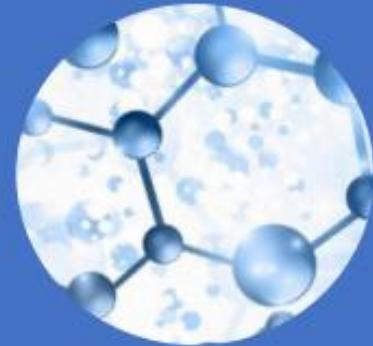


**ТОШКЕНТ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ
МАРКАЗИ**



КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ
(ноорганик моддалар ва минерал
ўғитлар ишлаб чиқариш бўйича)
йўналиши

TOSHKENT
KIMYO-TEKHNOLOGIYA
INSTITUTI

**« НАНО ВА КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ »**
модули бўйича

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

**Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг
2019 йил октябрдаги 5-сонли буйруги билан тасдиқланган ўқув режса ва
дастур асосида тайёрланди.**

Тузувчиликар: **З.А. Бабаханова** - Тошкент кимё-технология институти,
“Силикат материаллар, нодир ва камёб металлар технологияси” кафедраси доценти, т.ф.н.;
З.Ч. Қодирова – Тошкент кимё-технология институти,
“Силикат материаллар ва нодир, камёб металлар технологияси” кафедраси доценти, т.ф.д.;

**Ўқув -услубий мажмуа Тошкент кимё-технология институти Кенгашининг
20__ йил ___-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.**

МУНДАРИЖА

I.ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.....	100
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР.....	211
IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	57
V. БИТИРУВ ИШЛАРИ УЧУН МАВЗУЛАР	93
VI. КЕЙСЛАР БАНКИ.....	94
VII. ГЛОССАРИЙ.....	109
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ	137
IX. МУТАХАССИС ТОМОНИДАН БЕРИЛГАН ТАҚРИЗ	139

I.ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Дастур ривожланган мамлакатлардаги хорижий тажрибалар асосида “Кимёвий технология” қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналиши бўйича ишлаб чиқилган ўқув режа ва дастур мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг билимини ва касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди. Дастур мазмуни композицион материаллар инновацион технологиялари соҳасида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва технологик жараёнларни ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ушбу дастурда композицион материалларнинг инновацион технологиялари, композицион материаллар турлари ва уларнинг ишлаб чиқариш технологиялари, композитларнинг таркиби, структураси, макро ва микромеханикаси, композитлар билан дизайн қилиш усуллари, анъанавий ва ноанъанавий композитлар турлари, нанокомпозитлар, биокомпозитлар ва уларни ишлаб чиқаришдаги муаммолар баён этилган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

Кимёвий технология қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини “Кимёвий технология” мутахассислиги ўқув режасида маҳсус модуллар блокига киритилган “Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модули ўқув дастурининг **мақсади** – полимер, металл, керамик-матрициали композитлар ишлаб чиқаришда инновацион технологиялар; нанокомпозитлар, биокомпозитлар, ламинатлар турлари, материалларда керакли структура ва хоссаларни таъминлашда композицион материалларнинг ўрни ва моҳияти, асосий асбоб ускуналари тўғрисида назарий ва касбий тайёргарликни таъминлаш ва янгилаш бўйича билим, кўникма ва малакаларни такомиллаштиришга қаратилган.

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модулининг **вазифаси** - композицион материаллар ишлаб чиқаришда инновацион технологияларининг амалий принциплари, композицион материалларни заррача, тола ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш; шиша, органик, карбон, керамик тола ва симлар; матрица материаллар; композицион материалларнинг структура тузилишлари ва хоссаларини, замонавий композицион материалларни ишлаб чиқаришдаги ускуна ва жиҳозларнинг таснифи, тузилиши, худудий муаммоларнинг композицион материаллар ишлаб чиқаришга таъсири, уларни амалиётга қўллаш бўйича малакавий кўникмаларини шакллантириш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модули бўйича тингловчилар қўйидаги янги билим, кўникма, малака ҳамда компетенцияларга эга бўлишлари талаб этилади:

Тингловчи:

- композицион материаллар таснифи ва турлари;
- заррачалар, толалар ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш;
- матрица полимер, металл, керамика материаллари;
- полимер, металл, керамик-матрицали композитларни олиш жараёнлари;
- нанокомпозитлар, биокомпозитлар, ламинатлар инновацион технологиялари хақида **билимларга эга бўлиши лозим.**

Тингловчи:

- йўналтирилган хусусиятли композицион материал ишлаб чиқаришда матрица материалини танлаш;
- полимер, металл, керамик-матрицали композитларнинг таркибларини тузиш;
- зарур сифатдаги композицион материаллар ишлаб чиқариш учун тадбиқ қилинаётган инновацион технологияларнинг режимларини ростлаш **кўникма ва малакаларини эгаллаши зарур.**

Тингловчи:

- замонавий инновацион технологияларнинг имкониятларини намойиш қилиш тамойилларини ажратиб кўрсата олиш;
- технологик операцияларнинг инновацион технология жараёнларидағи ўрини ва уларнинг характеристикаларини фарқлаш;
- керакли хусусиятларга эга бўлган композицион материал таркибини тузиш ва унинг физик-механик хоссаларини лойиҳалаштириш **компетенцияларни эгаллаши лозим.**

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;
- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, тарқатма материаллар, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, ақлий хужум, кейслар ечиш, ва бошқа

интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модули қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини “Кимёвий технология” мутахассислигидаги “Кимё саноатидаги инновацион технологиялар” ва “Кимё саноатидаги наноматериаллар” модуллари билан узлуксиз боғлиқ бўлиб, ушбу модулларни ўзлаштиришда амалий ёрдам беради. «Композицион материалларнинг инновацион технологиялари» модулини тўлиқ ўзлаштиришда ва амалий вазифаларни бажаришда “Муҳандислик технологиясида тизимли таҳлил асослари (кимёвий технология)”, “Электрон педагогика асослари ва педагогнинг шахсий, касбий ахборот майдонини лойихалаш”, ҳамда “Амалий хорижий тилни ўрганишнинг интенсив усуллари” модуллари ёрдам беради.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

“Композицион материалларнинг инновацион технологиялари” модули қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишини “Кимёвий технология” мутахассислиги бўйича умумкасбий ва ихтисослик фанлари модулларидан дарс берувчи профессор ўқитувчилар учун муҳим ўринни эгаллайди. Ушбу модул Олий таълим муассасаларида таълим берувчи педагоглар томонидан ўқув-илмий ишларни олиб бориш учун асосий назарий ва амалий билимларни беради.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					Мустакил таълим
		Хаммаси	Жами	жумладан, назай	амалий машғулот		
1.	Нанотехнологиянинг асосий тушунчалари, предмет ва вазифалари. Нанотехнологияларнинг ривожланиш тенденцияси. Нанообъект, наноматериал, нанотехнология тушунчаси. Нанообъектларнинг асосий турлари ва улар асосидаги наносистемалар.	4	4	2	2		
2.	Наноструктураланган материалларни синтез усуллари. Нанозарралар, нанокукунларни синтез қилиш усуллари. 0-D нанообъектлар. 1-D нанообъектлар. Углеродсиз нанотрубкалар.	4	4	2	2		
3.	2D-Наноструктураланган материаллар ва углеродли наноматериал синтез усуллари. 2-D Нанообъектлар (юпқа пленкалар). Углеродли наноматериаллар, уларни синтези ва ишлатилиши. Композицион материаллар тузилиши. Матрица ва дисперс фаза.	4	4	2	2		
4.	Шиша, органик, карбон, керамик тола, симлар. Матрица материаллари: полимерлар, металлар, керамика материаллари.	2	2	-	2		
5.	Углерод-углеродли композитлар. Композитлар билан дизайн. Ноанъанавий композитлар. Нанокомпозитлар. Биокомпозитлар.	2	2	-	2		
6.	Жами:	16	16	6	10		

НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

**1-мавзу: Кириш. Нанотехнологиянинг асосий тушунчалари.
Нанообъектларнинг асосий турлари ва улар асосидаги наносистемалар.**

Фаннинг предмет ва вазифалари. Нанотехнологияларнинг ривожланиш тенденцияси. Нанотехнологиялар тўғрисида умумий маълумот. Нанообъект, наноматериал, нанотехнология тушунчаси. Кимё ва материаллар. Белгиланган хоссали наноматериаллар олишда илм-фан ва техника ютуқларини тадбиқ қилиш. Нанозаррачалар ва наноматериаллар хусусиятларининг физикавий сабаблари. Нанообъектлар таснифи. Фуллеренлар. Углеродли трубкалар. Супрамолекуляр кимё. Ноорганик наноматериаллар. Вискерлар. Манганиитлар. Юқори хароратли ўта ўтказгичлар. Фотон кристаллари. Биокерамика. Наноолмослар. Газли гидридлар. Газлардаги кластерлар.

2-мавзу: Наноструктураланган материалларни синтез усуллари.

Нанозарралар, нанокукунларни синтез қилиш усуллари. Газфазали синтез (буғларнинг конденсацияси). Плазмакимёвий синтез – лазерли аблация. Коллоид эритмалардан чўқтириб олиш – зол-гел жараён. Молекуляр-боғламли эпитаксия, газфазали эпитаксия, суюқ фазадан эпитаксия. 0-D нанообъектлар. 1-D нанообъектлар. Углеродсиз нанотрубкалар.

**3-мавзу: 2D-Наноструктураланган материаллар ва углеродли наноматериал синтез усуллари. Композицион материаллар тузилиши.
Матрицали ва дисперс фаза.**

2-D Нанообъектлар (юпқа пленкалар). Фазали эпитаксия. Углеродли наноматериаллар. Углеводородли наноматериаллар синтези. Углеводородли наноматериалларнинг ишлатилиши. Композицион материаллар тушунчаси. Композицион материаллар тузилиши. Матрицали ва дисперс фаза. Заррачалар, толалар ва структура даражасида мустаҳкамлаштириш.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАЗМУНИ

**1-амалий машғулот: Кристалл наносистемалар ва уларни ахамияти.
Нанотехнология ва электроника.**

Заррачаларнинг чегараси. Заррачалар чегарасининг миграцияси. Мултиплет иккиламчи заррачалар. Дислокация. Жойлашиш дефектлари. Учкаррали тугун. Холл-Петч қонуни. Таъкиқланган чегаранинг кенглиги.

Молекуляр электроника. Ёруғлик диоди (LED). Майдон эффектли транзистор (FET). Юпқа пленкали транзисторлар (TFT). Бир электронли транзистор (SET). Заряд боғланишли қурилма (CCD). Комплémentар металоксидли ярим ўтказгич (CMOS). Гигантмагнит қаршилиги (GMR). Оптоэлектроника. Фотолюминесценция. Фотон кристаллар. Фотоника. Юзаплазмон. Пьезорезистив эффект. Спинtronика (спин асосидаги

электроника). Кубит. Квант компьютерлар.

2-амалий машғулот: Полимер наноматериал олиш ва уларни хоссаларни. Наноцеллюлоза. Биомиметика системаларни олиш ва уларни хоссалари.

Суюқ кристал. Шакл хотирали полимерлар. Наноцеллюлоза. Түқимали инженерия. Биомослашувчанлик. Биомиметика. Электрон бурун. Электрон тил. Бот. Нанобот. Дориларни мақсадли етказиш. ДНК-чип.

3-амалий машғулот: Наноматериал олиш ва уларни хоссаларни.

Тагдан-тепага ва Тепадан пастга. Буғ фазасидан физикавий чүктириш (PVD). Плазма. Буғ фазасидан кимёвий чүктириш (CVD). Иссик изостатик преслаш (HIPing). Пиролиз. Учқунли плазмали пишириш (SPS). Тенг каналли бурчакли пресслаш (ECAP). Механик қотишималаш. Буғ-суюқлик-қаттиқ модда усули (VLS). Эпитаксия. Нанолитография. Fab. Аэрогел. Квант нұқталари. Бакминстер – фуллерен. Углеродли нанотрубка. Нанотолалар. Наноқобиқлар. Наносимлар. Наноматериал. Наностержнлар. Вискерлар. Юпқа пленкалар. Мезоговакли материал. Мултиқаватлар.

4-амалий машғулот: Нанометрология.

Атом-кучланишли микроскопия (AFM). Атом манипуляцияси. Нанолитография. Наноиндентификациялаш. Электрон микроскоп. Микрокантилевер. Сканировчи яқын худудли оптик микроскопия (SNOM). Рентгенфотоэлектронспектроскопия (XPS). Ўта ўказувчан квантинтерферометр (SQUID).

5-амалий машғулот: Композицион материаллар ишлаб чиқаришдаги мустаҳкамлаштирувчи компонентлар хоссаларини ўрганиш.

Композицион материаллар ишлаб чиқаришдаги толалар хоссаларини ўрганиш. Композицион материаллар ишлаб чиқаришдаги дисперс мустаҳкамлаштирувчи компонентларнинг гранулометрик таркиби ва хоссаларини ўрганиш.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

- Мазкур модул бўйича қуйидаги ўқитиши шаклларидан фойдаланилади:
- маъruzалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқишини ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сухбатлари (ўрганилаётган муаммо ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантикий хуносалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (муаммолар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш

қобилиягини ривожлантириш).

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Баҳолаш турлари	Максимал балл	Баллар
1	Кейс топшириклари	2.5	1.5 балл
2	Мустақил иш топшириклари		1.0 балл

П. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

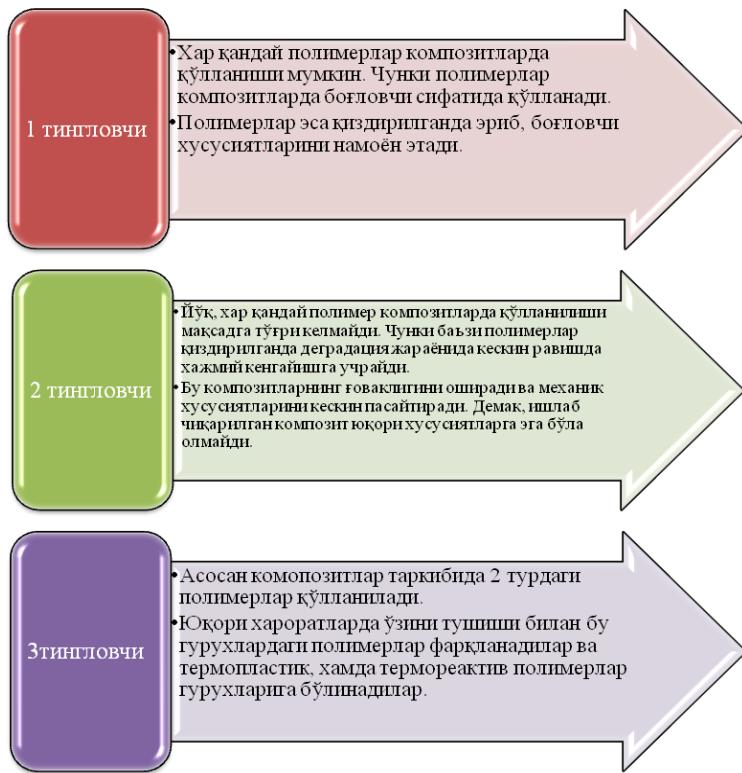
«Ақлий хужум» (брейнсторминг) методи

Методнинг мақсади: амалий ёки илмий муаммоларни ҳал этиш фикрларни жамоали генерация қилиш, ўқиб-ўрганиш фаолиятини фаоллаштириш, муаммони мустақил тушуниш ва ҳал этишга мотивлаштиришни ривожлантириш.

- Ақлий хужум вақтида иштирокчилар мураккаб муаммони биргаликда ҳал этишга интилишади: уларни ҳал этиш бўйича ўз фикрларини билдиради (генерация қиласи) ва бу фикрлар танқид қилинмасдан улар орасидан энг мувофиқи, самаралиси, мақбули ва шу каби фикрлар танлаб олиниб, муҳокама қилинади, ривожлантирилади ва ушбу фикрларни асослаш ва рад этиш имкониятлари баҳоланади. Ҳар бир груп ичida умумий муаммонинг бир жиҳати ҳал этилади.

Намуна: Ҳар қандай полимер бирикмаларидан композитлар таркибини тузишда фойдаланилиш мумкин-ми?

Тўғридан-тўғри жамоали ақлий хужум – иложи борича кўпроқ фикрлар йиғилишини таъминлайди. Бутун ўқув групидаги (20 кишидан ортиқ бўлмаган) битта муаммони ҳал этади. Ўқув групидаги ҳар бир тингловчи ушбу муаммога жавоб беради, ўз фикрини билдириб, далиллар келтиради.



ХУЛОСА:

- Композитларда полимерлар боғловчы сифатыда күлланилади. Полимерлар қыздырылғанда боғловчилик хусусиятига әгадир, юкори хароратдаги табиатига кўра 2 турга бўлинади: термопластик ва термореактив полимерлар.
- Композитларда боғловчы матрицалар сифатыда қаттық эпоксид, полизефир, фенол смолалар күлланилади.
- Полимер матрицалар юкори мустаҳкамлик ва эластик хоссалар; агрессив мухитларга бардошлиқ; яхши антифрикцион ва фрикцион хоссалар, ҳамда юкори иссиқлик химоялаш ва амортизацион хусусиятларини таъминлайди.
- Полимер матрицалар котган ҳолатда етарли мустаҳкамлигига ега да захарли моддаларни кўп микдорда чиқармайдиган бўлиши талаб этилади.

“Вени диаграммаси” методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишигандар айланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиши, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

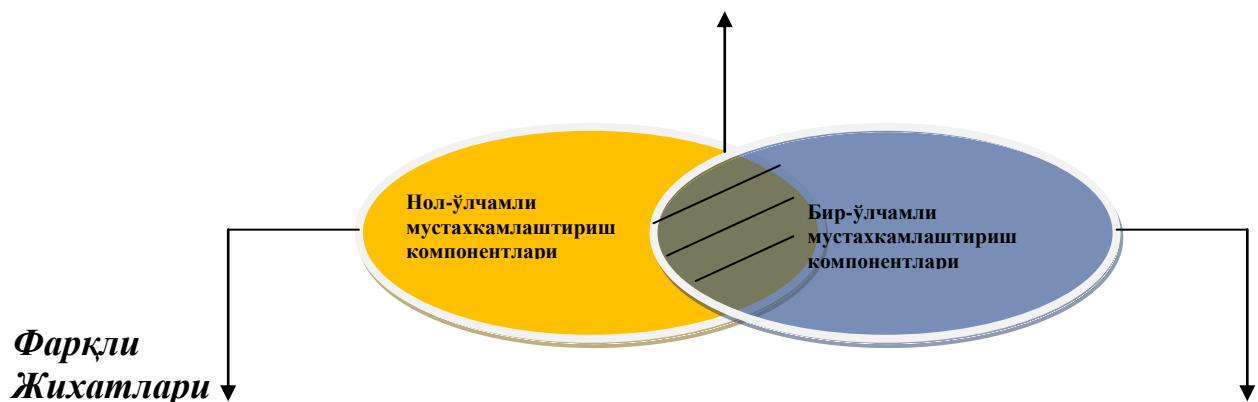
- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштирилдилар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиши таклиф этилади;
- навбатдаги босқичда иштирокчилар тўрт кишидан иборат кичик гурухларга бирлаштирилди да ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан гурух аъзоларини таништирадилар;
- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргалашиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар да доирачаларнинг кесишигандаги ёзадилар.

Намуна 1:

“Нол-ўлчамли мустаҳкамлаштириш компонентлари” ва “Бир-ўлчамли мустаҳкамлаштириш компонентлари” мавзуси бўйича “Вени диаграммаси”.

Умумий жиҳатлари:

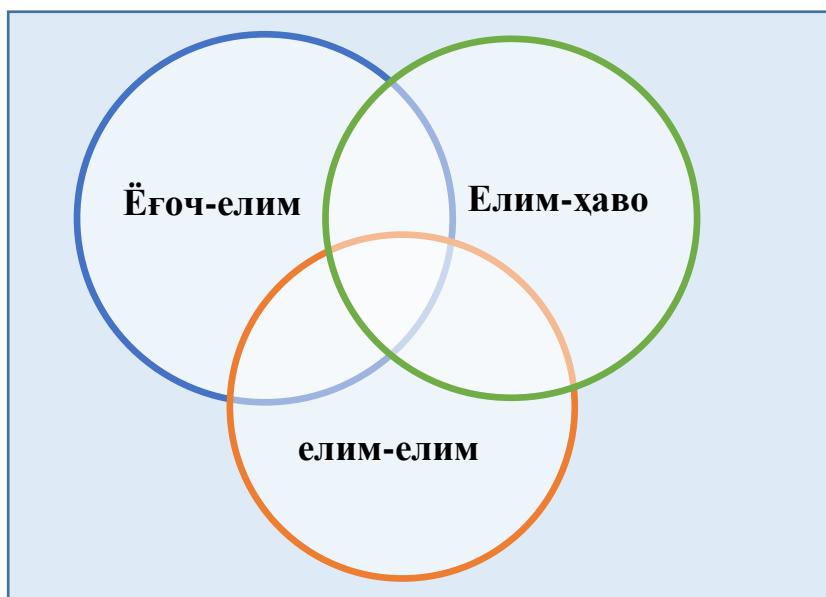
1. Композитларда мустаҳкамлаштирувчи вазифасини бажаради.
2. Композитларнинг термик бардошлигини оширади.
3. Композитларнинг мустаҳкамлигини оширади.
4. Композитларнинг қаттиқлигини оширади.



- 1. Нано- ва микро-ўлчамли заррачалар
 - 2. Изотропик хоссали композит хосил бўлади
 - 3. Ўлчами уч йўналишда кичик бўлган қўшимчалар
 - 4. Металл матрициали композитларда мустахкамлаштириш компонентлари
- 1. Тола, ип, “мўйловлар” шаклидаги узун кристаллар
 - 2. Анизотроп хусусиятли композит хосил бўлади
 - 3. Толасимон тўлдирувчилар, арматура элементлари, калта толали табиий материаллар
 - 4. Композитлар мустахкамлаштиришнинг энг тарқалган тури.

Намуна 2:

Елимланган материаллардаги адгезия ва когезия кучлари бўйича “Венн диаграммаси”.



“КЕЙС – СТАДИ” методи

«Кейс-стади» инглизча сўз - (case – аниқ вазият, ҳодиса, study - ўқитиш). Бу метод аниқ вазият, ҳодисага асосланган ўқитиш методи ҳисобланади. Кейс- услуг (Case study) – бу реал иқтисодий ёки ижтимоий вазиятлар таърифини қўллайдиган таълим бериш техникасидир. Бунда вазият деганда бирон аниқ ҳодисанинг таърифи назарда тутилади. Гурӯхга ҳақиқий ахборот тақдим этилиб (у ҳақиқий ҳодисага асосланган ёки ўйлаб чиқилган бўлиши мумкин), муаммоларни муҳокама қилиш, вазиятни таҳлил этиш, муаммонинг моҳиятини ўрганиб чиқиш, уларнинг таҳминий ечимларини таклиф қилиш ва бу ечимлар орасидан энг яхшисини танлаб

олиш таклиф этилади.

«Кейс - стади» методи бўйича ишлаш:

1. Якка тартибда ишлаш (умумий вақтнинг 30%си):

Вазият билан танишиш (матн бўйича ёки сўзлаб бериш орқали). Муаммоларни аниқлаш. Ахборотни умумлаштириш. Ахборот таҳлили.

2. Гурухда ишлаш (умумий вактнинг 50%си):

Муаммоларни ҳамда уларнинг долзарблиги бўйича кетма-кетлигини (иерархиясини) аниқлаш. Муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш. Ҳар бир ечимнинг афзал ва заиф жихатларини белгилаш. Муқобил ечимларни баҳолаш.

3. Якка тартибда ва гурухда ишлаш (умумий вақтнинг 20%си):

Муқобил варианtlарни қўллаш имкониятларини асослаш. Ҳисобот ҳамда натижалар тақдимотини тайёрлаш.

Кейс ҳаракатлари ўз ичига қўйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанака (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гурухда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гурухда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва гурухда ишлаш; ✓ муқобил варианtlарни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиҳа тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Кейс 1. «Кевлар» толалари билан мустаҳкамлаштирилган полимер – матрицали композитлар юқори эластиклик модулига эга, шунинг учун улар дунё бўйича қуролли кучларни ҳимоялаш воситаларида кенг қўлланилади

(бронежилетлар тайёрлашда). Аммо бундай композитларнинг термик бардошлиги паст кўрсаткичларга эга.

Композитларнинг термик бардошлигини қандай ошириш мумкин?

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг(индивидуал ва кичик гуруҳда).
- Янги термик бардош ва юқори эластик модулига эга бўлган композитнинг таркибини таклиф этинг (жуфтликлардаги иш).

Кейс 2.ДСП, фанера, МДФ, ДСтП материаллари ёғочсозликда мебель ишлаб чиқаришда кенг кўлланилади. Бироқ, улар Ўзбекистонга асосан четдан келтирилади. Ўзбекистонда елиманган ёғоч материаллар ишлаб чиқаришни ташкил қилиш учун имкониятларни изланг.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг, зарур билимлар рўйхатини тузинг (индивидуал ва кичик гуруҳда).
- Ёғоч хом ашёсини тўплаш бўйича бажариладиган ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликда ишлаш).
- Елиманган ёғоч материаллар бозори истеъмолчиларини изланг.
- Бажарилган ишларни тақдимот қилинг.

Кейс 3

Турли ёғочлардан олинган елиманган материаллар турлича физик-механик хоссаларни намоён қиласди. Ўзбекистон шароитида қайси елиманган ёғоч материалини ишлаб чиқариш ҳар тарафлама фойдали?

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:



“Тушунчалар таҳлили” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод тингловчилар ёки қатнашчиларни мавзу бўйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз билимларини мустақил равишда текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу бўйича дастлабки билимлар даражасини ташҳис қилиш мақсадида қўлланилади.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар машғулот қоидалари билан таништирилади;
- тингловчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, тушунчалар номи туширилган тарқатмалар берилади (индивидуал ёки гуруҳли тартибда);
- тингловчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, қачон, қандай ҳолатларда қўлланилиши ҳақида ёзма маълумот берадилар;
- белгиланган вақт якунига етгач ўқитувчи берилган тушунчаларнинг тўғри ва тўлиқ изохини уқиб эшиттиради ёки слайд орқали намойиш этади;
- ҳар бир иштирокчи берилган тўғри жавоблар билан ўзининг шахсий муносабатини таққослайди, фарқларини аниқлайди ва ўз билим даражасини текшириб, баҳолайди.

Намуна: “Модулдаги таянч тушунчалар таҳлили”

Тушунчалар	Сизнингча бу тушунча қандай маънони англатади?	Қўшимча маълумот
Композицион материал	Ишлаб чиқарилган, икки ёки қўпроқ физикавий ва кимёвий ҳар хил бўлган, матрица (интерфейс) ичida тартибли	

	жойлашган фазалардан ташкил топган материал.	
Матрица, интерфейс	Композицион материалнинг бир бутунлигини таъминловчи боғловчи компонент	
Матрица материаллари	Металл, керамика, полимер материаллар	

Изоҳ: Иккинчи устунчага қатнашчилар томонидан фикр билдирилади. Мазкур тушунчалар ҳақида қўшимча маълумот глоссарийда келтирилган.

“SWOT-таҳлил” методи

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топиш, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, баҳолаш, мустақил, танқидий фикрлаш, ностандарт тафаккурни шакллантириш.



Намуна 1: Толали мустаҳкамлаштириш компонентлари учун SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Толали мустаҳкамлаштириш компонентларининг кучли томонлари	Мустаҳкамлиги энг юқори кўрсаткичларга эга бўлган композитларни яратиш имкониятлари...
W	Толали мустаҳкамлаштириш компонентларининг кучсиз томонлари	Толали мустаҳкамлаштирилган композитларнинг анизотроплиги
O	Толали мустаҳкамлаштириш компонентларининг имкониятлари (ички)	Янги турдаги юқори хусусиятли толалар яратилмоқда – бор толалари, углерод толалари...
T	Тўсиқлар (ташқи)	Толали компонентлар матрица материаллари билан ҳўлланилиши ва аралишиши қийинлиги...

Намуна 2: Ёғоч-елим адгезияси учун SWOT таҳлилини амалга оширинг.

S	Кучли томонлари	<ul style="list-style-type: none"> • ёғоч юзасига елим текис тақсимланади; • елим ёғоч юзасига пуркаш, ролик билан суркаш, шпател билан суркаш, қуйиш каби турли усуслар билан берилиши мумкин; • очик ва ёпиқ ҳолатларда қотиши мумкин;
----------	-----------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> ион боғланишлар энг кучли боғланиш ҳисобланади.
W	Кучсиз томонлари	<ul style="list-style-type: none"> очик ҳолатда қотганда эритувчини чиқарип юбориш керак; елим ва ёғоч ўртасида мослашувчанлик бўлиши лозим; дисперс боғланишлар энг кучсиз боғланиш ҳисобланади.
O	Имкониятлари (ички)	<ul style="list-style-type: none"> ёғоч структурасига боғлик; кимёвий боғлар ҳам, механик боғлар ҳам яхши адгезия бериши мумкин; дисперсион, икки қутбли ва водород боғлари узилса намлик таъсирида қайта тикланиши мумкин.
T	Тўсиқлар (ташқи)	<ul style="list-style-type: none"> ковалент боғлар узилса қайта тикланмайди; дисперсия кучлар молекулалар орасида бўлгандан жуда суст бўлади, атомлар орасида бўлгандан эса жуда кучли ҳисобланади.

“Хулосалаш” (Резюме, Веер) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантикий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гурухлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гурӯҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурӯҳга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган кисмлари туширилган тарқатма материалларни



ҳар бир гурӯҳ ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён килади;



навбатдаги босқичда барча гурӯҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурӣ ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзуу

Намуна 1:

Композицион материаллар

Полимер матрициали		Металл матрициали		Керамик матрициали	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги

Хулоса:

Намуна 2:

Алтернатив ёқилғи турлари

Фанера		MDF		OSB	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги

Хулоса:

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникумаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзууни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хулоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



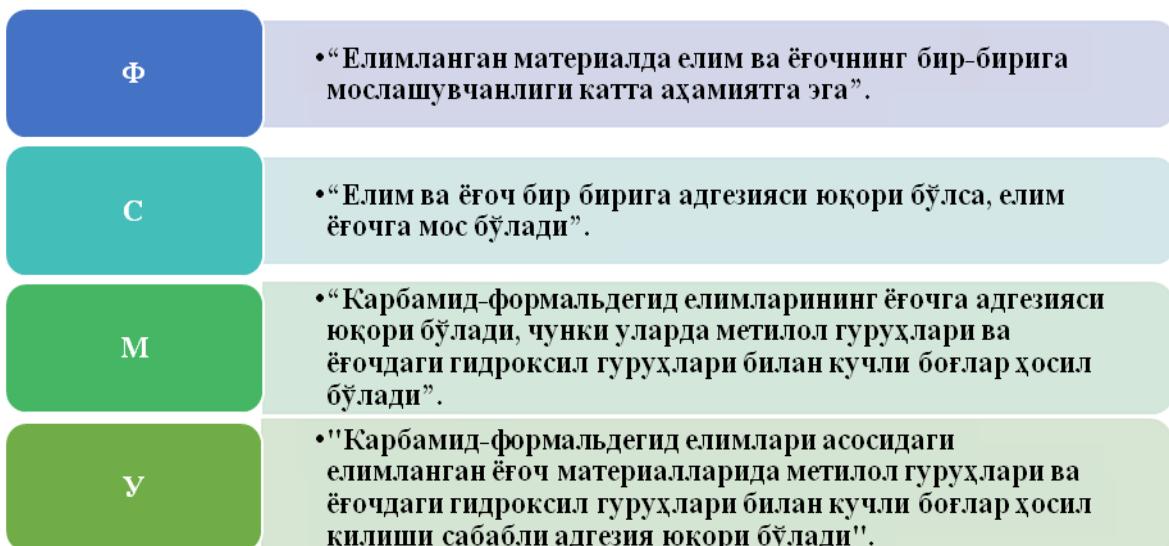
- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯҳий тартибда тақдимот қилинади.
- ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Намуна 1.

Фикр: “Полимер матрицали композитлар энг юқори физик-механик ва кимёвий хоссаларга эгадир”.

Топшириқ: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

Намуна 2: “Елимланган материалда елим ва ёғочнинг бир-бирига мослашувчанлиги катта аҳамиятга эга” фикрини ФСМУ орқали таҳлил қилинг.



“Синквейн” методи

“Синквейн” – тингловчини ижодий фаоллаштиришга, фаолиятни баҳолашига йўналтирилган таълим машқи ҳисобланади. Синквейн-французча сўздан олинган бўлиб, бешлик деган маънони билдиради. “Синквейн” методини амалга ошириш босқичлари:

1. Ўқитувчи тингловчиларга мавзуга оид тушунча, жараён ёки ҳодиса номини беради.
2. Тингловчилардан улар ҳақидаги фикрларини қисқа кўринишда ифодалашлари сўралади. Яъни, шеърга ўхшатиб 5 қатор маълумотлар ёзишлари керак бўлади.

У қуйидага қоидага асосан тузилиши керак:

- 1-қаторда мавзуу бир сўз билан (одатда от билан) ифодаланади.
- 2-қаторда мавзуга жуда мос келадиган иккита сифат берилади.
- 3-қаторда мавзуу Зта харакатни билдирувчи феъл билан фойдаланилади.
- 4-қаторда темага доир муҳокама этувчиларнинг ҳиссиётини ифодаловчи жумла тузилади. У тўрт сўздан иборат бўлади.
- 5-қаторда мавзуни моҳиятини ифодаловчи битта сўз берилади. У мавзунинг синоними бўлади.

Намуна. “Матрица” сўзига синквейн тузинг.

1. Матрица.
2. Боғловчилик хусусияти.
3. Хажм бўича тенг тақсимланган.
4. Композитнинг бир жинслилигини таъминлайдиган керамик, полимер ёки металл материал.
5. Компонент.

“Кластер” методи

Фикрларнинг тармоқланиши “Кластер” – бу педагогик стратегия бўлиб, у тингловчиларни бирон бир мавзуни чукур ўрганишларига ёрдам бериб, тингловчиларни мавзуга тааллуқли тушунча ёки аниқ фикрни эркин ва очиқ равишда кетма-кетлик билан узвий боғлаган ҳолда тармоқлашларига ўргатади.

Фикрларни тармоқлаш қуйидагича ташкил этилади:

- 1.Ҳаёлга келган ҳар қандай фикр бир сўз билан ифода этиб кетма-кет ёзилади.
- 2.Фикрлар тугамагунча ёзишда давом этавериш керак.
3. Иложи борича фикрларнинг кетма-кетлиги ва ўзаро боғлиқлигини кўпайтириш.

Намуна. “Композицион материаллар турлари” мавзусига “Кластер” график органайзерини тузинг.

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-мавзу: Кириш. Нанотехнологиянинг асосий тушунчалари

Режа:

- 1.1. Нанотехнологияларнинг ривожланиш тенденцияси.
- 1.2. Нанотехнологиялар тўғрисида умумий маълумот.
- 1.3. Нанообъект, наноматериал, нанотехнология тушунчаси.

Таянч иборалар: нанотехнология жараёнлари, наноматериаллар, углерод нанотрубкалари.

Кириш. Фаннининг предмет ва вазифалари.

Ушбу фан математик ва табиий-илмий хамда умумкасбий фанларга таянган холда наноматериалларнинг физик-кимёвий муаммоларини хал қилиш ва фан сифатида шаклланишини мустахкамлаш мақсадида: нанотехнологиянинг асосий тушунчалари, нанотехнологиянинг тадкиқот объектлари ва уларнинг синфланиши, нанотехнологиянинг ривожланиш босқичлари, нанообъектларнинг асосий турлари ва улар асосидаги нанотизимлар, углеродли нанотрубкалар, фуллеренлар, супрамолекуляр кимё, ноорганик наноматериаллар;nanoструктуранган материалларнинг синтез усуллари, фундаментал асослари тўғрисидаги маълумотларни қамраб олади ва бу билимларни талабаларга етказиш фаннинг асосий мақсад ва вазифалари хисобланади.

“Наноматериаллар” фанини ўзлаштириш жараёнида:

- анатизимнинг кристаллофизикаси, nanoструктуралар ва уларнинг симметрик ифодаси;
- электронларнинг энергетик спектри квант ушлов структураларида квант нукталар, толалар, юқори даражали панжаранинг аҳамияти;
- холлинг квант эфекти ва квант ўлчов структуралари оптик хусусиятларининг моҳияти;
- наноқатламли композицияларни магнит хоссалари, кондесацияланган мухитларда энергия ва зарядлар ўтқазиш жараенлари;
- nanoструктуралашган материалларни физик кимеси, кичик ансамбли молекулалар, молекулараро ўзаро таъсири ҳақида тасаввурга эга бўлиши;
- нанозаррачаларни ўлчов ва функционал хоссалари;
- молекуляр динамика, конформация ва нанотизм симметрик тасвири;
- фазалараро чегараларни термодинамикаси ва кинетикаси, Кластер;
- мицеллалар хосил бўлиши, полимеризациялаш, матрица синтези, ўзарошакланиш;

- наноматериаллар: золлар, геллар, суспензиялар, коллоид эритмалар, матрица-ажратилган кластерли юқори даражадаги структуралар, фуллеренлар, углеродли нанотрубкалар, полимерлар, юқори даражали панжаралар, биомембраналар;
- нанотизимларни электр ўтказувчи, иссиқлик ўтказувчи ва механик хоссалари.
- наноматериалларни махсус хоссалари, уларни физик-кимевий табиатлари боғлиқлары, танловчанлиги, энергия хажмлиги ва электрон хотирасининг моҳиятини билиши ва улардан фойдалана олиши;
- нанокимевий компоненталар: катализаторлар, сорбентлар, реакторлар;
- наноқатламлар синтези услублари: атом-молекуляр эпитаксия, молекуляр ва кимёвий конструктрлаш;
- Ленгмюр-Блоджетт молекуляр қатламлаш услуби, полианион молекуляр конструктрлаш;
- юқори даражада локалланган қопланиш, ажратиш ва моддаларни модификациялаш услублари;
- корпускуло-фотонли ва электрокимёвий нанотехнологиялар, нанозондли локал синтез ва моддани ажратиш, материал юзасини модификациялаш кўникмаларига эга бўлиши керак.

1.1. Нанотехнологияларнинг ривожланиш тенденцияси

Нанотехнологияни ривожланиши қуйидагиларга боғлиқ¹:

- Физика
- Кимё
- Биология
- АКТ
- Электротехника
- Машинасозлик

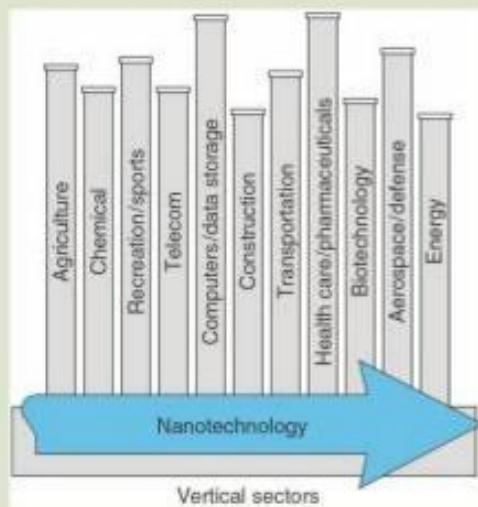
Нанотехнология генетика фанини ривожланишига катта тасир кўрсатди:

- нанотибиёт
- нано капсула
- нано гель
- саратон касаллигини даволаш
- соғ бўлган катакларга зарар етказмасдан даволаш

¹ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011. 35.

Fig. 1.6

Nanotechnology is a convergent and enabling horizontal technology. Nanotechnology is not its own industrial sector but cuts across all types of vertical industrial sectors.



Расм 1. Нанотехнологияларнинг ривожланиш тенденцияси².

Нано роботлар.

- Микроскопик масштабдаги машина ва роботларни яратиш ва улардан унумли фойдаланиш.

Нанотехнология ва коинот:

- коинот аппаратларни яхшилаш
- астронавтларга мухитни такомиллаштириш
- коинот саёхатларни арzonлаштириш
- нано ер йўлдошларини яратиш.

Нано озиқланиш:

- озиқаларни музсиз сақлаш
- озиқ- овқатларни бактерия ва паразитлардан химоя қилиш
- енгил хазм бўладиган моддаларни яратиш

Нано ва мудофаа:

- кичик ўлчамли ва тезюарар электрон қурилмалар
- енгил, қувватли ускуналар
- сенсорларнинг янги авлодларини яратиш
- такомиллаштирилган қуроллар

Нано ва электроника (Расм 1-2):

- электрон қурилмалар экранларини замонавийлаштириш
- хотира микросхемаларини бир квадрат дюймдаги хажминги терабайтларга етказиши
- интеграл схемаларда ишлатиладиган ярим ўтказгичли асбобларнинг хажмини камайтириш

²G.L.Hornyak, J.J. Moore, H.F.Tibbals, J. Dutta. Fundamentals of Nanotechnology.-CRC Press, Taylor and Francis, 2009, 24

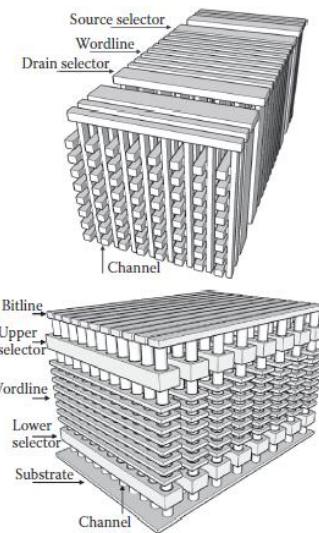


FIGURE 2.3 Proposed structures for three-dimensional NAND Flash Memory. (Data from International Technology Roadmap for Semiconductor [ITRS] <http://www.itrs.net>.)

Расм 2. Учёлчамли NAND Flash хотираси учун тахминий тузилиши³.

Нано ва АКТ:

- катодли нур трубкасини углерод нанотрубкаларига алмаштириш
- нанотехнологиялардан таъминотда унумли фойдаланиш

Нано ва энергетика:

- қуёш ва иссиқлик батареяларидан фойдаланиш;
- юқори ҳароратли ўтказгичларни ишлатиш
- гальванник элементлар ва аккумуляторларни, янги наноавлодини яратиш

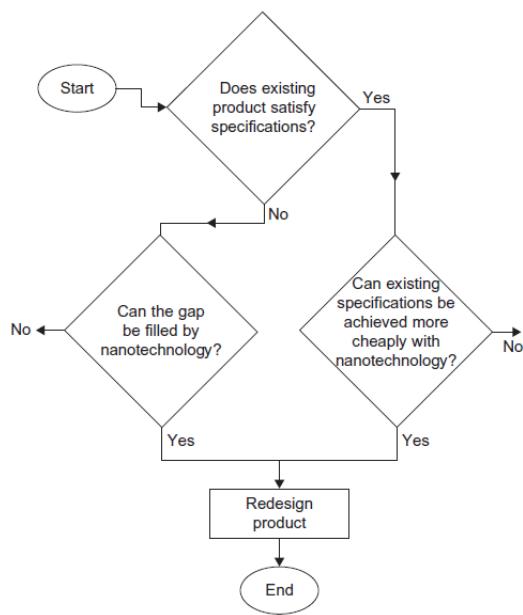


FIGURE 1.3

Flow chart to determine whether nanotechnology should be introduced into a product.

Расм 3. Нанотехнология махсулотга қўлланилиши мумкинлигини аниқлаш диаграммаси⁴.

³ David Rickerby Nanotechnology for Sustainable Manufacturing, Taylor and Francis, 2014, 21.

⁴ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 12

1) Р.Фейнман Нобель муроғоти лауреати. “Менинг фикримча, физика принциплари алоҳида атомлардан ўзининг шахсий манфаатлари йўлида фойдаланишни ман қилмайди”. 1995 й.



Richard Phillips Feynman

2) 1996 й. Р.Янг пъездвигателлар ғоясини таклиф қилди, ҳозирги кунда улар нанотехнология асбобларининг прецизион харакатланишини $0.01 \text{ A.A} = 10^{-10} \text{ м}$ аниқлик билан таъминлайди.

3) Норио Томигути биринчи марта “нанотехнология” атамасини 1974 йилда қўллади.

4) 1982-1985-йилларда немис профессори Г.Гляйтер қаттиқ жисмлар нанотузилмаси концепциясини таклиф этди.

5) 1985 йилда Роберт Керл, Харелд Крето, Ричард Смоллилардан иборат олимлар жамоаси фуллеренларни кашф қилди ва CNT (carbon nanotubes) назариясини яратди, улар 1991 йилда тажриба йўли билан олинди.

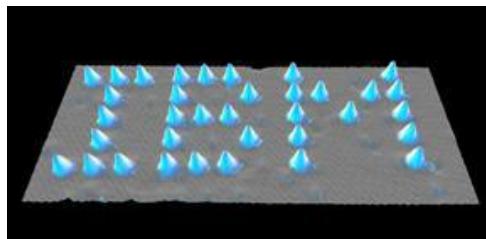
6) 1982-йилда Г.Бининг ва Т Рорер биринчи сканер қилувчи тунелли микроскоп (СТМ) яратдилар.

7) 1986-йилда сканер қилувчи атом –кучли микроскоп пайдо бўлди.

8) 1987-1988-йилларда алоҳида атомлардан ўзининг шахсий манфаатлари йўлида фойдаланиш имконини берувчи биринчи нанотехнология қурилмаларининг ишлаш принциплари намойиш қилинди.

Э.Дрекслер-нанотехнологиялар ҳақидаги барча билимларни умумлаштириди, ўз-ўзини намоён қилувчи молекуляр роботлар концепциясини аниқлади, улар йиғиш ва ёйиш (декомпозиция)нинг амалга ошириши, маълумотни атомар даражада хотирага ёзиш ўз-ўзини намоён қилиш ва улардан фойдаланиш дастурларини сақлаши керак эди.

9) 1990-йилда СТМ ёрдамида IBM фирмаси билан биргаликда Зта харф чизилди. Улар Xe(35 атом) билан никел кристаллининг яssi грамида чизилди. (Расм 4)

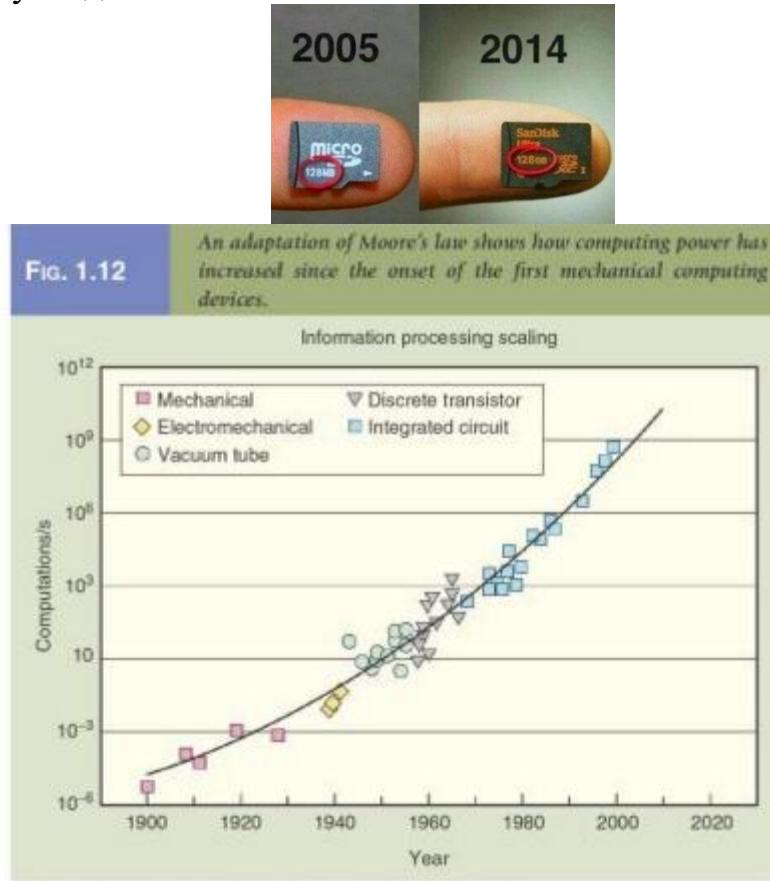


Расм 4. IBM фирмасининг литографияси⁵

⁵ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 302

Мур қонуни: қурилманинг юза бирлигига ўрнаштирилган транзисторларнинг сони тахминан хар 18 ойда икки баробар кўпайишини назарда тутувчи хисоблаш қурилмаларидағи ўзоқмуддатли тренд.

Кридер қонуни: қаттиқ дискларнинг хотира хажми деярли хар йили икки баробар кўпаяди.



Расм 5. Мур ва Кридер қонуни⁶ 23

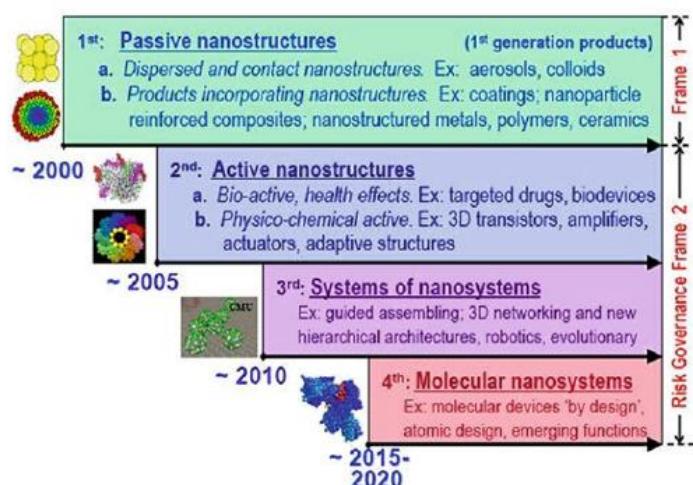


Fig. 2.1 Generations of nanotechnology development (Roco 2011)

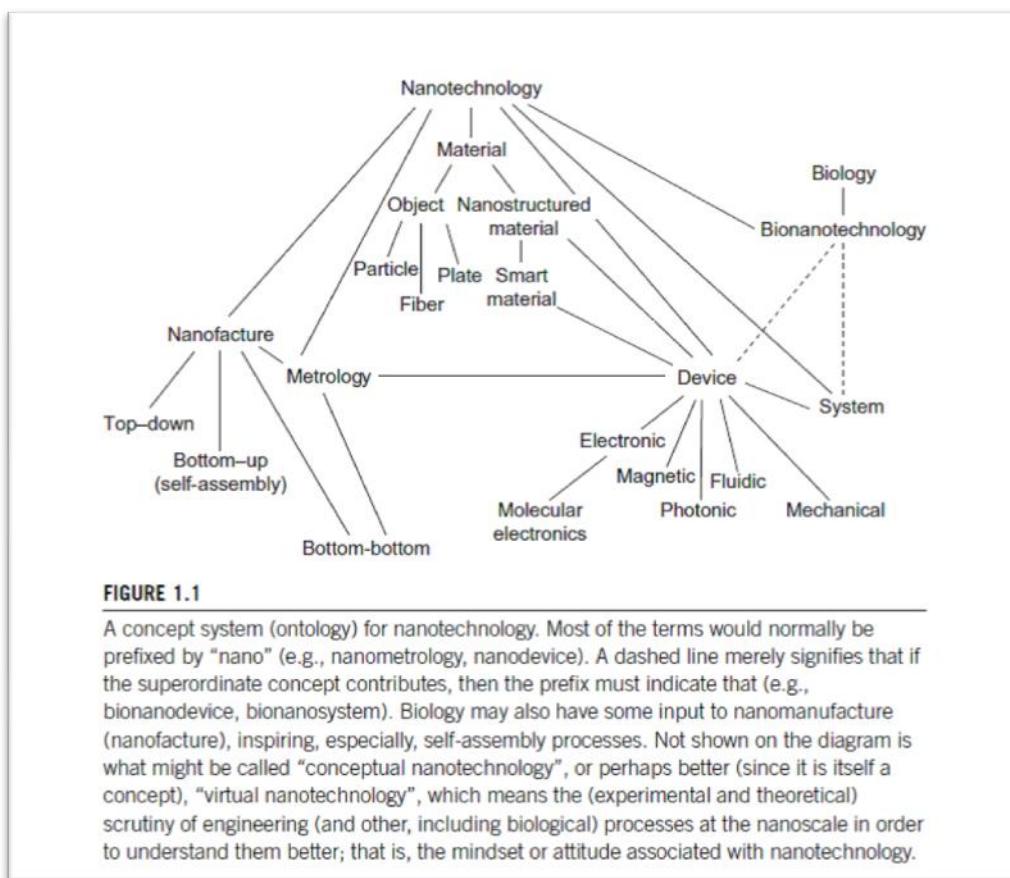
Расм 6. Нанотехнологиянинг ривожланиш тенденцияси⁷

⁶ G.L.Hornyak, J.J. Moore, H.F.Tibbals, J. Dutta. Fundamentals of Nanotechnology.-CRC Press, Taylor and Francis, 2009, 12

⁷ Said Salaheldeen Elnashaie, Firoozeh Danafar, Hassan Hashemipour Rafsanjani Nanotechnology for Chemical Engineers, Springer, 2015, 95.

1.2. Нанотехнологиялар түғрисида умумий маълумот

Белгиланган хоссали наноматериаллар олишда илм-фан ва техника ютуқларини тадбиқ қилиш. Бир қатор нанообъектлар маълум ва улар анчадан бери қўлланади. Коллоидлар, майда дисперс кукунлар ингичка плёнкалар шулар жумласидан (Расм 7).



Расм 7. Нанотехнологияларда онтология. Нано префикси (нанометрология, наноасбоб)⁸

Хозирги кунга келиб хона ҳарорати шароитида юзада атомларнинг бирикиши ва ҳажмда атомларнинг турли комбинациялари ҳосил бўлишининг технологик усуллари ишлаб чиқилмоқда.

Углерод “nanotube”лар (нанонайча, нанотрубкалари) CNT (carbon nanotubes):

- бу трубкалар молекуляр масштабдаги материалларга киради;
- таркибида графит углероди бўлиб ажойиб хоссаларга эга.

Нанотехнологияларининг энг реал чиқиши атомар тузилмаларининг ўз-ўзини йиғиши дейилади. Замонавий нанотехнологиянинг вазифаси, атомар тузилмаларини йиғишни таъминловчи табиий қонуниятларини топиш.

1.3. Нанообъект, наноматериал, нанотехнология тушунчаси

⁸ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 4

Нано - “ 10^{-9} ”. Шундай қилиб нанотехнологияларнинг фаолият соҳасига, ҳоҳ битта ўлчамда бўлсин *нм* билан ўлчанадиган объектлар киради. Кўриб чиқилаётган объектлар қўлами алоҳида атом ўлчамидан анча кенг, конгламератларгача (таркибида 1,2 ёки 3 ўлчамда 1 мкм ўлчамга эга 10^9 дан ортиқ атом органик молекулалар). Ушбу объектлар б.б сон атомлардан иборат эмаслиги жуда муҳим, бу эса модданинг дискрет атом-молекуляр тузилмасининг пайдо бўлиши ёки унинг квант қонуниятларини белгилаб беради (расм 8).

Table 1.1 Some nano concepts and their intensions and extensions

Intension	Concept	Extension
One or more external dimensions in the nanoscale	Nano-object	Graphene, fullerene
One or more geometrical features in the nanoscale	Nanomaterial	A nanocomposite
Automaton with information storage and/or processing embodiments in the nanoscale	Nanodevice	Single electron transistor

Жадвал 1. Наноконцепция ва уларнинг таркибий қисми ва қўлланилиши⁹

1) Нанообъектни аниқлаш. Нанометр ўлчамли ҳар қандай физикавий объект $1 \times 2 \times 3$ х координатали майдонда (тез кунда вақт ўлчамида бўлиши мумкин).

2) Ҳар қандай амтериал объект нанообъект дейилади, уларда юза атомларнинг сони ҳажмдаги атомларнинг сони билан солиштирма ёки юқори.

3) Нанообъектни аниқлаш. Нанообъект - 1 ёки кўпроқ координата ўлчамли, де Бройлнинг электрон учун тўлқини узунлиги билан таққосланадиган объект. (1924 йилда физик олим де Бройль “Фотонлар учун корпускуляр тўлқинли дуализм табиатнинг исталган зарраси учун мос” деган.

$$\lambda_{\delta} = \frac{h}{p},$$

бу ерда: h – Планк доимиси; p – электрон импулси; λ_{δ} – де Бройлнинг тўлқини.

4) Нанообъектни аниқлаш. Ўзининг ўлчовларида ҳодисанинг энг сўнгги ўлчовидан ҳам кичик объектларни айтишади (у ёки бу ҳодисанинг поляризацион радиуси билан бир хил ўлчам, электронларнинг эркин ҳаракатланиш узунлиги, магнит домен ўлчами, қаттиқ жисмнинг пайдо бўлиш ўлчами).

5) Нанообъектни аниқлаш. Нанообъект – бу уч майдон ўлчамиининг ҳеч бўлмаса биттасида 100 нм дан кам бўлмаган ўлчамли объект. 100 нм – де Бройлнинг электрони учун тўлқин узунлиги.

⁹ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 5

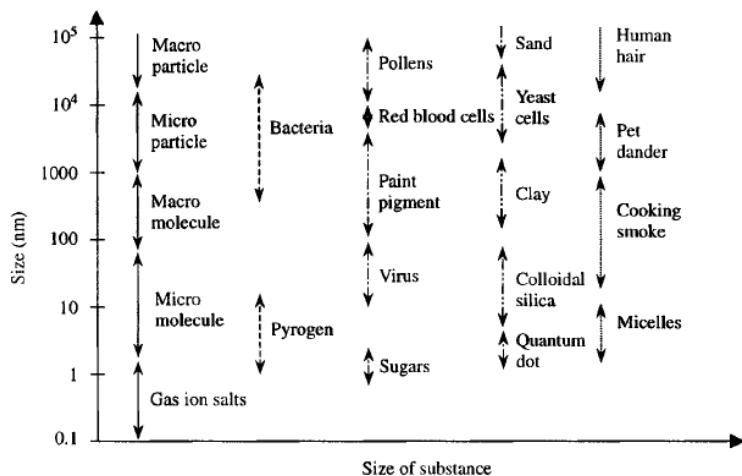
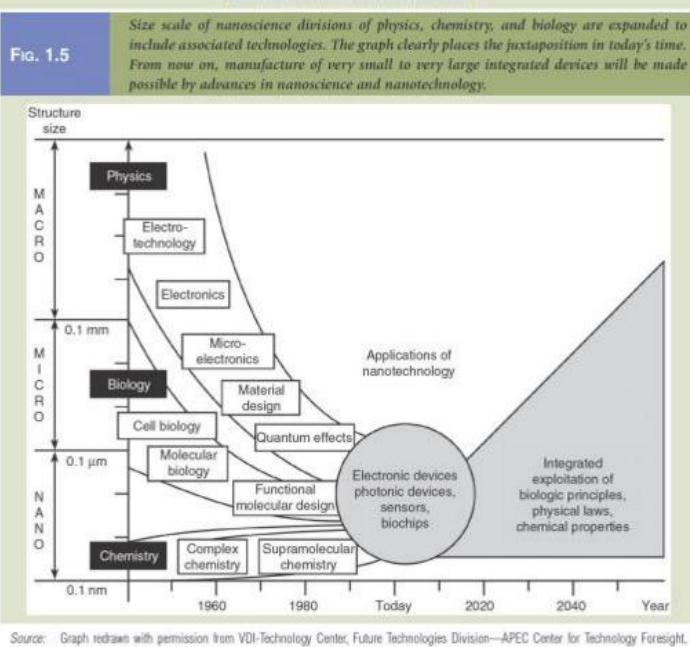
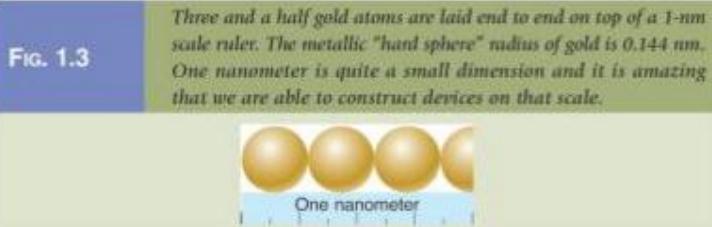


Fig. 1.1. Examples of zero-dimensional nanostructures or nanomaterials with their typical ranges of dimension.



Source: Graph redrawn with permission from VDI-Technology Center, Future Technologies Division—APEC Center for Technology Foresight, Thailand.

Расм. 8. Типик ўлчамли 0-ўлчамли нанотизимлар ва наноматериалларнинг намуналари 10^{-11}

Наноматериаллар бу нанообъектларнинг ўзи (агар улар турли техникавий мослама ва ускуналар тайёрлашга хизмат қилса, худди нанообъектлар ушбу материалларда маълум бир хусусият шакллантириши учун фойдаланилади ёки наноконструкторланган материаллар каби).

¹⁰ G.L.Hornyak, J.J. Moore, H.F.Tibbals, J. Dutta. Fundamentals of Nanotechnology.-CRC Press, Taylor and Francis, 2009, 8-11.

¹¹ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 2.

“Нанотехнология” түшүнчеси “наноматериал” түшүнчеси билан чамбарчас боғлиқ.

“Технология” атамаси уч түшүнчани англатади:

- 1) технологик жараён;
- 2) технологик ҳужжатлар түплами;
- 3) қайта ишлаш жараёнларининг қонуниятлари ва маҳсулотни ўрганувчи илмий фан.

Нанотехнология – наноматериалларни олиш, қайта ишлаш ва қўллаш қонуниятларини ўрганувчи фан.

Назорат саволлари

1. “Наноматериаллар” түшүнчасига таъриф беринг.
2. Наноматериалларнинг кандай турларини биласиз?
3. Нанометрология ва наноасбоб деб нимага айтилади?
4. Наноматериалларнинг алоҳида хусусиятларнинг сабаби нимада?
5. Мур қонуни нима?
6. Кридер қонуни тушунтиринг?

Фойдаланилган адабиётлар

1. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011. 35.
2. G.L.Hornyak, J.J. Moore, H.F.Tibbals, J. Dutta. Fundamentals of Nanotechnology.-CRC Press, Taylor and Francis, 2009, 24.
3. David Rickerby Nanotechnology for Sustainable Manufacturing, Taylor and Francis, 2014, 21.
4. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 12.
5. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 302.
6. G.L.Hornyak, J.J. Moore, H.F.Tibbals, J. Dutta. Fundamentals of Nanotechnology.-CRC Press, Taylor and Francis, 2009, 12.
7. Said Salaheldeen Elnashaie, Firoozeh Danafar, Hassan Hashemipour Rafsanjani Nanotechnology for Chemical Engineers, Springer, 2015, 95.
8. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 4.
9. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 5.
10. G.L.Hornyak, J.J. Moore, H.F.Tibbals, J. Dutta. Fundamentals of Nanotechnology.-CRC Press, Taylor and Francis, 2009, 8-11.
11. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 2.

2-мавзу: Нанообъектларнинг асосий турлари ва улар асосидаги наносистемалар.

Режа:

- 2.1. Нанозаррачалар ва наноматериаллар хусусиятларининг физикавий сабаблари.
- 2.2. Нанообъектлар таснифи.

Таянч иборалар: фуллеренлар, углеродли трубкалар, супрамолекуляр моддалар, вискерлар, манганиитлар, фотон кристаллари, биокерамика, наноолмослар, газли гидратлар ва кластерлар.

2.1. Нанозаррачалар ва наноматериаллар хусусиятларининг физикавий сабаблари

- 1) Нанообъектларда юза ёки дон чегара атомларининг сони ҳажмдаги атомлар сони билан таққосланади [1] (расм 1-2).

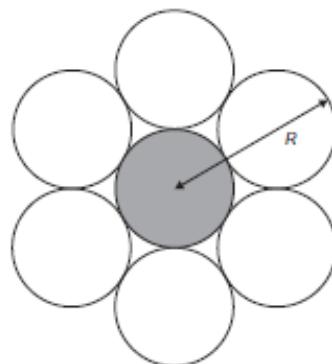


FIGURE 2.1
Cross-section of a spherical nanoparticle consisting of 19 atoms.

Расм 1. Кесимдаги 19 атомдан ташкил топган нанозаррата¹².

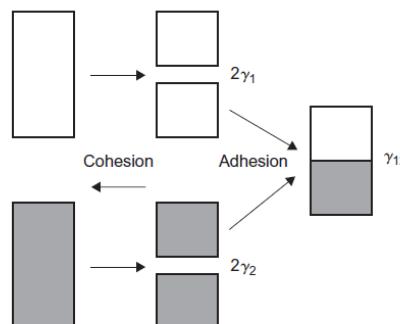


FIGURE 3.2
Cohesion and adhesion of substances 1 (white) and 2 (gray) (see text).

Расм 2. Когезия ва адгезия¹³.

¹² Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 19

¹³ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 38

2) Юзада жойлашган атомлар ҳам қаттиқ жисм ҳажмидағи атомлардан фарқли үлароқ, үйік жойлар ва босқичларнинг узелларида камсонли тугалланган алоқаларга эга бўлади. Бу ҳол нанообъектлар ва монотаркиблашган материалларнинг кимёвий, катализитик фаолияти турлича ортишига олиб келади. Бундан ташқари углерод атомлардан миграция, яъни диффузион миграция, рекристаллизация, шунингдек сорбцион ҳажм ва бошқалар тезлигининг ортиши юзалик бўйлаб анча тез юз беради (расм 3).

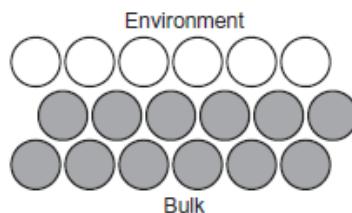


FIGURE 2.3

The boundary of an object shown as a cross-section in two dimensions. The surface atoms (white) are qualitatively different from the bulk atoms (gray), since the latter have six nearest neighbors (in two-dimensional cross-section) of their own kind, whereas the former only have four.

Расм 3. Иккита ўлчамда объектни боғланиши. Юза атомлари (ок) ички атомларидан сифат жихатдан фарқ қиласи (кулранг)¹⁴.

3) Нанообъектлар учун чизиқли ва юзаки таранглашувнинг тасвирлаш кучи нанообъектлар учун бўлганига қараганда анча кучли намоён бўлади, чунки қаттиқ жисм ҳажмида юзадан узоқлашганда бу кучлар анча заифлашади. Бу кучларнинг катталиги нанообъект ҳажмининг кристаллик таркиби камчиликларининг кучларидан тозаланишига олиб келади. Нанообъект нанообъектга қараганда анча мукаммал кристаллик таркибига эга. Тасвир кучлари ўз номини электр майдонларни хисоблаш усули бўйича олган (расм 4-6).

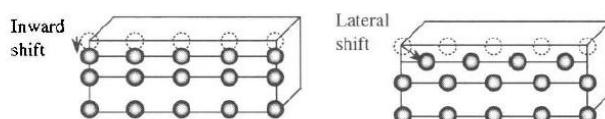


Fig. 2.4. Schematic showing surface atoms shifting either inwardly or laterally so as to reduce the surface energy.

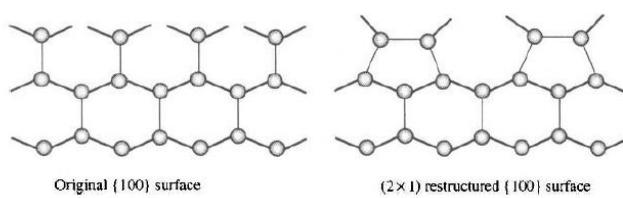


Fig. 2.5. Schematic illustrating the (2x1) restructure of silicon {100} surface.

Расм 4. Юза атомлари силжиши схемаси ва юза энергиясининг камайиши. Кремний юзасининг реструктуризацияси¹⁵.

¹⁴ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 22

¹⁵ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 20

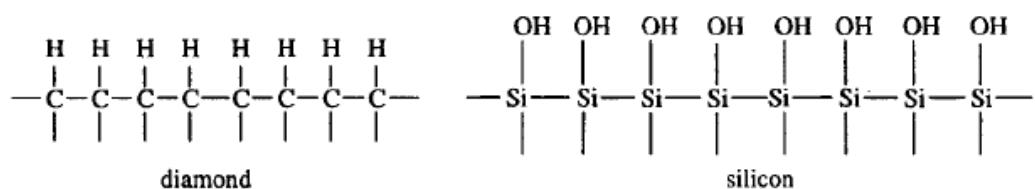


Fig. 2.6. Schematic showing the surface of diamond is covered with hydrogen and that of silicon is covered with hydroxyl groups through chemisorption before restructuring.

Расм 5. Хемосорбция натижасида юзаларида водород ва гидроксид группали олмос ва кремнийнинг юзаси¹⁶

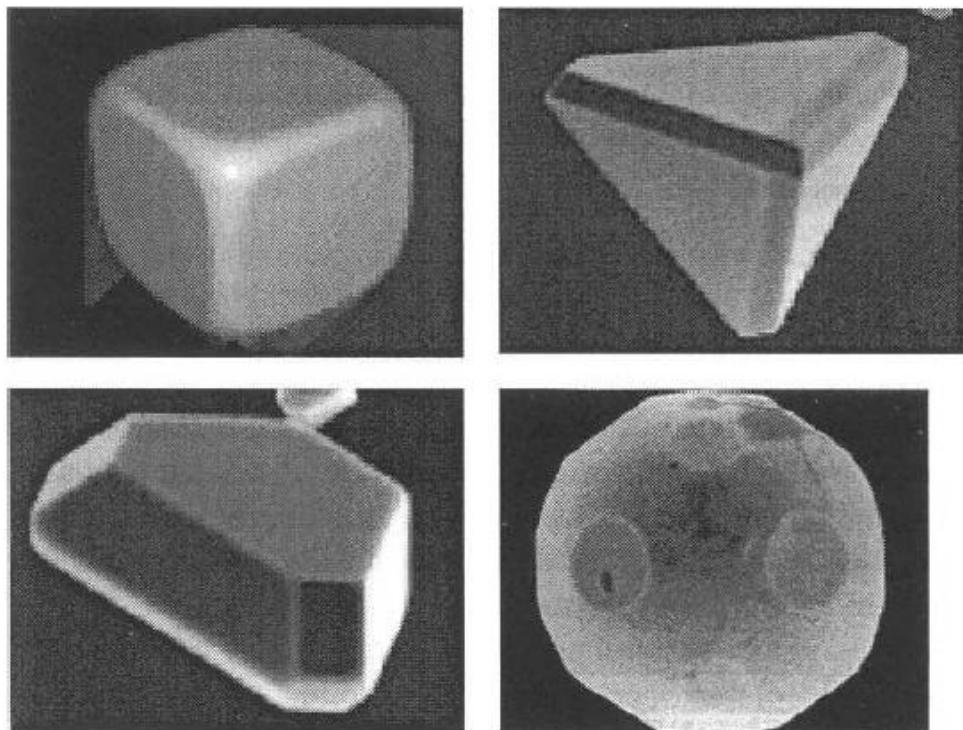


Fig. 2.7. Examples of single crystals with thermodynamic equilibrium shape. (Top-left) Sodium chloride, (top-right) silver, (bottom-left) silver, and (bottom-right) gold. Gold particles are formed at 1000°C and some facets have gone through roughening transition.

Расм 6. Монкристалларнинг намуналари – натрий хлориди, кумуш, олтин (харорат 1000°C)¹⁷.

4) Нанообъектларда тарқалиш, рекомбинация ҳамда объектларнинг чегараларида акс этиш билан боғлиқ бўлган катталик эфектлари катта аҳамиятга эга бўлади (гап микрозаррачаларнинг ҳаракати устида бормоқда).

Ҳар қандай кўчириш ҳодисасида (эл. токи, иссиқликни ўtkазувчанлик, пластик, деформация ва ҳоказолар) воситаларга қандайдир эркин югуришнинг самарали узунлигига нисбат бериш мумкин, бунда объектнинг

¹⁶ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 20

¹⁷ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 22

катталиги воситанинг эркин югуриш узунлиги, воситаларнинг тарқалиш ва ҳалок бўлиши жараёни объектнинг геометриясига учалик боғлик бўлмайди. Агарда объект катталигини воситанинг эркин югуриш узунлиги билан таққослаш мумкин бўлса, у ҳолда бу жараёнлар анча интенсив кечади ва улар намунанинг геометриясига кучли даражада боғлик бўлади (расм 7).

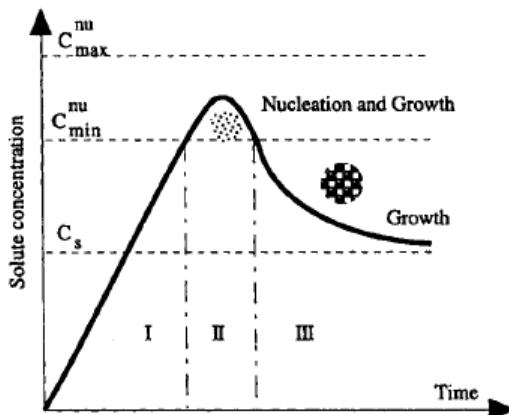


Fig. 3.4. Schematic illustrating the processes of nucleation and subsequent growth. [M. Haruta and B. Delmon, *J. Chim. Phys.* **83**, 859 (1986).]

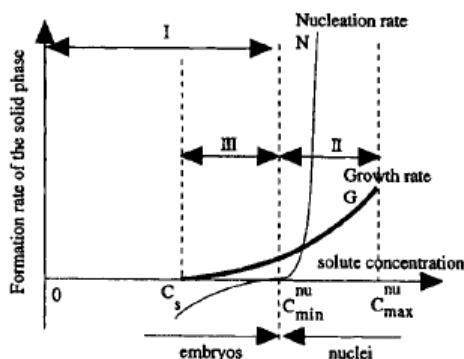


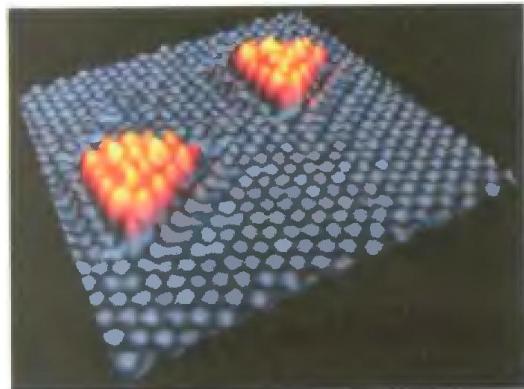
Fig. 3.5. Schematic showing, from a slightly different point of view, the relations between the nucleation and growth rates and the concentration of growth species. [M. Haruta and B. Delmon, *J. Chim. Phys.* **83**, 859 (1986).]

Расм 7. Нуклеация ва ўсиш жараёнлари схемалари¹⁸.

5) Нанозарраларнинг катталиги янги фаза, домен, дислокацион ҳалқа ва шу кабилар муртагининг катталиги билан тенг ёки ундан кичик бўлади. Бу нанообъектлар ва наноматериалларнинг магнит хоссалари (Fe нанозарра магнит хоссасига эга эмас), диэлектрик хоссалари, пишиқ-пухталик хоссалари макрообъектларнига нисбатан тубдан камайишига олиб келади.

6) Модданинг камсонли атомлари учун юзани реконструкция қилиш, ўзини ўзи ташкил этиш ва ўзини ўзи йифиш хосдир, яъни атом кластерга бирлашганида геометрик тузилмаларнинг ҳосил бўлиши юз беради, улардан кейинчалик техник вазифаларни ҳал қилиш учун фойдаланиш мумкин (расм 8).

¹⁸ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 57



Расм 8. Атомлар ўртасидаги ўзаро таъсир кучи.

7) Нанообъектларда турли элементар зарралар (электронлар) ҳаракатининг квант қонуниятлари намоён бўлади. Квант механикаси нуқтаи назаридан олганда, электронни тегишили тўлқин функцияларини вужудга келтирадиган тўлқин деб тасаввур қилиш мумкин. Бу тўлқиннинг қаттиқ жисмдаги тарқалиши квант чегараловчи билан боғлиқ бўлган (тўлқин интерференцияси, потенциал тўсиқлар орқали туннерланиш мумкинлиги) ҳодисалар билан назорат қилинади. Металл материаллар учун элементар заррарчаларнинг тўлқинли табиати томонидан қўйиладиган чекловлар ҳозирча долзарб эмас, чунки, улар учун (электронлар учун) де Бройл тўлқини $\lambda_e < 1$ мм, сони бир неча атомли миқдорларни ташкил этади. П/п да эса электроннинг самарали массаси ва унинг ҳаракат тезлиги шундайки, де Бройл тўлқинининг узунлиги электрони учун 10 ммдан 100 ммгачани ташкил этиши мумкин. Шу билан бирга, шаклланаётган а п/п тузилмаларининг катталиги ушбу ўлчамлар билан баравардир. Замонавий микропроцессорлар (флэш хотира) контактлар ўртасидаги масофа 0.03 мкмдан 30 мкмгача.

8) Нанообъектнинг ўлчами кичрайиб борган сари электронлар энергетик спектрининг дискретизациялашув даражаси ортиб боради. Квант нуқта учун (айнан бир неча атомдан иборат бўлган объект учун) электронлар амалда айрим атом билан бир хил бўлган рухсат этилган энергиялар спектрига эга бўла боради.

2.2. Нанообъектлар таснифи.

Нанообъектнинг катта-кичиклиги – нанообъектларни таснифлашнинг асосидир.

Катта-кичикликка мувофиқ қуйидагилар фарқланади:

1) 0-Д нанообъектлар – уларнинг 3 та макон ўлчамининг ҳаммаси нанометр диапазонида ётади (қўпол қилиб айтганда: 3 ўлчамнинг ҳаммаси < 100 нм).

Бундай объект макроскопик маънода нульмерли бўлади ва шу сабабли, электрон хоссалари нуқтаи назаридан, бундай объектлар квант нуқталар деб аталади. Улардаги де Бройль тўлқини ҳар қандай макон миқдордан катта бўлади. Квант нуқталардан лазер қурилишида, оптоэлектроникада, фотоникада, сенсорикада ва бошқаларда фойдаланилади (расм 9-11).

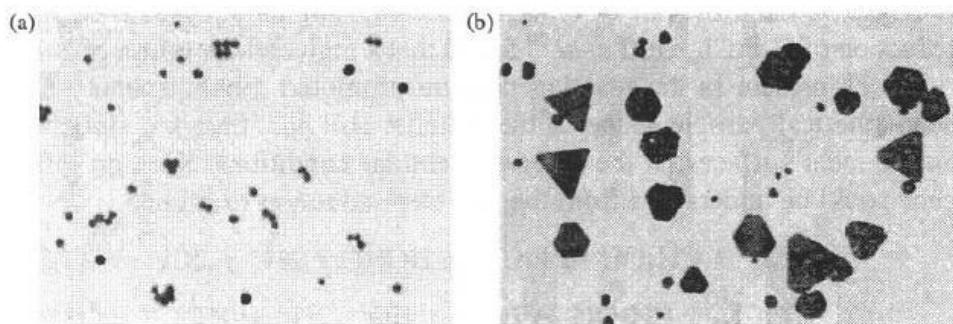


Fig. 3.10. SEM micrographs of gold nanoparticles prepared with sodium citrate (a) and citric acid (b) as reduction reagents, respectively, under otherwise similar synthesis conditions. [W.O. Miligan and R.H. Morris, *J. Am. Chem. Soc.* **86**, 3461 (1964).]

Расм 9. Қайтарувчи сифатида қўлланиладиган натрий цитрати ва лимон кислотасидаги олтин нанозаррачалари¹⁹.

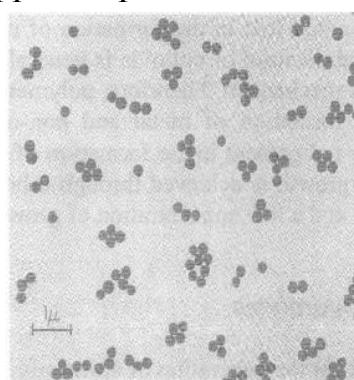


Fig. 3.19. SEM micrograph of silica spheres prepared in the ethanol-ethyl ester system. [W. Stober, A. Fink, and E. Bohn, *J. Colloid Interf. Sci.* **26**, 62 (1968).]

Расм 10. Этанол-эфир мухитидаги кремнезем нанозаррачалари²⁰.

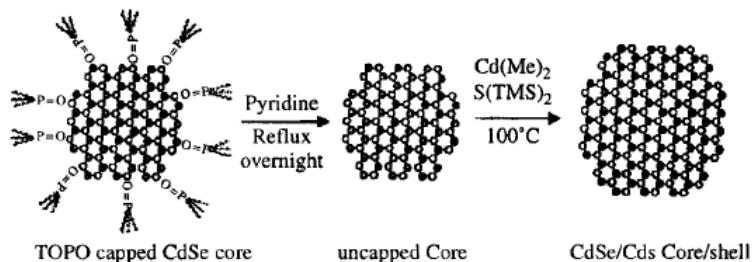


Fig. 3.27. Schematic synthesis of CdSe/CdS core/shell nanocrystals [X. Peng, M.C. Schlamp, A.V. Kadavanich, and A.P. Alivisatos, *J. Am. Chem. Soc.* **119**, 7019 (1997).]

Расм 11. Ядро-қобиқ нанокристалларнинг синтези CdSe/CdS²¹

2) 1-D нанообъектлар – икки ўлчамда нанометрик катталикка, учинчи ўлчамда эса – макроскопик катталикка эга бўлади. Булар жумласига наносимлар, нанотолалар, бир деворли ва кўп деворли наноқувурлар, органик

¹⁹ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 69

²⁰ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 86

²¹ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 104

макромолекулалар, шу жумладан ДНКнинг икки қаватли спираллари киритилади (расм 12-15).

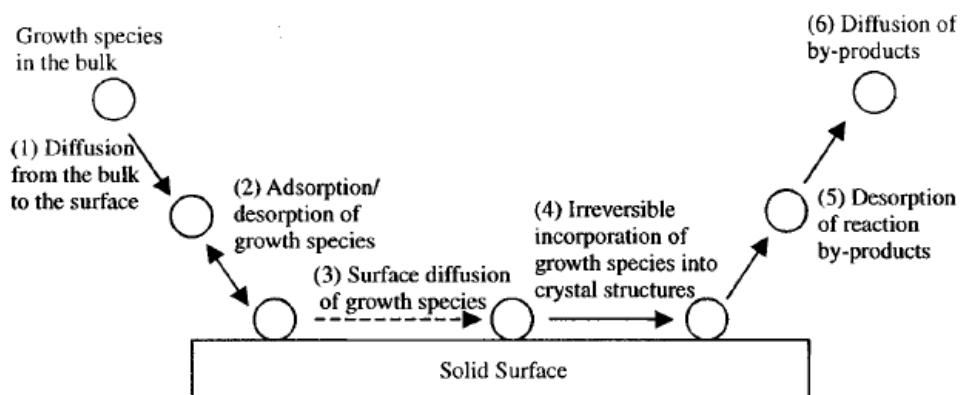


Fig. 4.1. Schematic illustrating six steps in crystal growth, which can be generally considered as a heterogeneous reaction, and a typical crystal growth proceeds following the sequences.

Расм 12. Гетероген реакция бўйича 6-каррали кристалларнинг ўсиш тизими²².

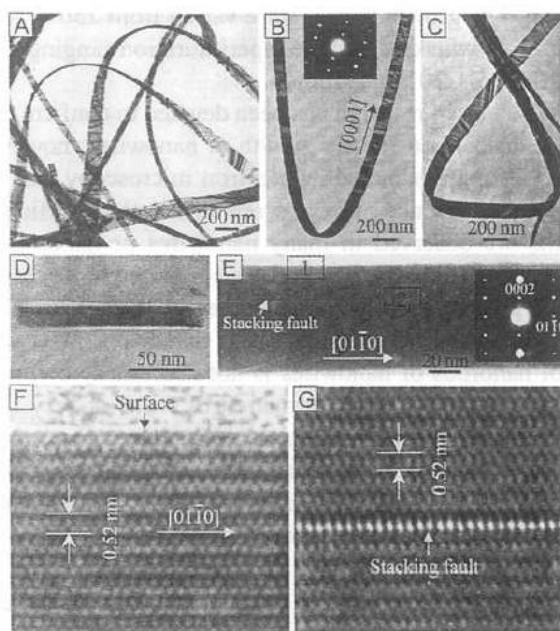


Fig. 4.6. SEM and TEM pictures of ZnO nanobelts [Z.W. Pan, Z.R. Dai, and Z.L. Wang, *Science* 291, 1947 (2001).]

Расм 13. Рух оксиди нанонайчалари учун SEM ва ТЕМ элекtron микротасвирлари²³.

²² Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 113

²³ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 120

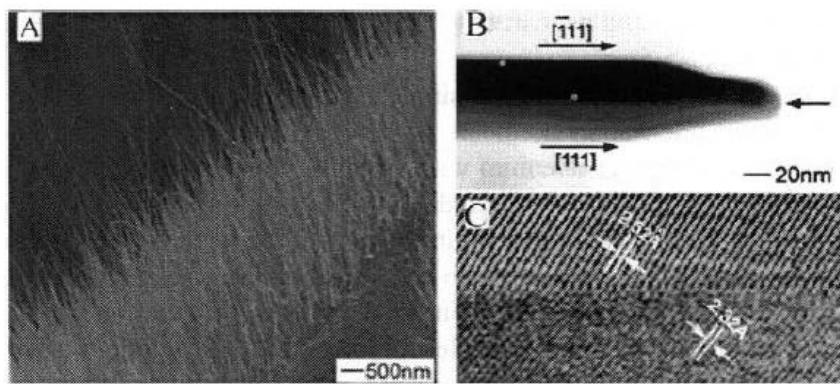


Fig. 4.8. (A) SEM and (B) TEM micrographs of CuO nanowires synthesized by heating a copper wire (0.1 mm in diameter) in air to a temperature of 500°C for 4 hr. Each CuO nanowire was a bicrystal as shown by its electron diffraction pattern and high-resolution TEM characterization (C). [X. Jiang, T. Herricks, and Y. Xia, *Nano Lett.* **2**, 1333 (2002).]

Расм 14. Мис оксиdi наносимлари учун SEM ва TEM электрон микротасвирлари²⁴.

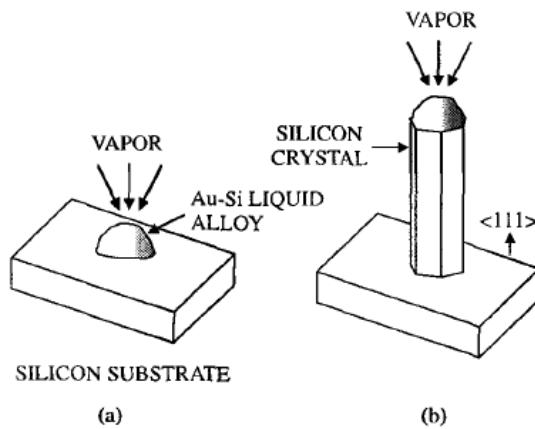


Fig. 4.11. Schematic showing the principal steps of the vapor-liquid-solid growth technique: (a) initial nucleation and (b) continued growth.

Расм 15. Газ-суюқлик-қаттиқ жисм усулининг схемаси: а- бошланғич заррача хосил бўлиши, б- ўсиш²⁵.

3) 2-D нанообъектлар – фақат битта ўлчамда нанометрик катталика эга бўлади, қолган иккита ўлчамда эса бу катталик макроскопик бўлади. Бундай объектлар жумласига бир таркибли материалнинг юзага яқин ингичка қатламлари: пленкалар, қопламалар, мембраналар, кўп қатламли гетеротузилмалар киритилади. Уларнинг квази икки ўлчамлилиги электрон газнинг хоссаларини, электрон ўтишларнинг (р-п ўтишларнинг) хусусиятларини ва шу кабиларни ўзgartириш имконини беради. Айнан 2-D нанообъектлар радиолэлектрониканинг тамомила янги элемент базасини ишлаб

²⁴Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 123

²⁵ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 129

чикиш учун асос ўйлаб топиш имконини беради. Бу энди наноэлектроника, нанооптика ва шу кабилар бўлади (расм 16-19).

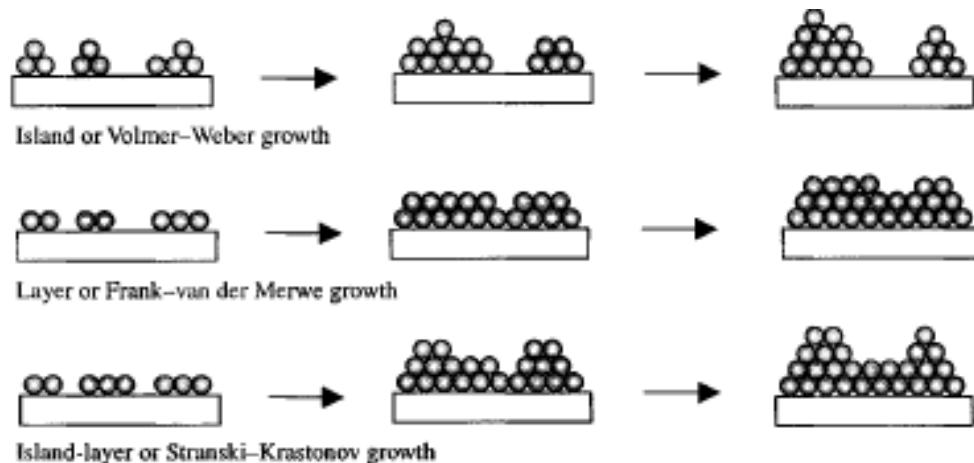


Fig. 5.1. Schematic illustrating three basic modes of initial nucleation in the film growth. Island growth occurs when the growth species are more strongly bonded to each other than to the substrate.

Расм 16. Юпқа пленкаларнинг ўсиш схемаси. Оролчали ўсиш субстрат билан мустахкам боғланган заррачалар учун боради²⁶

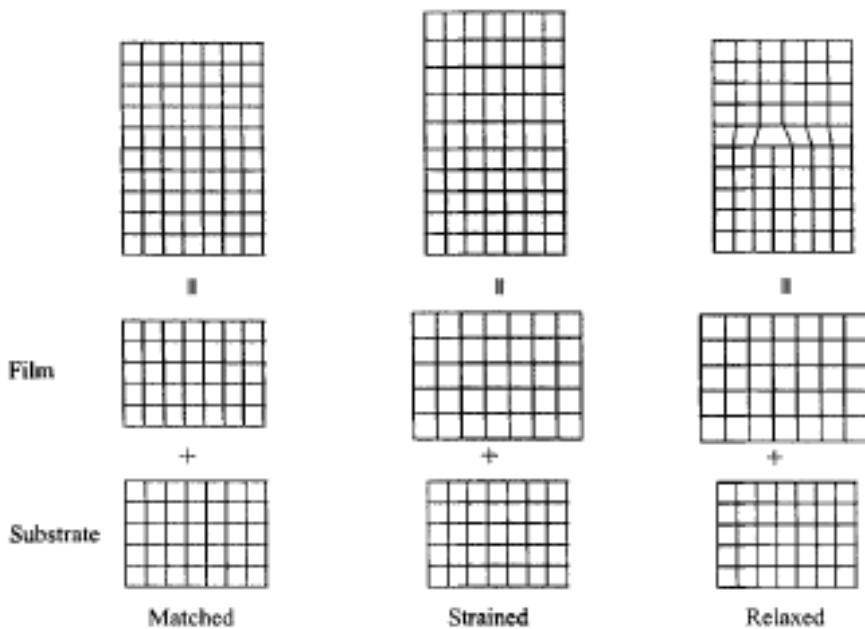


Fig. 5.3. Schematic illustrating the lattice matched homoepitaxial film and substrate, strained and relaxed heteroepitaxial structures.

Расм 17. Гетероэпитаксиал пленкаларнинг стресдаги ва релаксациядаги гомоэпитаксиал пленка ва субстратнинг кристалл панжараси схемаси, Рух оксиди нанонайчалари учун SEM ва TEM электрон микротасвирлари²⁷.

²⁶ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 175

²⁷ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 179

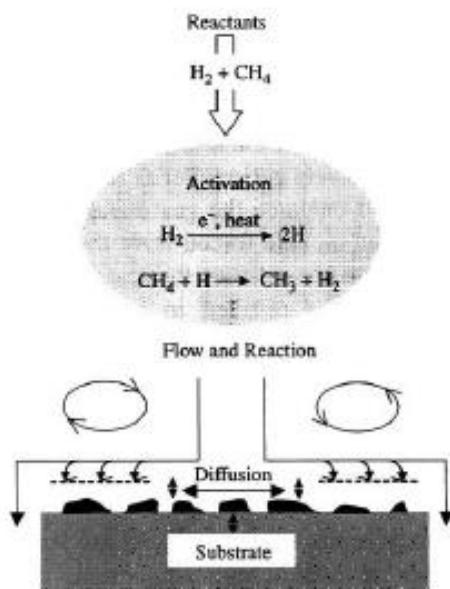


Fig. 5.14. Schematic showing the principal elements in the complex diamond CVD process: flow of reactants into the reactor, activation of the reactants by the thermal and plasma processes, reaction and transport of the species to the growing surface, and surface chemical processes depositing diamond and other forms of carbon. [J.E. Butler and D.G. Goodwin, in *Properties, Growth and Applications of Diamond*, eds. M.H. Nazare and A.J. Neves, INSPEC, London, p. 262, 2001.]

Расм 18. CVD жараёни бўйича наноолмосларни олишнинг принципиал тизими: реагентларнинг реакторга оқими, реагентларни термик жараён еки плазма билан фаолланиши, ўсувчи юзаларга заррачаларнинг ташиб ўтилиши ва реакцияси, олмосларнинг ва углероднинг бошқа шаклларини чўктиришнинг юзадаги кимёвий жараёнлари²⁸.

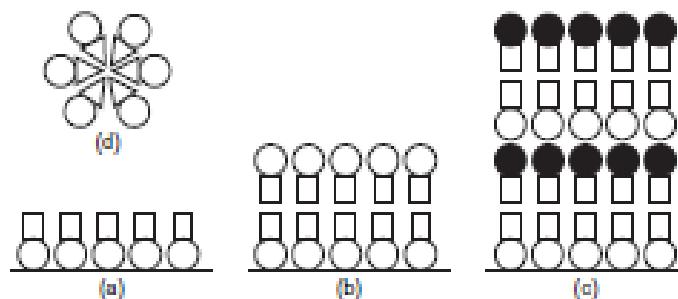


FIGURE 6.6

Langmuir-Blodgett films. (a) A monolayer; (b) a bilayer; (c) a Y-type multilayer. The circles represent the polar heads and the squares the apolar tails of the amphiphilic molecule. (d) A micelle, which can form spontaneously upon dispersal in water if the amphiphilic molecules have a smaller tail than the head (see Section 8.2.9).

Расм 19. Ленгмюр-Блоджет пленкаларини олиш. Моноқават, биқават, у-мултиқават. Агарда «tail» «head»дан кичик бўлса поляр амфи菲尔 молекулалар ўз-ўзидан мицеллалар хосил қиласди²⁹

²⁸ Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 198

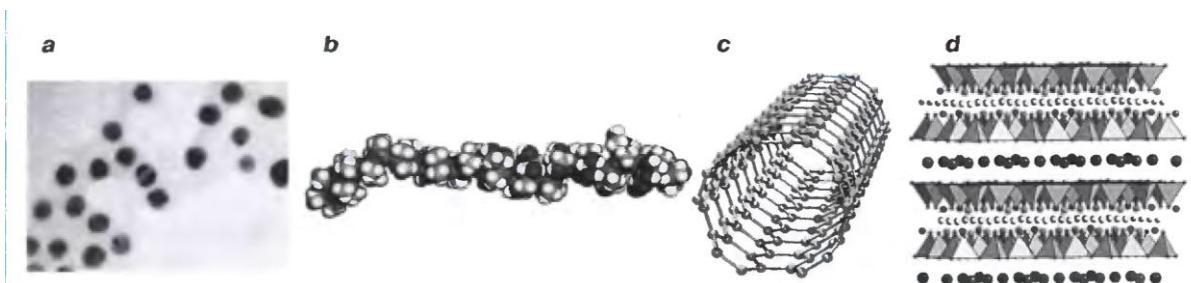
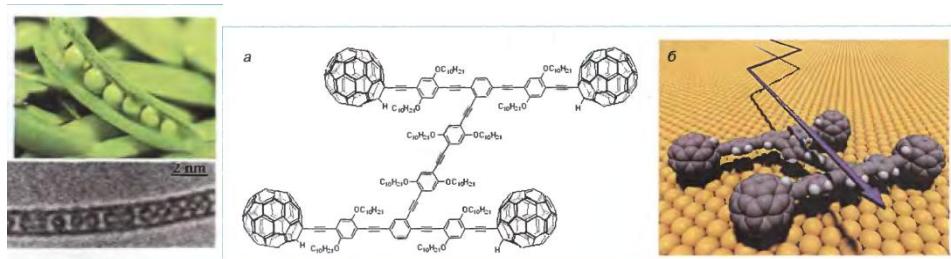
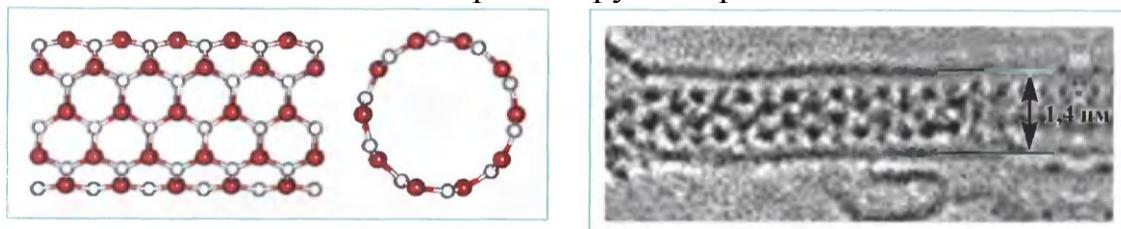
²⁹ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 110

Хозирги вақтда 2-Д нанообъектлар ҳаммадан күпроқ хилма-хил антифразион, антикоррозион ва ҳоказо қолпамалар сифатида хизмат қилмоқда. Улар молекуляр фильтрлар, сорбентлр ва шу кабиларда турли хил мембраналар яратиш учун ҳам катта аҳамиятга эга.

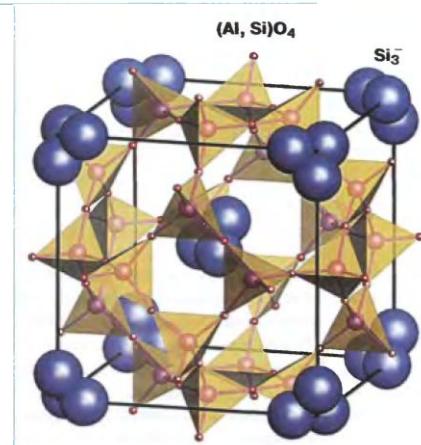
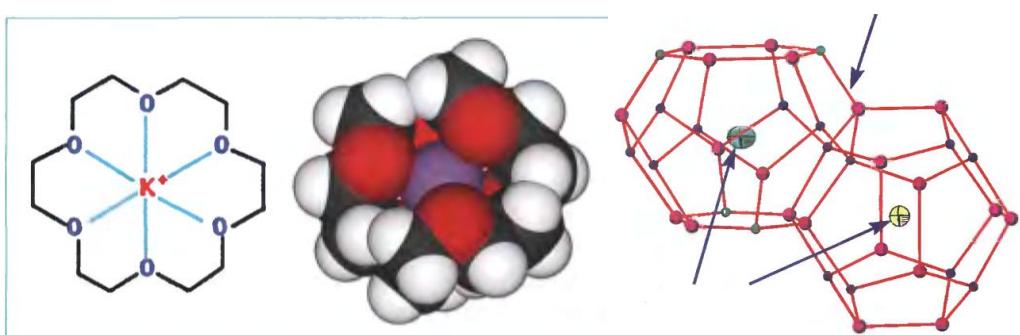
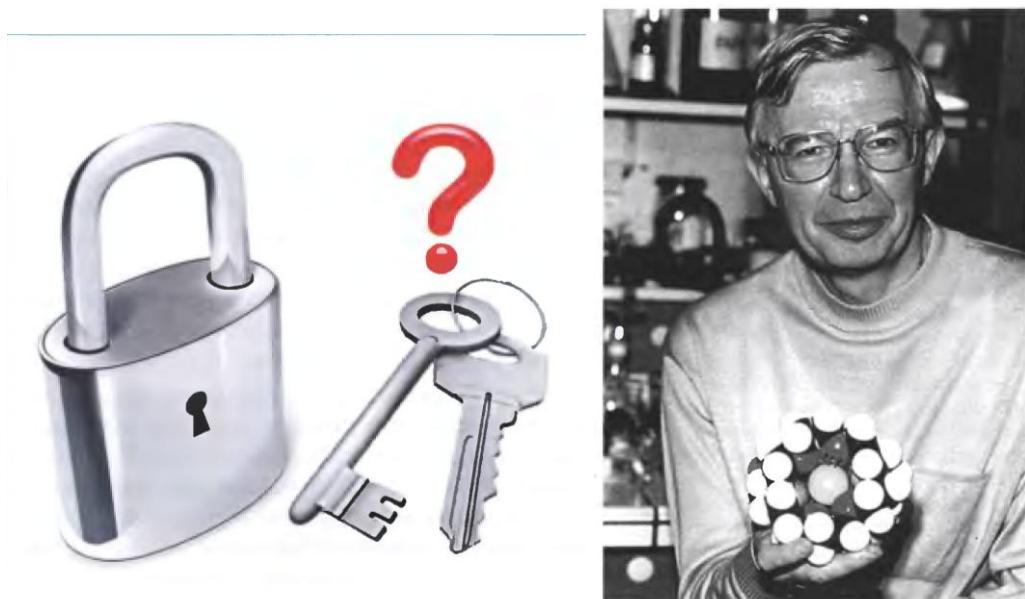
Фуллеренлар.



Углеродли трубкалар.

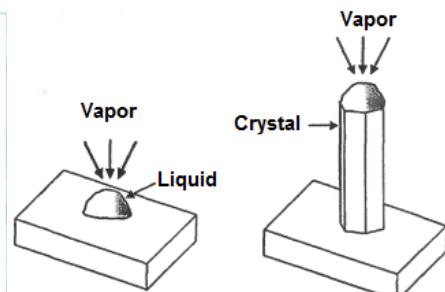
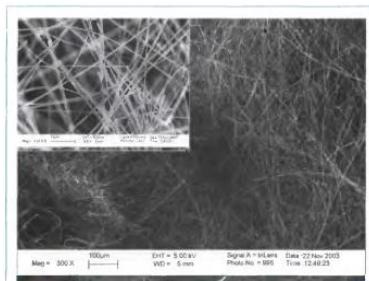


Супрамолекуляр кимё.

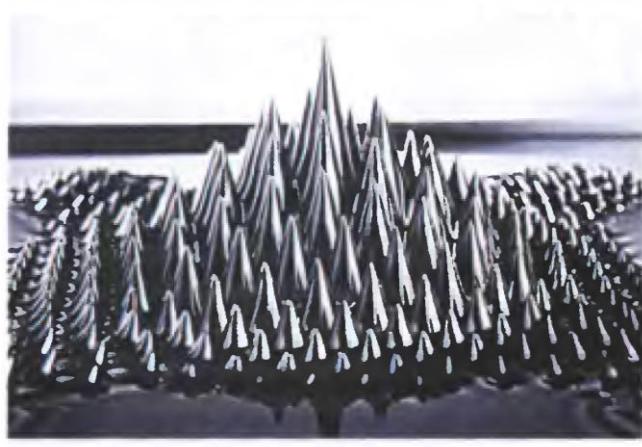


Ноорганик наноматериаллар.

Вискерлар.



Манганилар³⁰.

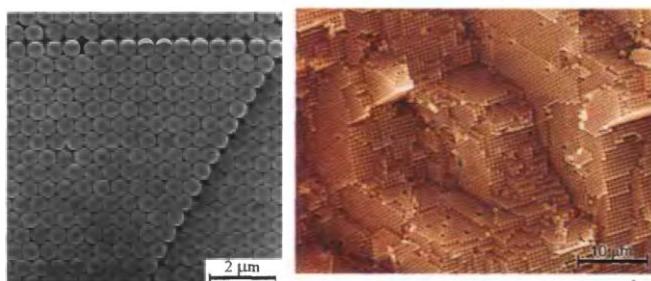


in
d
he
in apple is
which has
his fruit.

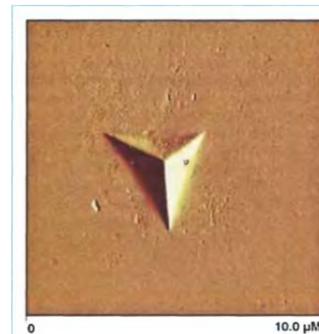
Magnetotacticum bavaricum. Magnetic bacteria can synthesise chains of nano-magnetics and be used as a compass needle.

Юкорихароратли ўтаўтказгичлар.
Фотон кристаллари (3D структура)

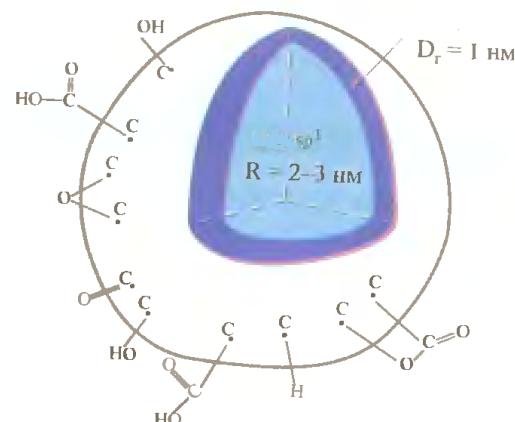
³⁰ European Commission EUR 21151, Nanotechnology : Innovation for tomorrow world, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004, 56.



Биокерамика.



Наноолмослар.



Газли гидратлар. Газлардаги кластерлар.



Назорат саволлари

1. Нанозаррачалар ва нанокластерлар деб нимага айтилади?
2. 0-D нанообъектларга мисол келтириинг.
3. 1-D нанообъектларга мисол келтириинг.
4. 2-D нанообъектларга мисол келтириинг.

5. Фуллеренлар ва углеродли трубкаларнинг кандай турларини биласиз.
6. Супрамолекуляр моддаларга мисол келтиринг.
7. Ноорганик наноматериалларнинг кандай турларини биласиз?

Фойдаланилган адабиётлар

1. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 19.
2. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 38.
3. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 22.
4. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 20.
5. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 20.
6. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 22.
7. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 57.
8. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 69.
9. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 86.
10. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 104.
11. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 113.
12. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 120.
13. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 123.
14. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 129.
15. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 175.
16. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 179.
17. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 198
18. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 110.
19. European Commission EUR 21151, Nanotechnology: Innovation for tomorrow world, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004, 56.

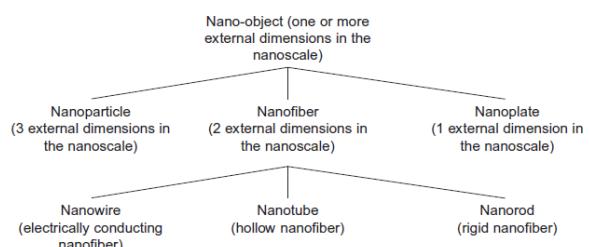
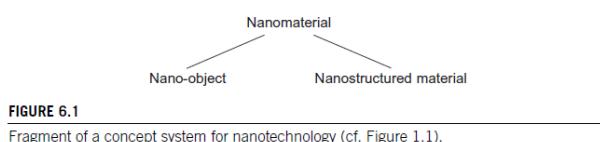
3-мавзу: Наноструктурулган материалларни синтез усуллари Режа:

- 3.1. Нанозарралар, нанокукунларни синтез қилиш усуллари
- 3.2. 0-D нанообъектлар
- 3.3. 1-D нанообъектлар
- 3.4. Углеродсиз нанотрубкалар

Таянч иборалар: CVD, PVD, нанокукунлари, газфазали синтез, буғларнинг конденсацияси, . плазмакимёвий синтез, лазерли аблация.

3.1. Нанозарралар, нанокукунларни синтез қилиш усуллари

Хозирги пайтда маълум бўлган наноматериаллар замонавий технологияларга фан ва техниканинг турли соҳаларидан кириб келганлигини ҳисобга олганда, бирон-бир асосда мақбул бўлган ягона таснифнинг ўзи йўқ (расм 1-2).



Расм 1. Нанообъектларнинг концептуал тизими³¹

Table 6.1 The ontology of nanodispersions

Matrix	State of the nano-objects		
	Solid	Liquid	Gaseous
Solid	Nanocomposite ^a	–	Nanofoam ^b
Liquid	Nanosuspension ^c	Nanoemulsion	Nanofoam ^b
Gaseous	Aerosol	Aerosol	–

^aOther materials falling into this category are nano-alloys, metal-matrix composites, etc.

^bThese materials may be described with the adjective "nanoporous" (or, in French, using the noun "nanoporeux").

^cNanofluids are included here (Section 6.5.4).

Расм 2. Нанодисперсияларнинг онтологияси³²

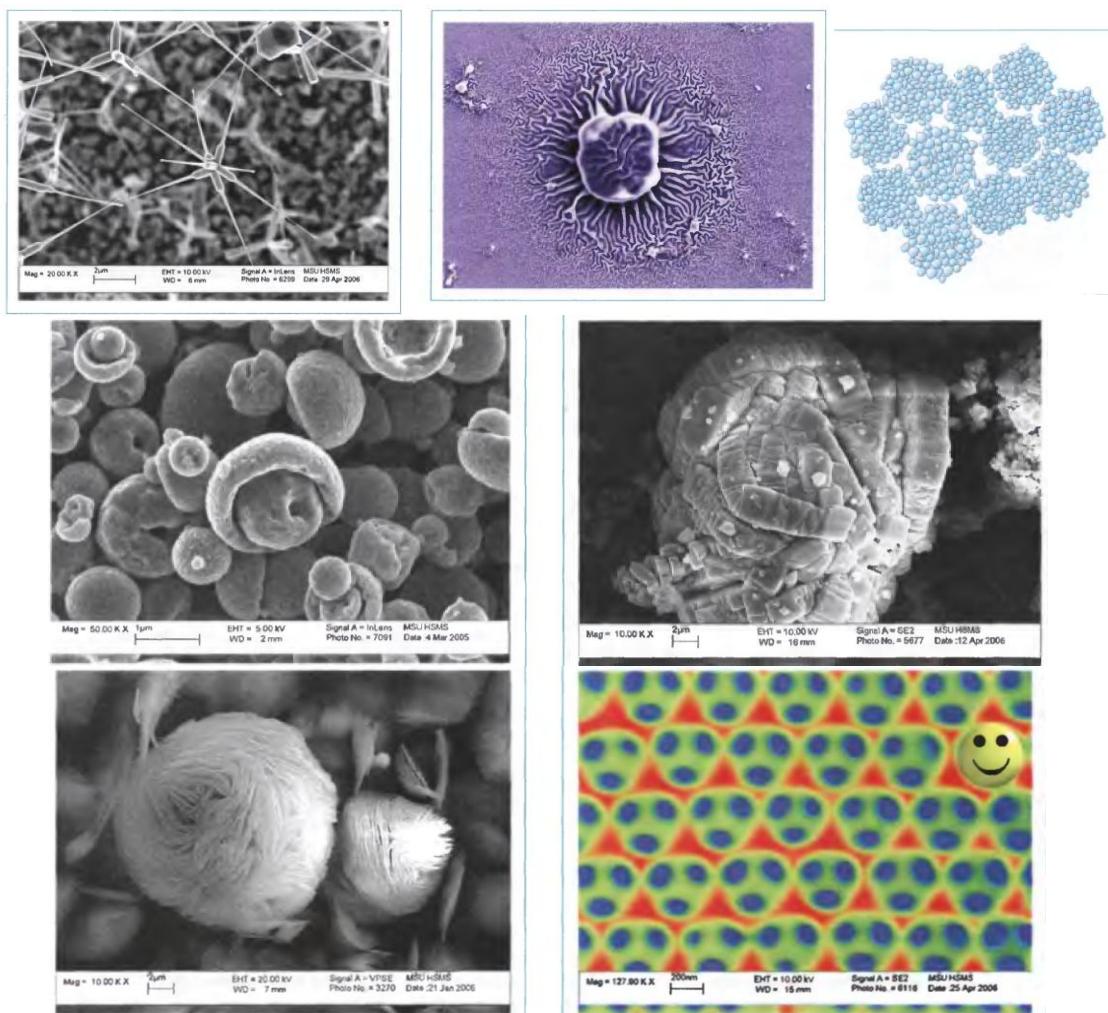
Наноматериаллар:

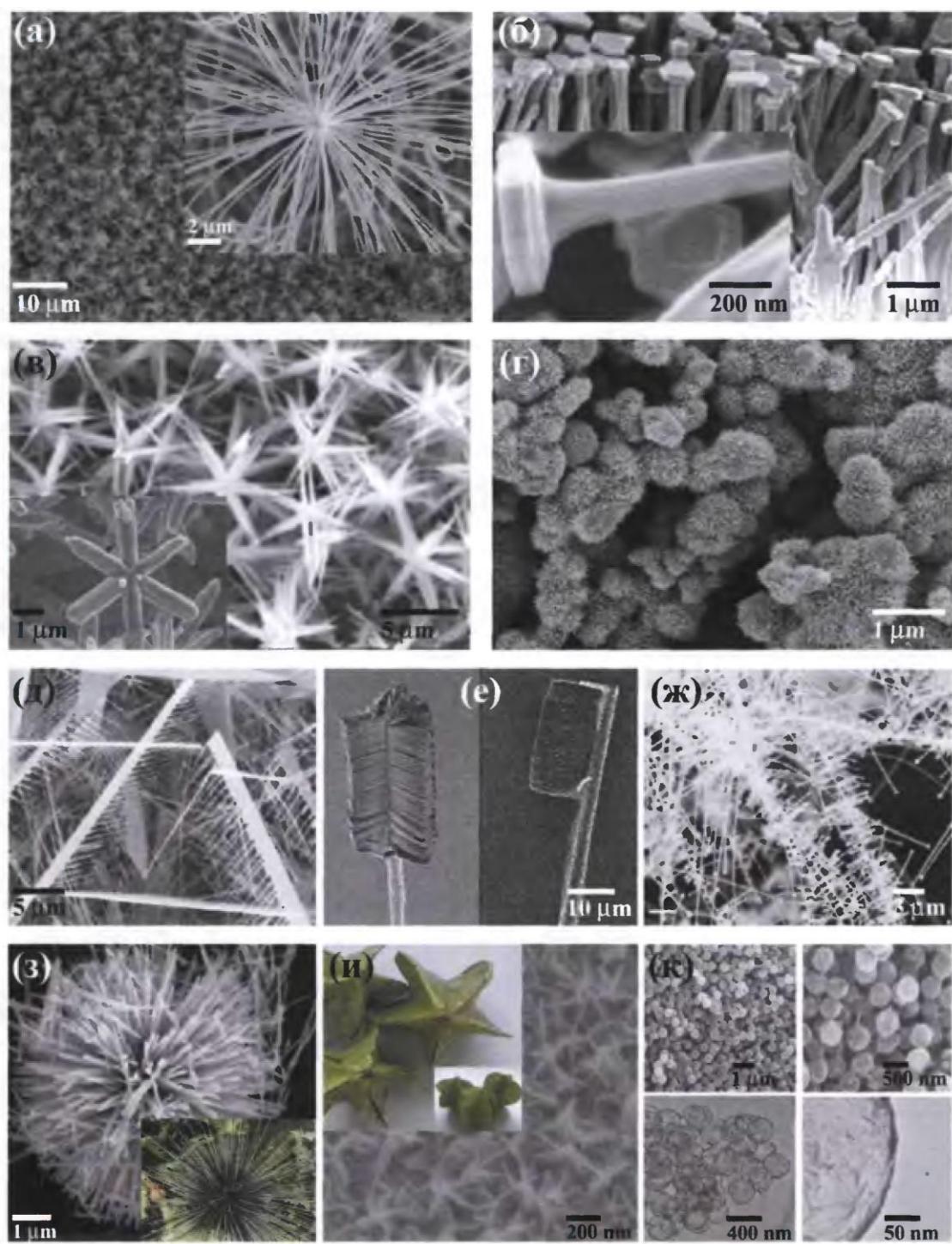
-Катта ҳажмли нанотаркиблашган материаллар;

³¹ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 102

³² Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 103

- Нанокластерлар, нанозарралар, нанокукунлар;
- Кўп қатламли нанопленкалар, кўп қатламли нанотузилмалар, кўп қатламли наноқопламалар;
- Функционал (ақлли) наноматериаллар;
- Наноғовакли материаллар;
- Фуллеренлар ва уларнинг ҳосилалари бўлган наноқувурлар;
- Биологик ва биобирлашган материаллар;
- Нанотаркибли суюкликлар: коллоидлар, геллар, суспензиялар, полимер композитлар;
- Нанокомпозитлар.





Расм 3. Наноструктурасининг хар хил шакллари

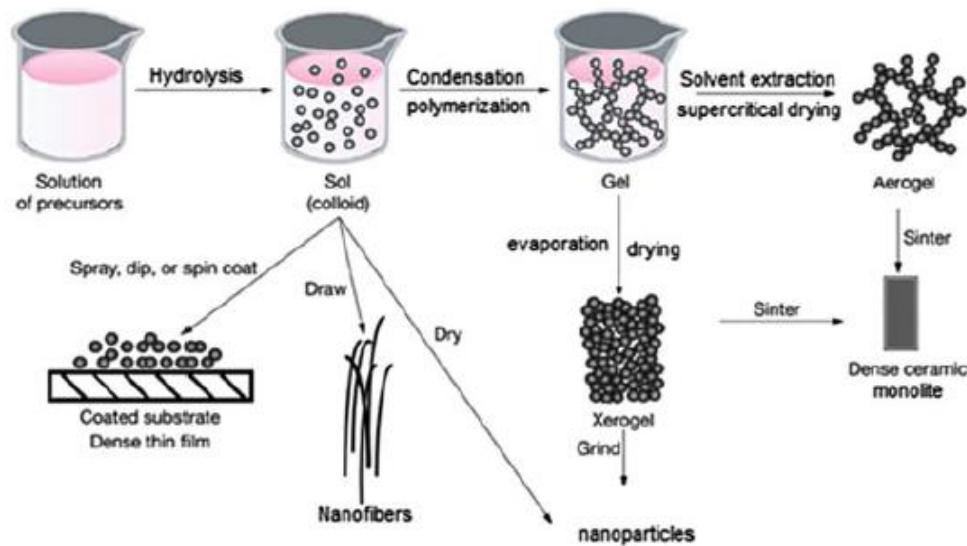


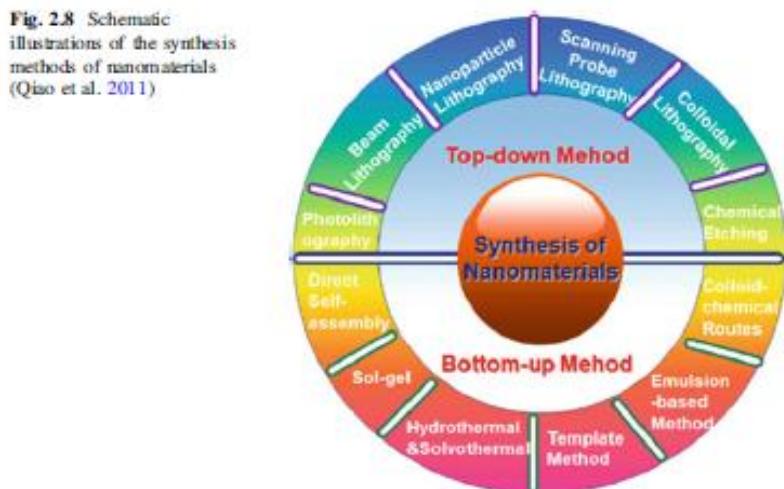
Fig. 2.10 Schematic diagram of sol-gel method and its nanomaterials products

Расм 4. “Зол-гел” жараён³³

Дастлабки нанозарралар одам томонидан атайлаб эмаси, тасодифан, турли технологик жараёнларда яратылған. Ҳозирги вақтда улар яратыладын ва маҳсус ишлаб чиқарыладын бўлди, бу эса нанотехнологияларга асос солди. Нанотехнологияларнинг ривожланиши айrim фундаментал принципларнинг тубдан қайта кўриб чиқилишига олиб келди. (Расм 3-4).

“Юқоридан-пастга” йўли – нанотехнологияларнинг умумий парадигмаси (яrim маҳсулотдан (танавордан) ортиқча қисмлар кесиб ташланади)

Нанотехнологиялар “пастдан- юқорига” – кичикдан каттага (атомдан объектга) йўлини таклиф қилади. Бу нанотехнологиялар парадигмасидир.



Расм 5. “Юқоридан-пастга” ва “Пастдан-юқорига” методлар³⁴

³³ Said Salaheldeen Elnashaie, Firoozeh Danafar, Hassan Hashemipour Rafsanjani Nanotechnology for Chemical Engineers, Springer, 2015, 99

³⁴ Said Salaheldeen Elnashaie, Firoozeh Danafar, Hassan Hashemipour Rafsanjani Nanotechnology for Chemical Engineers, Springer, 2015, 95

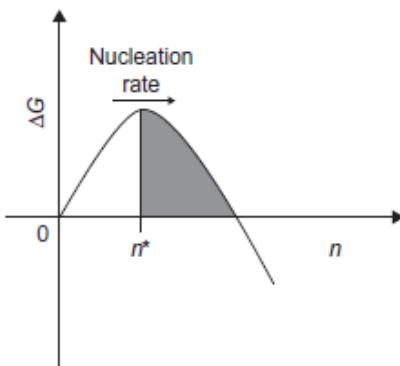


FIGURE 6.3

Sketch of the variation of free energy of a cluster containing n atoms (cf. Figure 2.2). The maximum corresponds to the critical nucleus size. Clusters that have managed through fluctuations to climb up the free energy slope to reach the critical nucleus size have an equal probability to shrink back and vanish, or to grow up to microscopic size.

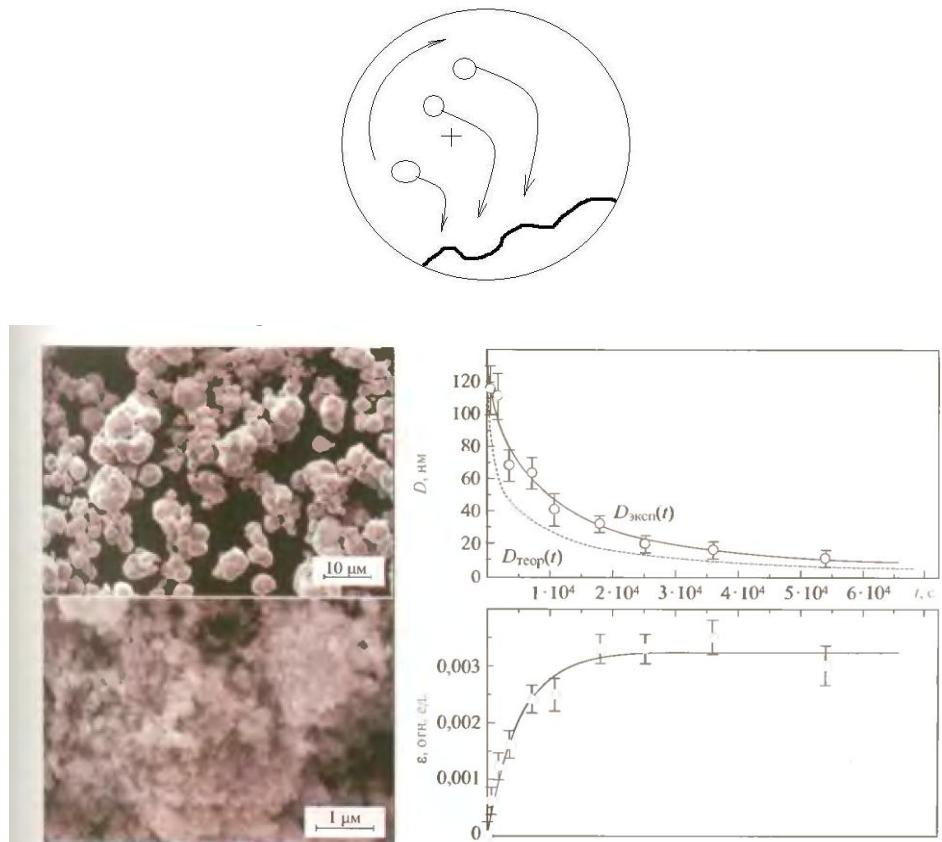
Расм 6. Расм. n -атомлардан ташкил этиувчи кластернинг эркин энергиясини ўзгариши. Ядронинг критик ўлчамига максимал равишда мос келади³⁵.

3.2. 0-Д нанообъектлар

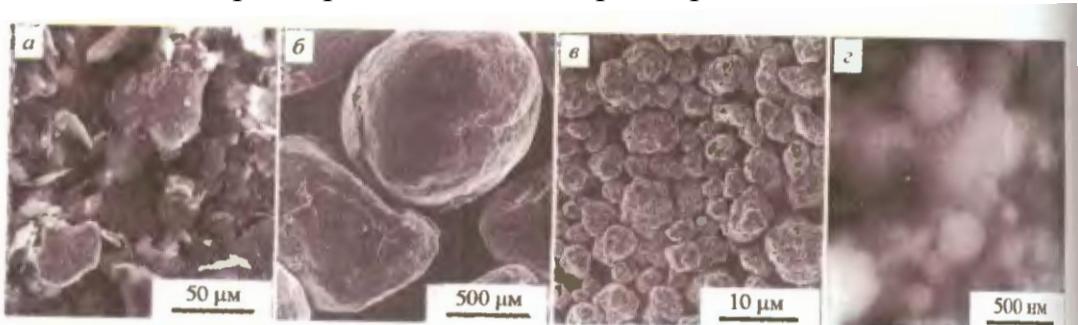
Хозирги вақтда асосан нанотехнологияларда бизга макротехнологиялардан ўтган технологик усуллар устунлик қилмоқда. 0-Д тоифасига мансуб нанозарраларни яратиш учун ҳозирги нанотехнологиялар дисперсиялаш, яъни майдалаш усулини қўлламоқда. Ҳар қандай микроскопик объектни наноўлчамларгача майдалаш (дисперсиялаш) учун оддий дисперсиялаш тўғри келмайди. Зарралар қанча майда бўлса, улар юзасининг фаоллиги шунча юқори бўлади, натижада алоҳида зарралар катта ҳажмли конгломератларга бирлашади. Шу сабабли ўта ингичка дисперсиялаш учун юзадаги таранглик кучларини камайтирадиган юзаки фаол моддалар, шунингдек стабилизаторлар тарзидаги муайян турдаги муҳитни, такroran қўшилишга тўсқинлик қиласиган совен тарзидаги композицияларни қўлланиш талаб қилинади. Қаттиқ жисм чегарасида юзаки энергия жуда ҳам пасайган муайян шароитларда дисперсланиш жараёни ўз-ўзидан, масалан, зарраларнинг иссиқлик ҳаракати ҳисобидан юз бериши мумкин. Ана шу усуллр билан зарралар катталиги ўнлаб нм бўлган Мечкуунларини, ушбу металларнинг зарралар катталиги 1 нм бўлган оксидларини олиш, шунингдек полимерлар, керамика компонентлари в шу кабиларнинг дисперсияланишини амалга ошириш мумкин.

1) Майдалаш усуллари: шарли тегирмон, тебранма тегирмон, аттрикторлар, пуркама тегирмонлар (расм 5-6)

³⁵ Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 105

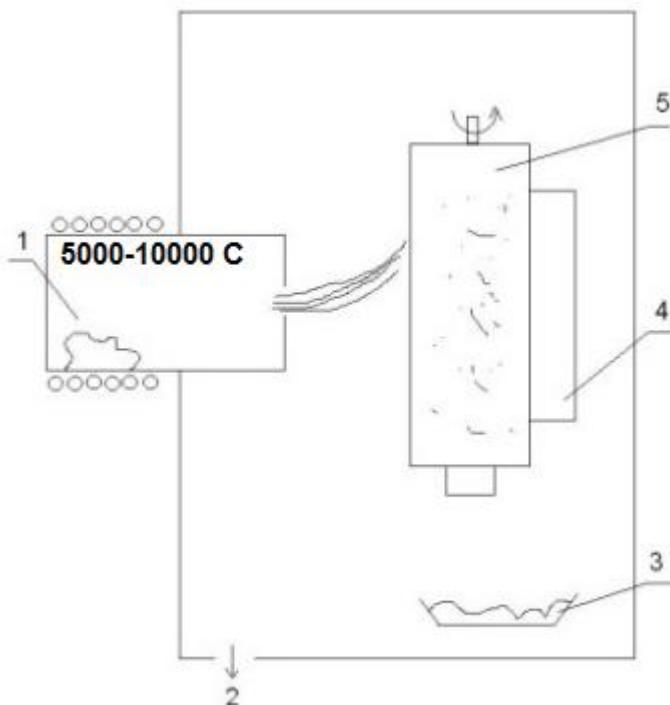


Расм 7. Вольфрам кадбиднинг нанокукунлари (50 нм). Механокимёвий синтеза - 10 соат, D - размер частиц, ε – микронапряжения, t - соат



Расм 8. Титан кадбиднинг нанокукунлари (2-100 нм). Механокимёвий синтез.

2) Дисперсиялашдан ташқари иккита чекланган парадигманинг кўшилишидан иборат бўлган жараёндан кенг фойдаланилади. Бу жараён қаттиқ модданинг буғланиб, шундай кейин турли шароитларда конденсациялашувчиidan иборат. Масалан, совутилган инерт газ мухитида 5000 – 10000 С даражасигача қиздирилган модда буғини конденсациялаб, ҳосил бўлган кукунни конденсация зонасидан тезда чиқариб ташлаш. Шу йўл билан зарралар катталиги 3 – 5 нм бўлган кукунларни олиш мумкин.

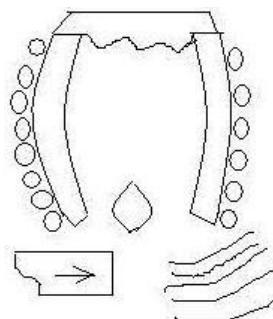


Расм 9. Наноматериалларни олиш қурилмаси

1 – Бугланыётган модда манбаи; 2 – чиқариб ташлаш; 3 – Кукун;
4 – Куракча; 5 – Конденсация барабани

3) Учинчи усул ҳам анъанавий дисперсиялашга алоқадор бўлиб, эритилган моддани совутилган газ ёки суюқлик оқимида пуркаш деб аталади.

Томчини майдалайдиган оқимнинг газ муҳити сифатида, суюқлик сифатида эса спиртлар, сув, ацетон хизмат қилиши мумкин. Шундай усул билан катталиги 100 нмга яқин бўлган зарраларни олиш мумкин.



Таърифланган усулларнинг ҳаммаси жуда унумли, бироқ қоида тариқасида улар кукуннинг ультрадисперлигини, зарраларнинг каттилиги бир бўлишини таъминламайди, ҳамда жараённинг тозалигини таъминламайди. Булар нанозарраларни шакллантиришнинг маълум бўлган бирдан-бир усуллари эмас. 0-D нанообъектлар жумласига ультрадисперс кукунлардан ташқари фуллеренларни, углеродли 0-D нанообъектларни ҳам киритадилар.

3.3. 1-D нанообъектлар

Айтиб ўтилган нанообъектларнинг ҳар бири техниканинг турли соҳаларида қўлланилади. Масалан, наносимлардан субмикрон ва наноэлектрон узелларда ўтказувчилар сифатида фойдаланишни таклиф қиласидилар. Нанотолалар нанотаркиблаштирилган нанокомпозицион п/пда элемент сифатида қўлланилади. Органик наномолекулалар ҳам тиббиётда, кимё саноатида нанотаркиблаштирилган материаллар яратишида қўлланилади.

Электроника учун нанотрубкалар каби 1-Д нанообъектлар жуда муҳим аҳамият касб этди. Умуман олганда ҳамма нанотрубкалар 2 та катта тоифага бўлинади:

- 1) Углеродли нанотрубкалар (УНТ)
- 2) Углеродсиз нанотрубкалар.

Бундан ташқари ҳамма нанотрубкалар қатламларнинг сони бўйича ажралиб туради: бир қатламли, икки қатламли, кўп қатламли.

3.4. Углеродсиз нанотрубкалар

Ҳамма углеродсиз нанотрубкалар икки туркумга бўлинади:

- 1) Таркибига углерод кирадиган ўткинчи нанотузилмалар
- 2) Дихалькогенид нанотрубкалар. Ҳозирги вақтда дихалькогенид трубкалардн MoS_2 , WS_2 , WSe_2 , MoTe_2 ва бошқалар маълум. Бундай нанотрубкалар ўта юпқа, идеал ҳолатда – мноатомли қатламлар, ўрам қилиб ўралган материаллардир.



Баъзи қатламли материаллар кимёвий алоқалар ассимметрик бўлганлиги туфайли бундай ўрамларга мустақил равишида анча осон ўралади, шу билан бирга бундай тузилмаларни шакллантиришдаги бирдан-бир муаммо - эркин, ҳеч нарса билан боғланмаган атом катталигидаги модда қатламини олишдан иборат. Бошқа материаллар ўз-ўзидан ўралиб қолишига мойил бўлмайди ва шу сабабли ҳозирги вақтда нанотрубкаларни мажбуран шакллантириш имконини берадиган технология усуллари ишлаб чиқилмоқда. Бундай жараёнларнинг 3 та варианти бор:

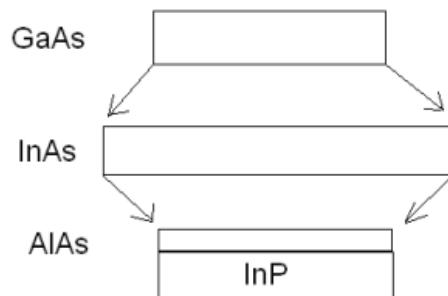
- 1) Мавжуд бўлган нанотрубка асосида нанотрубка яратмоқчи бўлаётганимиз материалнинг юпқа қатламларини гетероэпитаксиал ошириб бориш. Мисол $\text{GaN} - \text{ZnO}$.

Бу усулнинг асосий камчилиги шундаки, гетероэпитаксиал ошириб бориш учун иккита материални танлаш қийин.

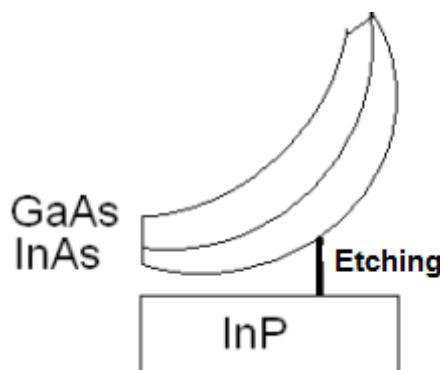
2) Бошлангич наносимни электрон нур билан изчил равища камайтириб бориш йўли билан олинган бир деворли нанотрубкалар. Мисол: Олтин ва платина нанотрубкалар. D Pt нанотрубкалар - 0,48 нм.

3) Қалинлиги бир неча монокатлам бўлган юпқа, тифиз гетероэпитаксиал тузилмани ясси тагликда етиштириб, шундан кейин бу гетеротузилмани таглик билан алоқадан бўшатишга ва ўрам, тугун қилиб ўрашга асосланган. 1ML – битта монокатлам.

Ўраш жараёни атомлар ўртасидаги кучларнинг тифиз гетеропленкада ҳаракатланиши ҳисобига юз беради.



Inda гетероэпитаксия усулида у билан яхши мослашадиган AlAs етиштирилади, сўнгра бу тузилмага ГЭ усулида AsIn ўстирилади. У AlAsга қараганда кўпроқ кристалл панжара параметрларига эга ва шу сабабли бу қатлам ўстирилганда у гўё сиқилади. Шундан кейин ушбу қатламга яна ГЭ усули билан GaAs қатлами ўстирилади. Лекин, AsInдан фарқли ўлароқ бу қатлам кристалл панжара параметрига камроқ эга (элементар катак катталиги камроқ) ва уни, аксинча, чўзади. Натижада, AsAl қатламини бўшата бошлаганимизда бўшаган InAs тузилмаси AsGa билан бирга InAs кенгайтирадиган, GaAs қатлами эса тортадиган кучлар ҳисобига ўрам қилиб ўрай бошлади.



Усулнинг яхши жиҳатлари:

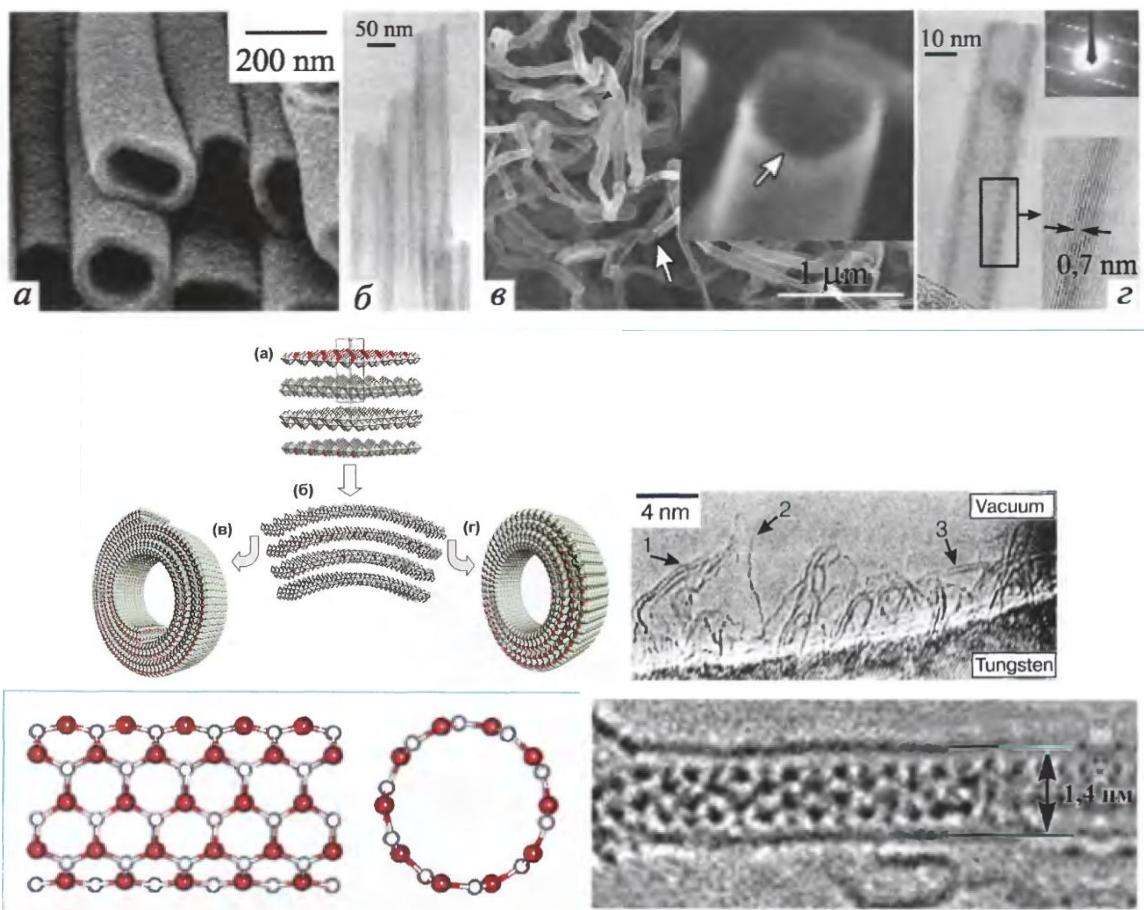
1) Трубкалар диаметри ҳар хил бўлиб, гетеротузилма учун тегишли материалларни тўплаш йўли билн осонгина белгиланиши мумкин.

2) Бу усул деярли ҳар қандай материаллардан (п/п, Ме, диэлектриклар) фойдаланиш ҳамда уларнинг ҳаммасини нанотрубкалар қилиб ўраш имконини беради.

3) Деворларининг қалинлиги бир хил бўлган трубкалар сифати яхшилиги ва нисбатан катта узунликка эгалиги.

4) Бу усул ИМС интеграл микросхемалар технологиялари билан яхши мослашади.

5) Бундай нанотрубкаларнинг физикавий хоссалари бошланғич гетеротузилма материаллари билан белгиланади (расм 7).



Расм 10. Нанонайчалари

Назорат саволлари

1. “Юқори-пастга” технологиясига мисол келтиринг.
2. “Пастдан-юқорига” технологиясига мисол келтиринг.
3. “Зол-гел” жараёнини тушунтиринг
4. Нанозарралар, нанокуунлар, нанодисперсия ни синтез қилиш усуллари
5. 0-D нанообъектлар ва 1-D нанообъектлар деб нимага айтилади
6. Углеродсиз нанотрубкаларнинг қандай турларни биласиз?

Фойдаланилган адабитлар

1. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 102.
2. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 103.
3. Said Salaheldeen Elnashaie, Firoozeh Danafar, Hassan Hashemipour Rafsanjani Nanotechnology for Chemical Engineers, Springer, 2015, 99.
4. Said Salaheldeen Elnashaie, Firoozeh Danafar, Hassan Hashemipour Rafsanjani Nanotechnology for Chemical Engineers, Springer, 2015, 95.
5. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 105.

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

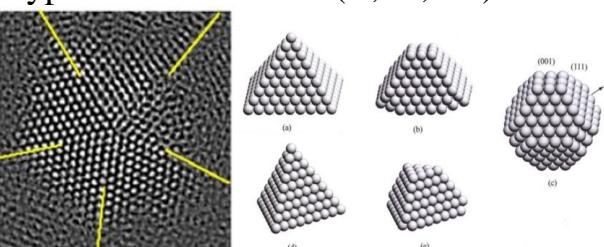
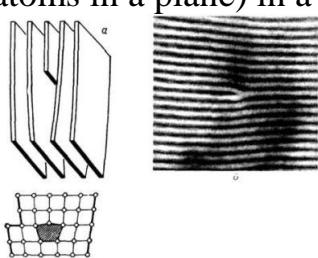
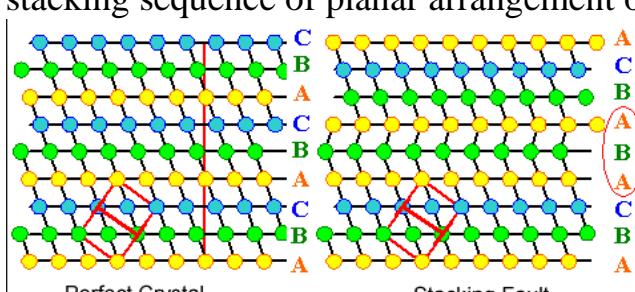
1-амалий машғулот: Кристалл наносистемалар ва уларни аҳамияти. Нанотехнология ва электроника.

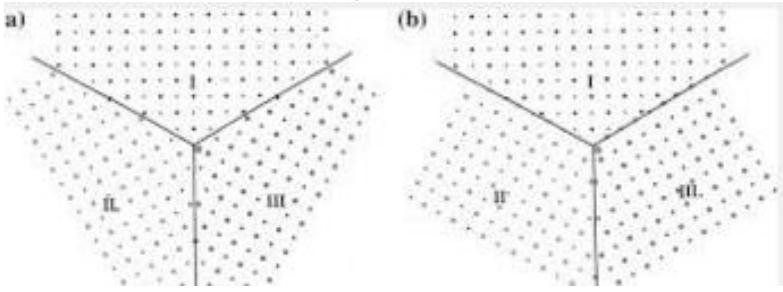
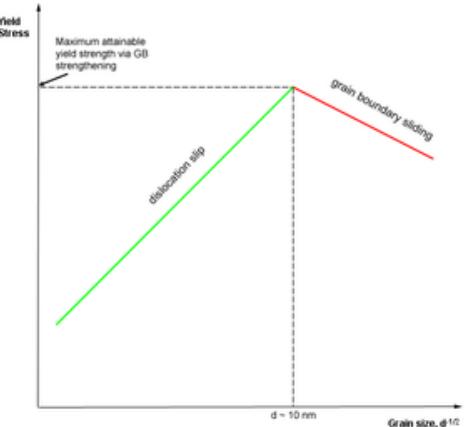
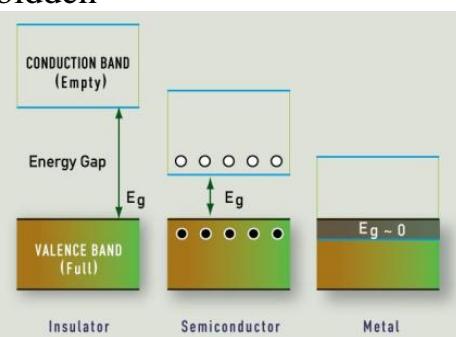
Ишдан мақсад:

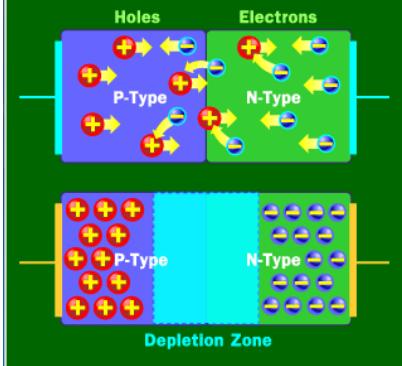
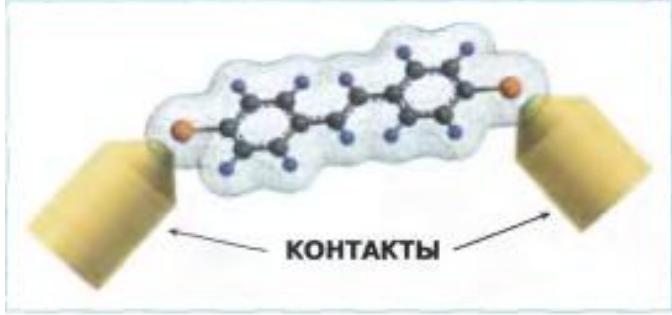
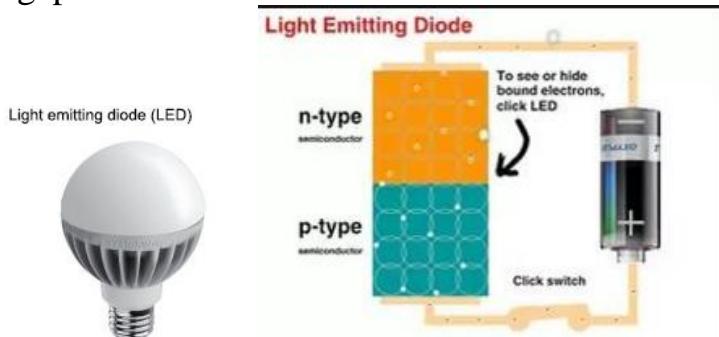
Заррачаларнинг чегараси. Заррачалар чегарасининг миграцияси. Мултиплет иккиламчи заррачалар. Дислокация. Жойлашиш дефектлари. Уч каррали тугун. Холл-Петч қонуни. Тақиқланган чегаранинг кенглиги. Холилаштирилган худуд.

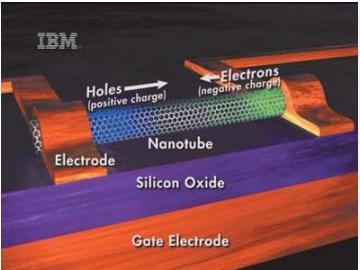
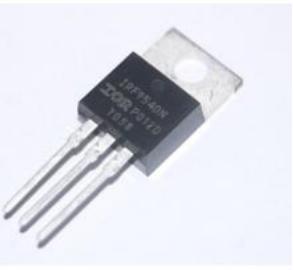
Молекуляр электроника. Ёруғлик диоди (LED). Майдон эффектли транзистор (FET). Юпқа пленкали транзисторлар (TFT). Бир электронли транзистор (SET). Заряд боғланишли қурилма (CCD). Комплементар металоксидли ярим ўтказгич (CMOS). Гигантмагнит қаршилиги (GMR). Оптоэлектроника. Фотолюминесценция. Фотон кристаллар. Фотоника. Юзаплазмон. Пъезорезистив эффект. Спинtronика (спин асосидаги электроника). Кубит. Квант компьютерлар.

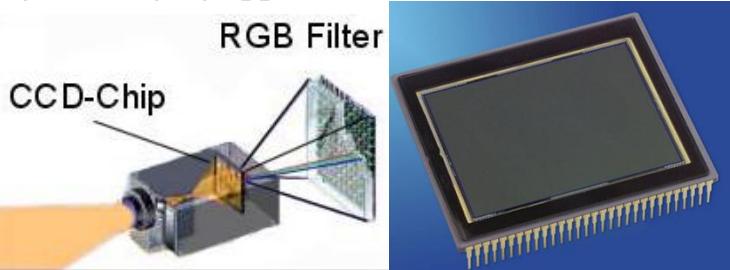
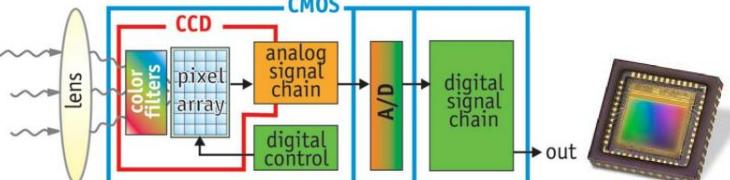
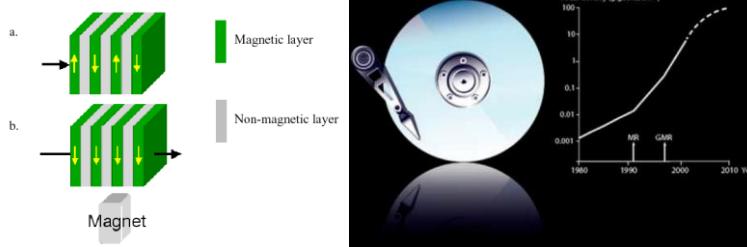
№	Ишни бажариш учун намуна	Масаланинг кўйилиши
1.	<p>Grain boundary: a 2D defect, the interface bordering two well-defined crystals</p> <p>Заррачаларнинг чегараси: 2D-дефект, аниқ аниқланган иккита чегараланувчи кристалларнинг интерфейси</p>	<p>Заррачалар чегарасининг асосий принципини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>
2.	<p>Grain boundary migration: coordinated movement of grain boundaries activated either thermally or by mechanical stress</p> <p>Заррачалар чегарасининг миграцияси: термик ёки</p>	<p>Заррачалар чегарасининг миграциясини асосий принципини тушунтиринг?</p>

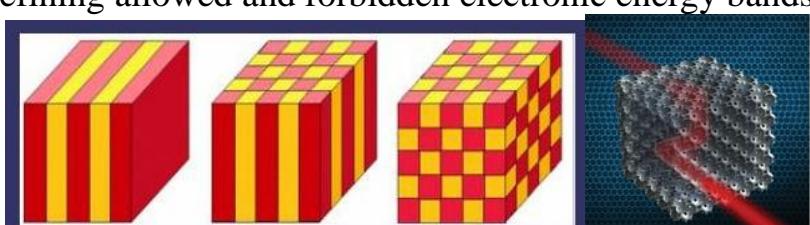
	механик кучланиш йўли ёрдамида фаоллаштирилган заррачалар чегараларининг келишилган харакати	
3.	<p>Multiply twinned particles (MTP): observed frequently with a pseudo five-fold symmetry in nanocrystalline particles and thin films (deposited on crystalline substrates) of cubic face-centred metals, diamond-type semiconductors (C, Si, Ge) and alloys</p>  <p>Мултиплет иккиламчи заррачалар (МТР): олмос (C, Si, Ge) ва қотишмалар типидаги яrimўтказгичлардан, кубсимон ёқларимарказлаштирилган металлардан олинган юпқа пленкалар (кристалл тагликларда чўқтирилган) ва нанокристалл заррачалардаги бешинчи тартибли псевдосимметрияning кузатилиши</p>	<p>Мултиплет иккиламчи заррачаларнинг асосий хоссаларни тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>
4.	<p>Dislocation: a crystallographic line defect involving irregularity in the periodic arrangement of atoms (missing row of atoms in a plane) in a crystal</p>  <p>Дислокация: ўз ичига атомларнинг даврий жойлашувиning нотекислигини олувчи кристалдаги (текисликдаги бир қатор атомларнинг йўқлиги) кристаллографик чизиқли дефект</p>	<p>Дислокацийнинг асосий хоссаларни тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>
5.	<p>Stacking faults: crystallographic defects arising due to wrong stacking sequence of planar arrangement of atoms</p>  <p>Жойлашиш дефектлари: атомларнинг нотўғри кетма-кет планар жойлашуви натижасида хосил бўлувчи кристаллографик дефектлар</p>	<p>Жойлашиш дефектларининг асосий принципини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>

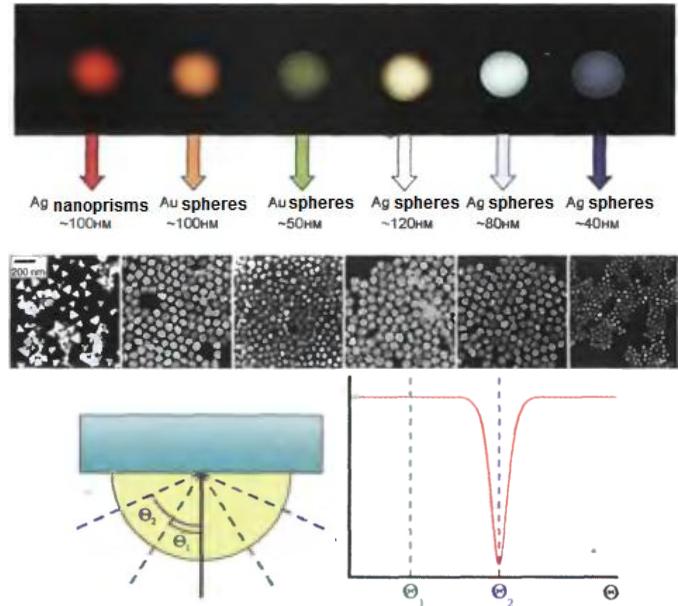
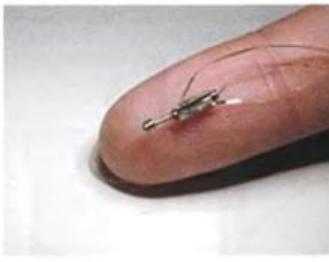
6.	<p>Triple junction: a node at the intersection of three crystals or grains</p>  <p>Учкаррали тугун: уча кристалларнинг ёки зарраларнинг тўқнашувидаги тугун</p>	<p>Учкаррали тугунинг асосий хоссаларни тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>
7.	<p>Hall–Petch relation: the effect describing the inverse effect of grain size on the hardness of a crystalline solid that arises mainly due to grain boundary strengthening</p> <p><u>Hall-Petch Strengthening Limit</u></p>  <p>Холл-Петч қонуни: асосан чегарадаги заррачанинг мустахкамлашуви хисобига хосил бўлувчи кристалсимон модданинг қаттиқлигига заррачаларнинг ўлчамини тескари таъсирини тавсифловчи эффекти</p>	<p>Холл-Петч қонунини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>
8.	<p>Band gap: energy gap between the valence band and conduction band in a solid in which all electronic energy states are forbidden</p>  <p>Таъқиқланган чегаранинг кенглиги: барча электрон энергетик холатлар таъқиқланган қаттиқ жисмдаги валент чегара ва ўтказувчанлик чегараси</p>	<p>Таъқиқланган чегаранинг асосий хоссаларини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>

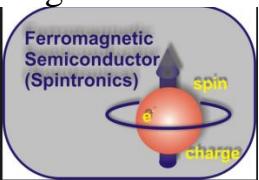
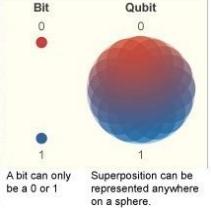
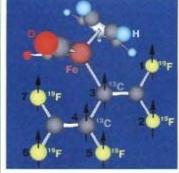
	орасидаги энергетик түйнүк	
9.	<p>Depletion zone: a region at the junction of semiconducting materials that is devoid of free charge carriers</p>  <p>The diagram illustrates a p-n junction with two regions: P-Type (left) and N-Type (right). In the P-Type region, there are holes (red dots) and electrons (blue circles). In the N-Type region, there are holes (red dots) and electrons (blue circles). At the junction, holes from the P-type side diffuse into the N-type side, and electrons from the N-type side diffuse into the P-type side, creating a 'Depletion Zone' where there are no free charge carriers.</p> <p>Холилаштирилган худуд: зарядларни эркин ташувчиларидан холи бўлган яримўтказгич материалларнинг бирлашиш жойи</p>	Холилаштирилга н худуд қандай таркибий қисмлардан ташкил топган? Расмдан фойдаланинг!
10	<p>Molecular electronics: the study and application of molecules for electronic device applications</p>  <p>The diagram shows a molecular structure with two yellow cylindrical 'CONTACTS' attached to it, representing a molecular electronic device.</p> <p>Молекуляр электроника: электрон қурилмаларда кўлланилиши учун молекулаларнинг тадқики ва кўлланилиши</p>	Молекуляр электрониканинг асосий принципини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!
11	<p>Light-emitting diode (LED): a semiconductor light source working on the principle of electroluminescence, where the wavelength of light emitted depends on the band gap of semiconductors</p>  <p>The diagram shows a Light Emitting Diode (LED) connected in a circuit with a battery and a click switch. The LED is composed of n-type and p-type semiconductors. A callout indicates: 'To see or hide bound electrons, click LED'. Another callout indicates: 'Click switch'.</p> <p>Светодиод (LED): электролюминесценция принципига асосан ишловчи яримўтказгичли нур</p>	Светодиоднинг асосий принципини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!

	манбаи, нурланувчи ёруғликнинг тўлқин узунлиги яримўтказгичларнинг таъкиқланган худуди кенглигига боғлиқ.	
12	<p>Field effect transistor (FET): a transistor whose conductivity can be controlled by electrical field</p>   <p>Майдон эфектитранзистор (FET): электр майдони ёрдамида ўтказувчанигини бошқариш мумкин бўлган транзистор</p>	<p>Майдон эфектли транзистор (FET) нима учун керак? Расмдан фойдаланинг!</p>
13	<p>Thin film transistors (TFT): an FET made of thin film layers of semiconducting and dielectric materials; used in LCD and digital radiography applications</p>  <p>Юпқа пленкали транзисторлар (TFT): яримўтказгичли ва диэлектрик материалли юпқа пленка қаватли транзисторлар; радиографиянинг LCD ва ракамли иловаларида қўлланилади</p>	<p>Юпқа пленкали транзисторлар қандай таркибий қисмлардан ташкил топган? Расмдан фойдаланинг!</p>
14	<p>Single electron transistor (SET): devices that are capable of detecting very small variations in the charge of the gate; charge differences of even one electron can cause the on-and-off switching function of SET</p>  <p>Бир электронли транзистор (SET): чиқувчи заряднинг жуда кичик ўзгаришларини аниqlаш қобилиятига эга мосламалар; биргина электрон учун хам зарядлар фарқи “ёқиб-ўчириш” функциясини чақириши мумкин</p>	<p>Бир электронли транзисторнинг асосий хоссаларни тушунтиринг?</p>
15	<p>Charge-coupled device (CCD): a device that can gather</p>	<p>Заряд</p>

	<p>position-sensitive charge information and convert to digital data for manipulation, which is used extensively for digital imaging applications</p>  <p>Заряд боғланишлы қурилма (CCD): зарядланган позицион-сезир ахборотни йиға оладиган ва рақамли тасвиirlарни ишлатиш учун кенг күлланиладиган монипуляциялар учун рақамли маълумотларга ўтказа оладиган қурилма</p>	<p>боғланишлы қурилма нима учун керак? Расмдан фойдаланинг!</p>
16	<p>Complementary metal–oxide semiconductor (CMOS): an emerging technology for the fabrication of ICs and VLSI, the main advantage being low power consumption and high noise, enabling larger density of devices within unit area</p>  <p>Комплементарметалоксидли яримўтказгич (CMOS): интеграл схемалар (ICs) ва ўта катта интеграл схемаларни (VLSI) ясаш учун янги технология, асосий афзалликлари кам энергия сарф қилиши ва юқори шовқин даражасида бўлиб бу ўз навбатида юза бирлиги доирасида қурилмаларнинг юқори зичлигини таъминлайди</p>	<p>Комплементарметалоксидли яримўтказгичлар нима учун керак? Расмдан фойдаланинг!</p>
17	<p>Giant magnetoresistance (GMR): quantum mechanical effect observed in thin film structures: the electrical resistance decreases significantly when the ferromagnetic layer is exposed to a magnetic field</p>  <p>Гигантмагнит қаршилиги (GMR): юпқа пленкали структураларда кузатиладиган квант-механик эфект: ферромагнит қаватнинг магнит майдони</p>	<p>Гигантмагнит қаршилигининг асосий хоссаларини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>

	таъсирига учраганда электр қаршилиги сезиларли даражада камаяди	
18	<p>Opto-electronics: an application of electromagnetic photons for electronic device applications; they can be either electrical-to-optical or optical-to-electrical transducers</p>  <p>Оптоэлектроника: электрон қурилмалардани электромагнит фотонларнинг қўлланилиши; “электр сигналини оптик сигналга” ёки “оптик сигнални электр сигналга” ўтказувчи ўзгартгичлар бўлиши мумкин CdSe наноколлоид</p>	<p>Оптоэлектроника нинг асосий хоссаларини тушунтириинг?</p>
19	<p>Photoluminescence (PL): a process by which certain substances absorb electromagnetic radiations of specific wavelengths and re-radiate photons of different wavelength</p> <p>Фотолюминесценция (PL): баъзи бир моддаларнингмаълум бир тўлқин узунликдаги электромагнит нурларни ютиб ва қайтадан фотонларни турли хил тўлқин узунликда нурлатувчи жараён</p>	<p>Фотолюминесценциянинг асосий принципини тушунтириинг?</p>
20	<p>Photonic crystals: periodic dielectric or metallo-dielectric optical nanostructures that are designed to affect the propagation of electromagnetic waves (EM) in the same way as the periodic potential in a semiconductor crystal affects electron motion by defining allowed and forbidden electronic energy bands</p>  <p>Фотонкристаллар: электромагнит тўлқинларни тарқатилишига таъсир этишга мўлжалланган даврий диэлектрик ёки металлдиэлектрик оптик наноструктуралар</p>	<p>Фотонкристаллар нинг асосий хоссаларини тушунтириинг?</p> <p>Расмдан фойдаланинг!</p>
21	<p>Photonics: electronics using light (photons) instead of electrons to manage data</p>	<p>Фотониканинг асосий принципини тушунтириинг?</p>

	 <p>Фотоника: маълумотларни электронлар ўрнига еруғликни бошқаришда (фотонларни) кўлловчи электроника</p>	
22	<p>Surface plasmon (SP): plasmons that are confined to surfaces and interact strongly with light resulting in a polariton</p>  <p>Юзаплазмон (SP): ёруғлик билан кучли таъсирилашиб натижасида поляритонга олиб келувчи юзага мос келувчи плазмонлар</p>	Юзаплазмон (SP) терминини тушунтуринг. Расмдан фойдаланинг!
23	<p>Piezoresistive effect: phenomenon by which electrical resistance of a material varies with externally applied mechanical pressure</p>  <p>Пьезорезистив эффект: ташқаридан механик босим таъсирига боғлиқ равишда материалнинг электр</p>	Пьезорезистив эффектнинг асосий принципини тушунтиринг?

	қаршилигининг ўзгариш ҳодисаси	
24	<p>Spintronics (spin-based electronics): an emerging technology, which exploits the dual property of electrons, namely charge and spin state; also known as magneto-electronics</p>  <p>Спинтроника (спин асосидаги электроника): электронларнинг иккиланган хоссаларини, жумладан заряд ва спин холатини қўлловчи янги технология; манито-электроника сифатида хам маълум</p>	<p>Спинтроника (спин асосидаги электроника) нинг асосий хоссаларини тушунтириинг?</p>
25	<p>Qubit: a quantum-computing equivalent to a bit; with an additional dimension of quantum properties of atoms</p>  <p>Кубит: хисоблашлардаги битнинг квант эквиваленти; атомларнинг квант хоссаларини ўлчаш қўшимчаси билан</p>	<p>Кубит нима учун керак?</p>
26	<p>Quantum computers: a computational device using quantum mechanical phenomena for operations on input data</p>  <p>Кванткомпьютерлар: кириш маълумотларидағи операцияларда квант-механик ҳодисаларини қўлловчи хисоблаш асбоблари</p>	<p>Квант компьютерлари асосий принципини тушунтириинг? Расмдан фойдаланинг!</p>

Назорат саволлари

1. Кристалл нанозаррачаларнинг асосий хоссаларнинг тушунтириинг?
2. Материалларда энергетик зоналар қандай шаклланади?
3. Рухсат этилган ва таъкиқланган зоналарнинг фарқи нимадан иборат?
4. Металлар, диэлектриклар ва яримўтказгичларда энергетик зоналарнинг тўлдирилишидаги фундаментал фарқлар нимадан иборат?
5. Кўп қатламли яримўтказгичли структураларда квантли ўралар ва потенциал тўсиқлар қандай қилиб шаклланади?
6. Тунелланиш ҳодисаси мохияти нимадан иборат?

7. Кванли ўрада энергия сатхлари қайси сабабларга кўра дискретлашади?
8. Квант ўлчамли эффект нимадан иборат?
9. Молекуляр электроника, оптоэлектроника, фотоника, спинтроника асосий принципининг солиширинг.
10. Светодиод, майдон эффектли транзистор (FET), юпқа пленкали транзисторлар, бир электронли транзисторнинг нима учун керак?
11. Кубит ва квант компьютерларнинг асосий принципининг тушунтиринг.
12. Гигантмагнит қаршилигининг асосий хоссаларнинг тушунтиринг?
13. Фотонкристалларнинг қандай таркибий қисмлардан ташкил топган?
14. Пьезорезистив эффектнинг асосий принципининг тушунтиринг?
15. Спин асосидаги электрониканинг асосий хоссаларнинг тушунтиринг?

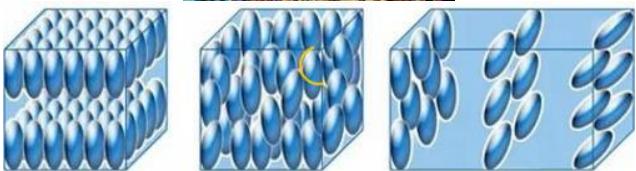
Фойдаланилган адабиёт

1. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 17-35.

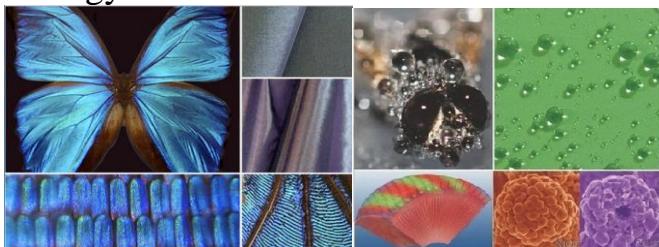
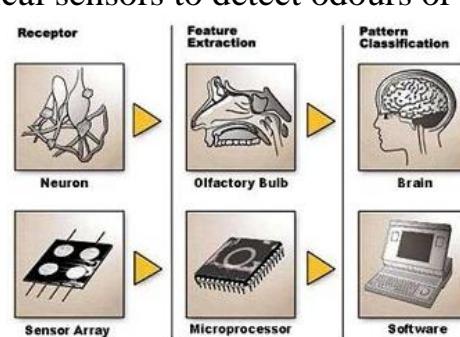
2-амалий машғулот: Полимер наноматериал олиш ва уларни хоссаларни. Наноцеллюлоза. Биомиметика системаларни олиш ва уларни хоссалари.

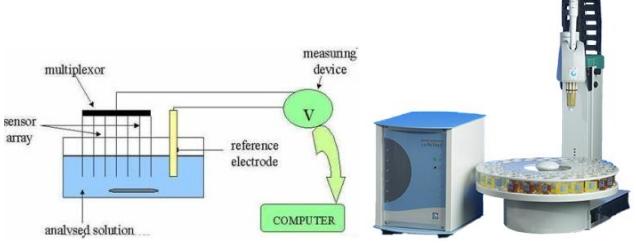
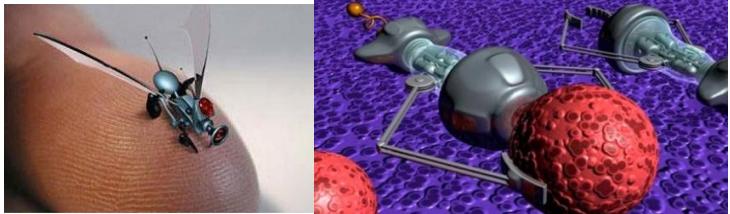
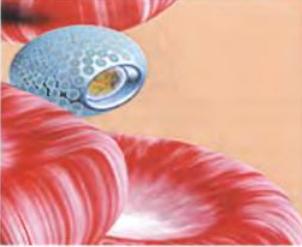
Ишдан мақсад:

Суюқ кристал. Шакл хотирали полимерлар. Наноцеллюлоза. Тўқимали инженерия. Биомослашувчанлик. Биомиметика. Электрон бурун. Электрон тил. Бот. Нанобот. Дориларни мақсадли етказиш. ДНК-чип.

№	Ишни бажариш учун намуна	Масаланинг кўйилиши
1.	<p>Liquid crystal (LC): a state of matter with properties between a liquid and solid crystal; it is used extensively in liquid crystal displays</p>   <p>Суюқкристал (СК): суюқлик ва қаттиқ кристалсизмон модда хоссалари оралиғидаги материя; суюқ кристалли дисплейларда кенг қўлланилади</p>	<p>Суюқ кристал (СК) қандай таркибий қисмлардан ташкил топган? Расмдан фойдаланинг!</p>

	<p>2. Shape memory polymers: smart polymers capable of returning to their original shape after being deformed by external forces, when triggered by an external stimulus such as temperature change</p> <p>Шакл хотириали полимерлар: хароратнинг ўзгариши каби ташқи кучлар таъсирида вужудга келган ташқи кучлар таъсирида деформациядан сўнг ўзининг дастлабки шаклига қайтиш қобилиятига эга ақлли полимерлар</p>	<p>Шакл хотириали полимерлар нима учун керак?</p>
3.	<p>Tissue engineering: science of structural and functional fundamentals of mammalian tissues and application of biocompatible substitutes to restore, maintain or improve functions</p> <p>Тўқимали инженерия: сутемизувчиларнинг асосий тўқималарининг тузилиши ва функционал асослари хамда функцияларини тиклаш, қўллаб туриш ёки яхшилаш учун биомослашувчан ўрнини босувчиларнинг қўлланилиши тўғрисидаги фан</p>	<p>Тўқимали инженериянинг асосий хоссаларини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>
4.	<p>Biocompatibility: capability of a material in contact with a biological system to perform its intended function without causing deleterious changes</p>	<p>Биомослашувчанинг асосий принципини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>

	Биомослашувчанлик: нохуш ўзгаришларни чақирмай материалнинг биологик тизим билан таъсирашувида ўз вазифаларини бажариши	
5.	<p>Biomimetic: the science of imitating or reverse engineering from natural systems to the study and design of engineered systems using modern technology</p>  <p>Биомиметика: замонавий технологияларни қўллаш билан мухандислик тизимларни тадқиқ қилиш ва лойиҳалаштириш учун табиий тизимларга ўхшаш, инженерия ёки тақлид қилиш тўғрисидаги фан</p>	Биомиметика асосий принципини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!
6.	<p>Electronic nose: a device consisting of an array of chemical sensors to detect odours or flavours</p>   <p>Электрон бурун: хид ёки таъмларни аниқлаш учун бир неча кимёвий сенсорлардан ташкил топган қурилма</p>	Электрон буруннинг асосий хоссаларини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!
7.	<p>Electronic tongue: a device consisting of an array of chemical sensors to detect and compare tastes</p>	Электрон тилнинг асосий хоссаларини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!

	 <p>Электрон тил: таъмларни аниқлаш ва таққослаш учун бир неча кимёвий датчиклардан ташкил топган қурилма</p>	
8.	<p>Bot: a robot or automated intelligent machine</p>  <p>Бот: робот ёки автоматлаштирилган интеллектуал машина</p>	<p>Бот: нима учун керак?</p>
9.	<p>Nanobots: a robot (semi- or fully-automated intelligent machine) consisting of components of a few hundred nanometre-dimensions; they are also referred to as nanorobots, nanoids, nanites, nanomachines or nanomites</p>  <p>Нанобот: нанометрли ўлчамлардан ташкил топган компонентли робот (ярим ёки тўлиқ автоматлаштирилган интеграл машина); улар нанороботлар, наноидлар, нанитлар, наномашиналар ёки наномитлар номлари билан хам учрайди</p>	<p>Нанобот нима учун керак? Расмдан фойдаланинг!</p>
10.	<p>Targeted drug delivery: administration of a pharmaceutical compound in desired amount to a localized diseased cell/tissue for therapy</p>	<p>Дориларни мақсадли етказишининг асосий принципини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>

	<p>Дориларни мақсадли етказиши: терапияда локаллашган заарланган хужайраларга / түқималарга керак бўлган миқдорда фармацевтик биримни киритиш</p>	
11.	<p>DNA chip: a sensor based on a semiconductor microchip used to identify mutations or alterations in a gene</p> <p>ДНК-чип: гендаги мутацияларни ёки ўзгаришларни идентификациялаш учун қўлланиладиган яримўтказгичли микрочип асосидаги датчик</p>	<p>ДНК-чипнинг асосий хоссаларини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>

Назорат саволлари

- Суюқристал қандай таркибий қисмлардан ташкил топган?
- Шакл хотирали полимерлар асосий хоссаларнинг тушунтиринг?
- Тўқимали инженериянинг нима учун керак?
- Биомиметика ва биокерамиканинг асосий принципини тушунтиринг?
- Электрон бурун ва электрон тил асосий хоссаларнинг тушунтиринг?
- Нанобот ва дориларни мақсадли етказишининг асосий принципининг тушунтиринг?
- ДНК-чипнинг асосий хоссаларнинг тушунтиринг?

Фодаланилган адабиётлар

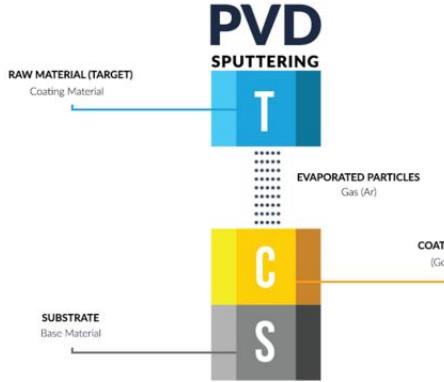
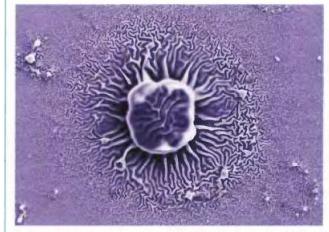
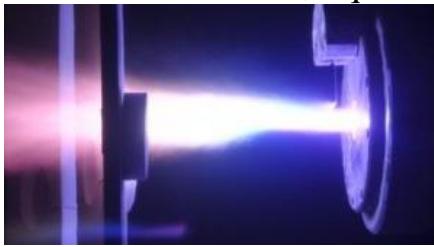
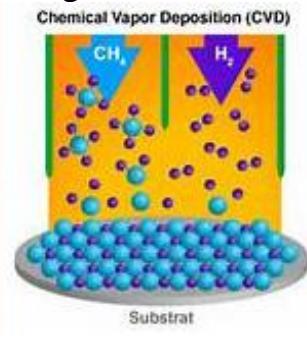
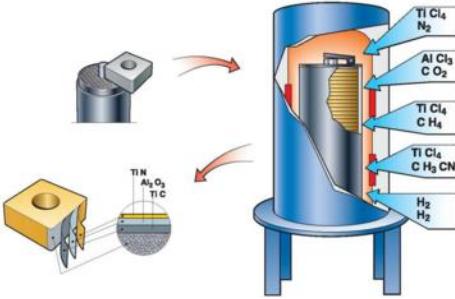
- David Rickerby Nanotechnology for Sustainable Manufacturing, Taylor and Francis, 2014, 79-92.
- David Rickerby Nanotechnology for Sustainable Manufacturing, Taylor and Francis, 2014, 213-226.

3-амалий машғулот: Наноматериал олиш ва уларни хоссаларни.

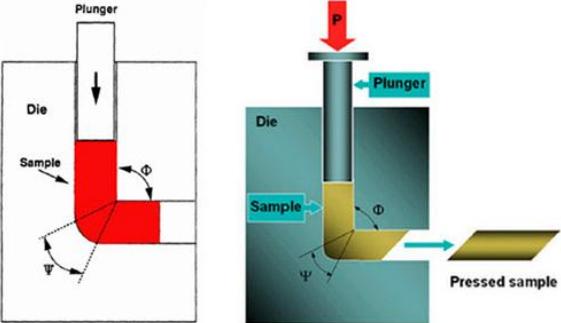
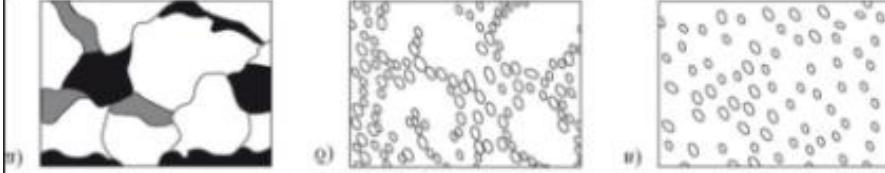
Ишдан мақсад:

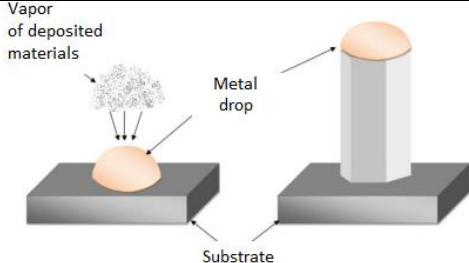
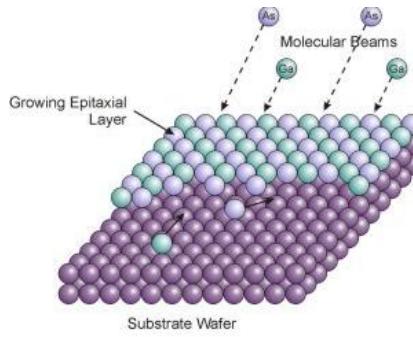
Тагдан-тепага ва Тепадан пастга. Бұғ фазасидан физикалық чүктириш (PVD).
Плазма. Бұғ фазасидан кимёвий чүктириш (CVD). Иссык изостатик преслаш (HIPing).
Пиролиз. Учқунли плазмали пишириш (SPS). Тенг каналлы бурчаклы пресслаш (ECAP).
Механик қотишмалаш. Бұғ-суюқлик-қаттық модда усули (VLS).
Эпитаксия. Нанолитография. Fab. Коллоид.
Нанодисперсия. Үз-үзини йиғиши. Аэрогел. Квант нукталари. Бакминстер – фуллерен. Магиксон. Углеродли нанотрубка. Нанотолалар. Наноқобиқлар.
Наносимлар. Наноматериал. Наностержнлар. Вискерлар. Юпқа пленкалар. Мезофовакли материал. Мултиқаватлар.

№	Ишни бажариш учун намуна	Масаланиң негізде күйилиш и
1.	<p>Bottom-up: a strategy for synthesizing nanomaterials from atomic scale fundamental units where the fundamental units link up to form nanoparticles/nanostructures</p> <p>Top-down: involves fragmentation of a microcrystalline material to yield a nanocrystalline material; all solid state synthesis routes of nanostructures fall into this category</p> <p>Тагдан-тепага ва Тепадан пастга: асосий принциптердің негізде күйилиш ини солишиштіринг? Расмдан фойдалан инг!</p> <p>Тагдан-тепага: асосий бирліктіктер нанозаррачалар / нанотизимларни хосил қилиш билан бирлашадын атом миқёсидеги асосий бирліктіктерден наноматериалдарнинг синтез қилиш стратегияси</p> <p>Тепадан пастга: нанокристалл материални олиш билан микрокристалл модданинг майдалашни үз ичига олади; наноструктураларни синтез қилишнинг қаттық моддали йүллари шу категорияга киради</p>	

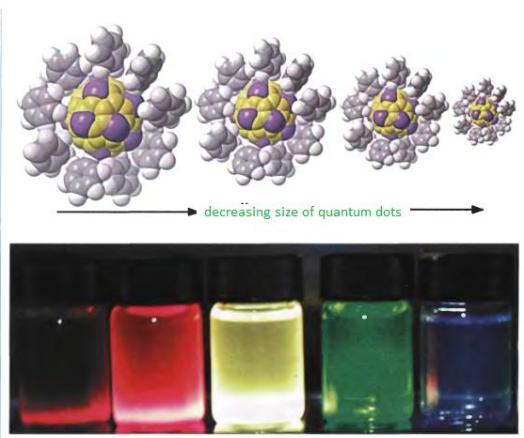
2.	<p>Physical vapour deposition (PVD): a variety of vacuum deposition technique involving vaporization of atoms from target material to produce a thin film on a substrate</p>   <p>Amorphous silicon on substrate (PVD)</p>	<p>Буғ фазасидан физикави й чўқтириш нинг асосий принципи ни тушунтирилган расмдан фойдаланинг!</p>
3.	<p>Plasma: a state of matter containing a significantly large fraction of ionized matter; plasma properties differ significantly from those of solids, liquids or gases</p>  <p>Плазма: ионлашган модданинг анчагина катта фракциясини ўзида сақловчи модданинг холати; плазманинг хоссалари қаттиқ моддалардан, суюқликлардан ёки газлардан тубдан фарқ қиласди</p>	<p>Плазма температурасини ва хоссалари и принципи нинг тушунтирилган</p>
4.	<p>Chemical vapour deposition (CVD): a technique for depositing thin films on a substrate using gaseous reactants</p>   <p>Буғ фазасидан кимёвий чўқтириш (CVD) инг асосий принципи ни тушунтирилган?</p> <p>Расмдан фойдаланинг!</p>	
5.	<p>Hot isostatic pressing (HIPing): the process of using high hydrostatic pressure and temperature to compress fine particles into coherent parts</p>	<p>Иссик изостатик преслашинг!</p>

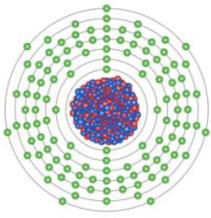
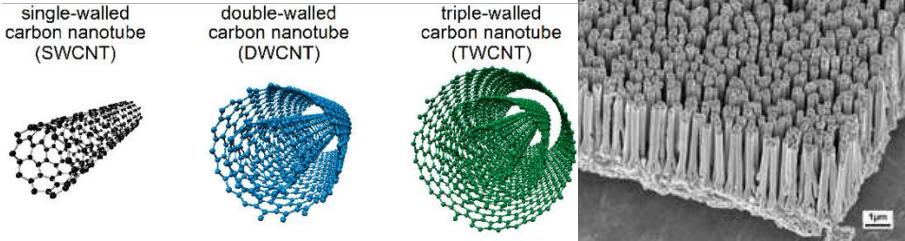
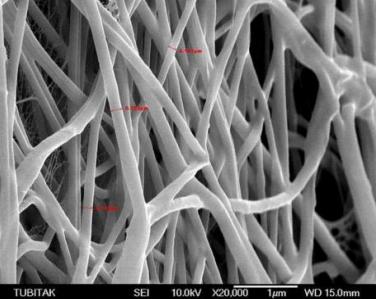
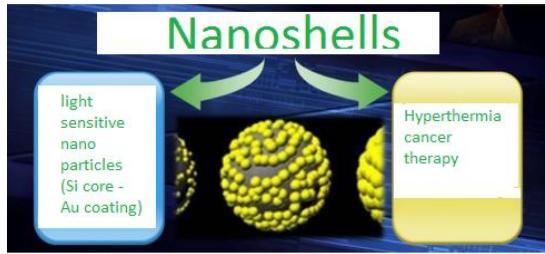
	<p>Иссик изостатик преслаш (HIPing): майин заррачаларни яхлит қисмларга сиқиши учун юқори гидростатик босим ва хароратни күллаш жараёни</p>	инг асосий принципни тушунтир инг? Расмдан фойдалан инг!
6.	<p>Pyrolysis: Greek word denoting separation (<i>lysis</i>) under fire (<i>pyr</i>); a thermochemical method involving decomposition of organic material at elevated temperatures in the absence of oxygen</p> <p>Пиролиз: аланга(<i>pyr</i>) остида ажратишни (<i>lysis</i>) англатувчи грекча сўз; кислород иштирокисиз юқори хароратларда органик моддани парчалашни ўз ичига оловчи термокимёвий усул</p>	Пиролиз нима учун керак? Расмдан фойдалан инг!
7.	<p>Spark plasma sintering (SPS): a sintering technique using pulsed DC current that directly passes through the graphite die, as well as the powder to be consolidated, in case of conductive samples</p> <p>Учқунли плазмали пишириш (SPS): графит матрицаси шунингдек ўтказувчан намуналар холатида пиширилаётган кукундан бевиста ўтаётган доимий импульс токи кўлланилишидаги пишириш техникаси</p>	Учқунли плазмали пишириш нинг асосий принципни тушунтир инг? Расмдан фойдалан инг!

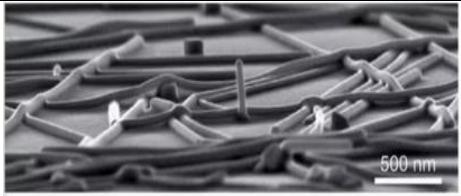
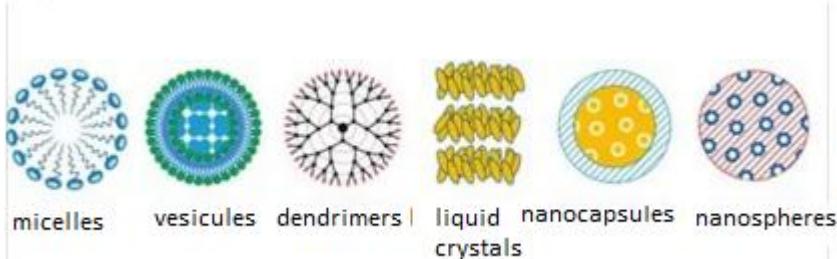
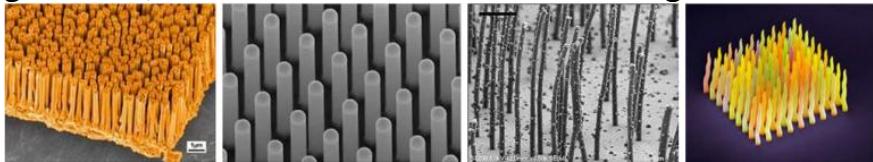
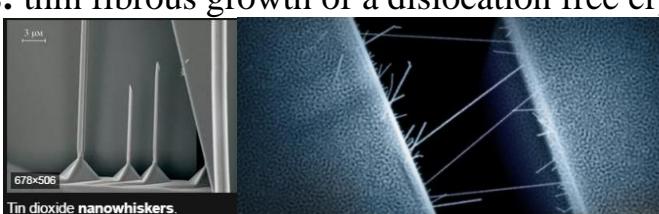
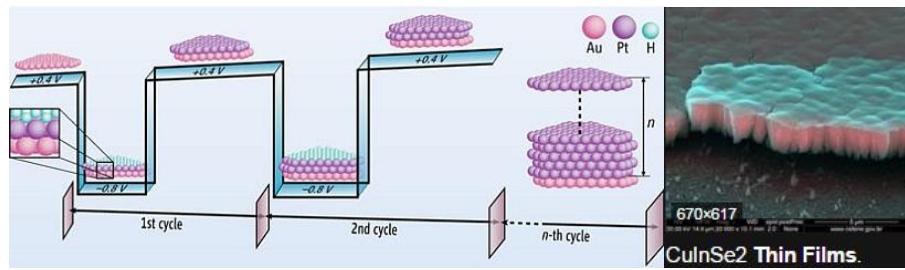
8.	<p>Equal channel angular pressing (ECAP): a severe plastic deformation technique for producing ultrafine grain structures, which introduces a large amount of shear strain into the materials without changing its shape or dimensions; equichannel angular extrusion (ECAE) is a similar process involving extrusion</p>  	<p>Тенгканалли бурчакли пресслаш(ЕСАР): шакл ва ўлчамларини ўзгартиришсиз катта микдордаги деформацион силжишни киритувчи ултрайсперс тузилиши заррачаларни ишлаб чиқариш учун пластик деформациянинг оғир техникаси; экструзия иштироқидаги ўхшаш жараённи намоён қилувчи тенг каналли бурчак экструзияси (ECAE)</p>
9.	<p>Mechanical alloying: a solid state process in which grain refinement occurs by repeated deformation, fracturing and cold welding of powder particles in a high-energy ball mill</p> <p>Механикқотишмалаш: юқори энергияли шарлы тегирмонда заррачаларнинг қайта деформацияланиши ва ёриқлари натижасида майдаланиши, кукунларнинг заррачалари совук пайванланадиган қаттиқ жисмдаги жараён</p>	<p>Механиккотишмалаш нинг асосий принципи нинг тушунтирилган?</p>
10.	<p>Vapour–liquid–solid method (VLS): a mechanism for the growth of one-dimensional nanostructures, such as nanowires, from chemical vapour deposition; to enhance the efficiency and kinetics for the growth of crystals, a catalytic liquid alloy phase which can rapidly adsorb a vapour to supersaturation levels is used</p>	<p>Буғсуюқликкөттөштөрдөн гасасиң принципи нинг тушунтирилган?</p> <p>Расмдан фойдалан</p>

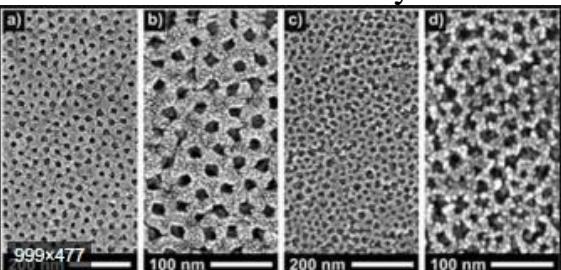
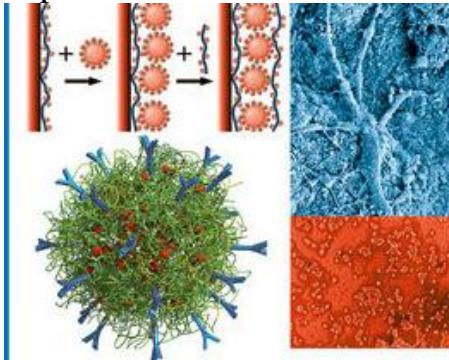
	 <p>Буғ-суюқлик-каттиқ модда усули (VLS): буғ фазасидан кимёвий чўқтиришдаги наносимлар каби бирўлчамли наноструктураларнинг ўсиши учун механизм; кристалларнинг ўсиши ва кинетикаси самарадорлигини ошиши учун қўлланилади, каталитик суюққотишмали фаза буғларни ўтатўйинганлик даражасигача тезда адсорбциялаши мумкин</p>	инг!
11.	<p>Epitaxy: growth of a secondary phase maintaining a perfect crystallographic registry (coherency) with the underlying substrate</p>  <p>Эпитаксия: асосий таглик билан кристаллографик тартибни (когерентликни) таъминлаш учун иккиламчи фазанинг ўсиши</p>	Эпитаксия инг асосий хоссаларнинг тушунтиришинг? Расмдан фойдалан инг!
12.	<p>Fab: a microfabrication facility consisting of clean rooms and controlled deposition process for the fabrication of semiconductor devices and ICs</p> <p>Fab: интеграл схемалар ва ва яримўтказгичли асбобларни ишлаб чиқариш учун назорат қилинувчи чўқтириш жараёнлари ва тоза хоналардан ташкил топган микротехнологик объект</p> 	Fab нима учун керак? Расмдан фойдалан инг!
13.	<p>Colloid: a homogenous suspension of a dispersoid in a continuous medium; it may be a solid, liquid or gas</p>	Коллоид қандай таркибий қисмлард

		ан ташкил топган? Расмдан фойдалан инг!
	<p>Коллоид: ўзлуксиз мухитдаги дисперсияланган модданинг бир турдаги суспензияси; қаттиқ, суюқ ёки газсимон бўлиши мумкин.</p>	
14.	<p>Nanofluid: colloidal suspension of nanoparticles of metals, ceramic, carbon nanotubes, etc.</p>	Нанодисперсия қандай таркибий қисмлардан ташкил топган?
15.	<p>Self-assembly: process in which the components interact within themselves to form aligned or organized structures without any external force</p>	Ўз-ўзини йигишни нг асосий принципи нинг тушунтир инг? Расмдан фойдалан инг!
16.	<p>Aerogel: a porous solid formed from a gel in which the liquid is replaced with a gas with gas entrapment</p>	Аэрогел қандай таркибий қисмлардан ташкил топган? Расмдан фойдалан инг!

	Аэрогел: суюқлиги ютилган газ билан ўриналмашган гелдан олинган ғоваксимон қаттың чүкма	инг!
17.	<p>Quantum dots: 0D nanostructures in which electron energy states are confined in all three spatial dimensions; their electronic properties are between that of cluster*s and bulk semiconductors</p>  <p>Color of CdSe - CdS colloids is a function of quantum dots sizes</p> <p>Квантнұқталари: электронларнинг энергия холатлари барча уcta кенглик үлчамларida аниқланадиган 0D наноструктуралар; уларнинг электрон хоссалари кластерлар ва яримүтказгичлар орасида бўлади</p>	Квантнұқталари нима учун керак? Расмдан фойдалан инг!
18.	<p>Buckminster fullerene: a spherical molecule with the formula C₆₀, named in homage to Richard Buckminster Fuller, due to its resemblance to the geodesic dome designed by him; Buckminster fullerene is the first fullerene molecule to be discovered and is also the most common in terms of natural occurrence, as it can be found in small quantities in soot</p>  <p>Бакминстер - фуллерен: Ричард Бакминстер Фуллерен томонидан лойиҳалаштирилган геодезик гумбазга ўхшаши туфайли унинг шарафига номланган C₆₀ формуласи доирасимон молекула; Бакминстерфуллерен – фуллереннинг дастлабки топилган молекуласи ҳисобланади, шу билан бирга қурумда оз миқдорда топилиши мумкин бўлганлиги учун табий хосил бўлиши нуқтаи назаридан энг қўп тарқалган ҳисобланади.</p>	Бакминстер – фуллерен қандай таркибий қисмлардан ташкил топган?
19.	Magic number: a critical number of atoms in a cluster size providing it higher structural and potential stability	Магиксон тушунтир инг? Атом

	 <p>Магиксон: анчагина юқори бўлган структуравий ва потенциал турғунликни таъминловчи кластердаги атомларнинг критик сони</p>	тузилиши нинг фойдалан инг!
20.	<p>Carbon nanotube (CNT): an allotrope of carbon with cylindrical nanostructure and having high aspect ratios; their unusual electronic and magnetic properties find wide applications</p> 	Углеродли нанотрубка (CNT): тасвир форматининг юқори ўзгартирилиб туришли цилиндрисимон наноструктурали углероднинг аллотропик шакли; уларнинг ўзгача бўлган электрон ва магнит хоссалари кенг қўлланилади.
21.	<p>Nanofibre: fibres with diameter less than 100 nm</p> 	Нанотолалар: 100 нм дан кичик бўлган диаметрли толалар
22.	<p>Nanoshells: a thin coating over a core object a few tens of nanometres in diameter</p> 	Наноқобиқлар: диаметри бир неча ўнликдаги нанометрда бўлган объект ядроси устидаги юпқа қобиқ
23.	<p>Nanowires: 1D nanostructures with width of nanometric dimensions and exhibiting aspect ratios of 1000 or more</p>	Наносимлар нима

	 Наносимлар: нанометр ўлчамли кенгликдаги ва геометрик ўлчамларининг нисбати 1000 ва ундан юқори бўлган 1Dнаноструктуралар	учун керак?
24.	Nanomaterial: class of materials in which at least one of the dimensions is on the nanoscale (<100 nm) 	Наномате риалларн инг қандай синфлани ши бор?
25.	Nanorods: 3D nanostructures with aspect ratio typically in the range of 3–5; all their dimensions are in the range 1–100 nm  Наностержилар: ёқларининг нисбати 3-5 диапазонида бўлган 3Dнаноструктуралар; уларнинг барча ўлчамлари 1-100 нм диапазонида бўлади	Наностер жилар қандай таркибий қисмлард ан ташкил топган?
26.	Whiskers: thin fibrous growth of a dislocation free crystal  Вискерлар: эркиндислокацияланадиган кристаллнинг нозик толали ўсиши	Вискерла р нима учун керак?
27.	Thin films: atomically engineered layers with film thickness usually in the range of nanometers to a maximum of a few microns 	Юпқа пленкала рнинг асосий хоссаларн инг тушунтир инг? Расмдан фойдалан

	Юпқа пленкалар: атомар конструкцияланган қаватлар нанометрдан максимум бир неча микронгача бўлган диапазонда бўлган қалинликдаги пленкалар	инг!
28.	Mesoporous: porous materials with regularly arranged, uniform mesopores (2–50 nm in diameter); their large surface areas make them useful as adsorbents or catalysts  <p>Мезовакли: бир меъёрда бер текис жойлашган мезовакли (диаметри 2-50 нм) ғоваксимон материаллар; юза сиртининг катталиги уларни адсорбент еки катализаторлар сифатида фойдали қилади</p>	Мезовакли материал ларнинг асосий хоссаларн и тушунтири инг? Расмдан фойдалан инг!
29.	Multilayers: thin films of differing chemistry or structure deposited one over the other  <p>Мултиқаватлар: бир-бирига жойлаштирилган турли хил кимёвий таркибли ёки структурали юпқа пленкалар</p>	Мултиқав атлар: нима учун керак? Расмдан фойдалан инг!

Назорат саволлари

- Буғ фазасидан физикавий чўқтиришнинг (PVD) ва буғ фазасидан кимёвий чўқтириш (CVD) инг асосий принципини солиштиринг?
- Иссик изостатик преслашнинг во тенгканалли бурчакли преслашнинг асосий принципининг тушунтиринг?
- Пиролиз ва учқунли плазмали пишириши нима учун керак?
- Механик қотишмалашнинг асосий принципининг тушунтиринг?
- Буғ-суюқлик-қаттиқ модда усулининг асосий принципининг тушунтиринг?
- Эпитаксиянинг асосий хоссаларнинг тушунтиринг?
- Коллоид ва нанодисперсия қандай таркибий қисмлардан ташкил топган?
- Квантнуқталари, бакминстер – фуллерен, углеродли нанотрубканинг синтезининг тушунтиринг?

9. Нанотолаларнинг, наноқобиқлар, наносимлар, наностержилар, вискерлар мисол келтиринг?
10. Юпқа пленкаларнинг ва мезофовакли материалларнинг нима учун керак?

Фойдаланилган адабиётлар

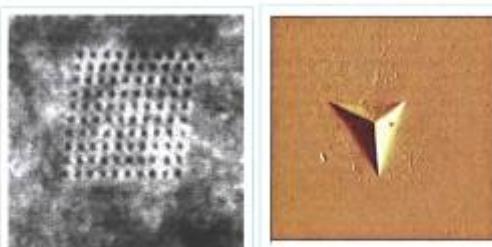
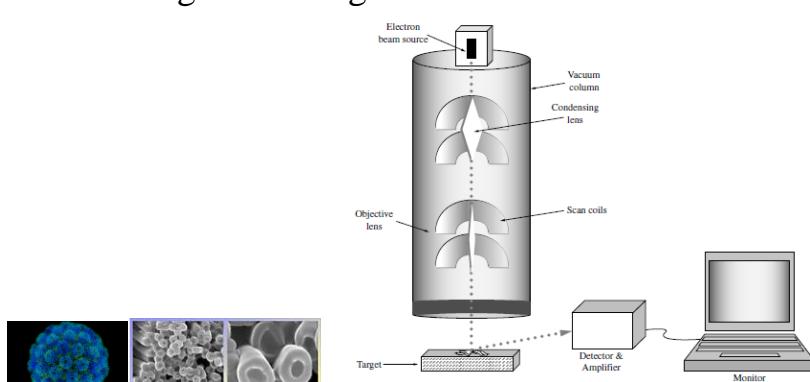
1. David Rickerby Nanotechnology for Sustainable Manufacturing, Taylor and Francis, 2014, 153-197

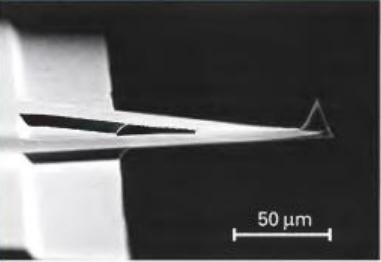
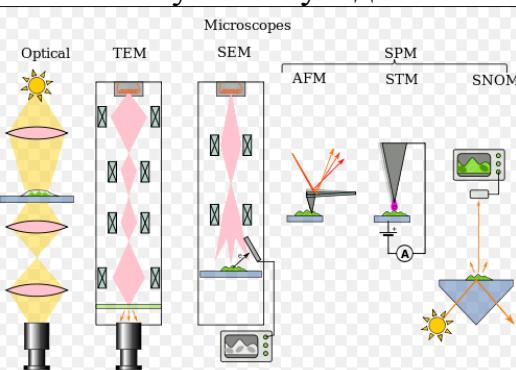
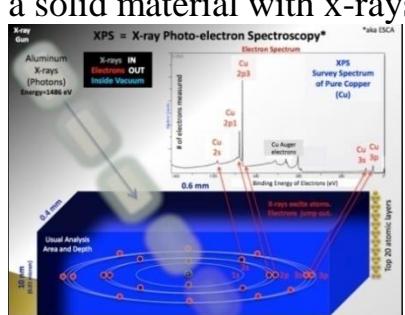
4-амалий машғулот: Нанометрология.

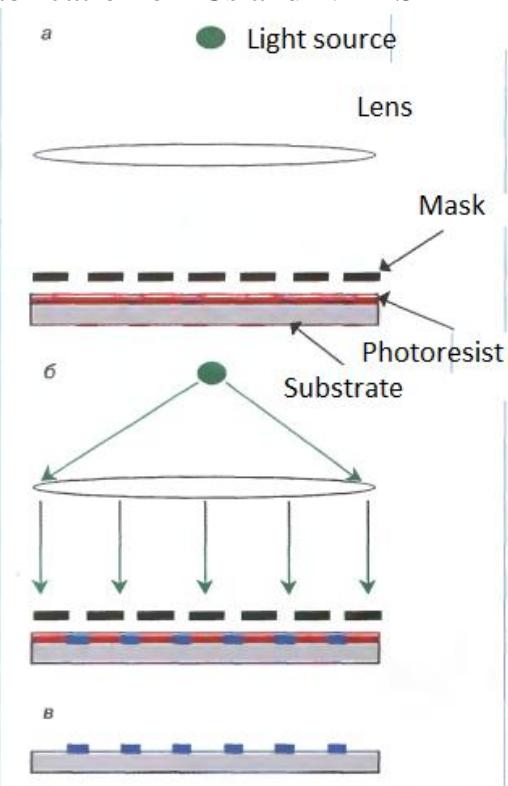
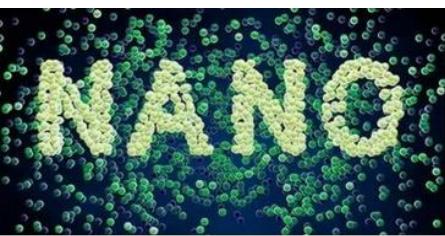
Ишдан мақсад:

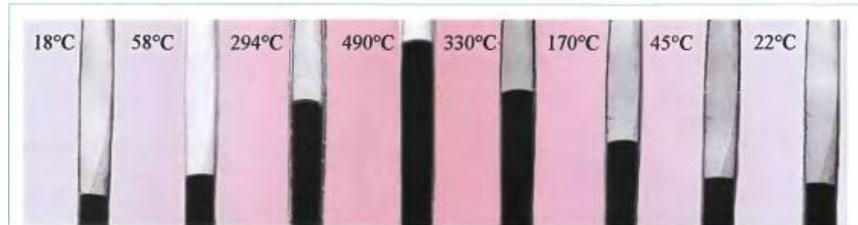
Атом-кучланишли микроскопия (AFM). Атом манипуляцияси. Нанолитография. Наноиндентификациялаш. Электрон микроскоп. Микрокантилевер. Сканировчи яқин худудли оптик микроскопия (SNOM). Рентгенфотоэлектронспектроскопия (XPS). Ўта ўказувчан квантинтерферометр (SQUID).

№	Ишни бажариш учун намуна	Масаланинг кўйилиши
1.	<p>Atomic force microscopy (AFM) or scanning probe microscopy (SPM): a high-resolution device used to map topography or other functional properties of the surface atoms at atomic resolution capabilities</p> <p>Атом-кучланишли микроскопия (AFM) ёки сканерловчи зондмикроскопияси (СЗМ): атом кўрсатгичли юзадаги атомларнинг тасвирини ёки бошқа функционал хоссаларини тасвирлаш учун қўлланиувчи юқори кўрсатгичли қурилма</p>	<p>Атом-кучланишлими кроскопия (AFM) ёки сканерловчи зондмикроскопияси (СЗМ) асосий принципини тушунтиринг. Расмдан фойдаланинг!</p>
2.	<p>Atomic manipulation: atom by atom modification of surface structure or chemistry made possible by advanced techniques like atomic force microscope and scanning tunnelling microscope</p>	<p>Атом манипуляцияси нинг асосий принципини тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>

	<p>Атом манипуляцияси: атом-кучланишли микроскопия ва сканерловчи тунелли микроскоп каби илғор усуллар туфайли имконияти туғилған юзанинг тузилишини атом ортидан атом еки кимёвий модификациялаш</p>	
3.	<p>Nanoindentation: an indentation hardness test applied to nanoscale volumes at small loads to obtain the hardness of individual nanoparticles</p>  <p style="text-align: center;">Nanointender prints</p> <p>Наноиндентификациялаш: наноўлчамли хажмларга қўлланиувчи босищдаги қаттиқлик тести, кичик босимларда алоҳида нанозаррачаларнинг қаттиқлигини аниқлаш учун</p>	<p>Наноиндентификациялашнинг асосий принципининг тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>
4.	<p>Electron microscope: a microscope that focusses a collimated accelerated electron beam on the specimen to produce a magnified image at atomic resolution</p>  <p>Figure 4-1 The scanning electron microscope focuses a beam of electrons on a sample.</p> <p>Электронмикроскоп: тезлаштирилган электронларнинг коллимирланган дастасини намунага фокуслаб атом ўлчамидаги катталаштирилган тасвирни олиш учун қўлланиладиганмикроскоп</p>	<p>Электронмикроскоп инг асосий хоссаларнинг тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>
5.	<p>Microcantilever: a cantilever beam with dimensions in the micrometer scale that is extensively used in the field of MEMS, sensors, resonators, etc.</p> <p>Микрокантилевер: микрометр миқёсидаги ўлчамли кантилеверли нур, MEMS соҳасида, датчикларда, резонаторларда ва хиз кенг қўлланилади</p>	<p>Микрокантилевер нима учун керак? Расмдан фойдаланинг!</p>

		
6.	<p>Scanning near-field optical microscopy (SNOM): illuminates a specimen through an aperture of a size smaller than the wavelength of light used and with the specimen positioned within the near-field regime of the source; by scanning the aperture across the sample through a conventional objective, an image can be formed</p> <p>Сканирловчи яқинхудудли оптикомикроско пиянинг асосий принципининг тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p> <p>Сканирловчи яқинхудудли оптикомикроскопия(SNOM): намунани ишлатилаётган нурнинг тўлқин узунлигидан кичик бўлган ўлчамдаги тирқиши орқали ёритади, намунани яқинхудудли манба режими доирасида жойлаштирилади; оддий объектив ёрдамида намунадаги диафрагманинг сканерлаш йўли билан тасвир шаклланиши мумкин бўлади</p> 	
7.	<p>X-ray photoelectron spectroscopy (XPS): a quantitative surface chemical analysis technique that measures the elemental composition; the technique involves characterization of photoelectrons produced by irradiating a solid material with x-rays</p>  <p>Рентгенфотоэлектронспектроскопия (XPS): кимёвий модданинг юзасини миқдорий анализ қилиш услуби, элемент таркибини аниқлайди; Усул, рентген</p>	<p>Рентгенфотоэле кtronспектроск опиянинг асосий принципининг тушунтиринг? Расмдан фойдаланинг!</p>

	нурлари билан қаттиқ модданинг нурлаш ёрдамида олинган фотоэлектронларнинг тавсифини ўз ичига олади	
8.	<p>Superconducting quantum interference device (SQUID): a device capable of measuring extremely weak magnetic fields</p>  <p>Ўтаўказувчан квантинтерферометр (SQUID): ўта кучсиз магнит майдонларини ўлчаш имкониятига эга мослама</p>	<p>Ўтаўказувчан квантинтерферометр (SQUID) қандай таркибий қисмлардан ташкил топган?</p> <p>Расмдан фойдаланинг!</p>
9.	<p>Nanolithography: a nanofabrication technique for patterning nanoscale features; used extensively in the fabrication of ICs and NEMS</p>   <p>Нанолитография: наноўлчамли деталларни шакллаш учун нано ишлаб чиқариш техникаси; интеграл</p>	<p>Нанолитографиянынг асосий принципининг тушунтиринг?</p> <p>Расмдан фойдаланинг!</p>

	схемалар ва NEMSлар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади	
10.	<p>Melting point oscillation: the phenomenon of suppression of melting point followed by elevation as the particle size is reduced from bulk to sub-nanometre size</p> <p>Суюқланиш хароратининг осцилляцияси: заррачаларнинг ўлчами асосий массадан субнанометргача камайиб миқдорининг ошиши натижасидаги суюқланиш хароратини бостириш ходисаси</p>  <p>Nanothermometer (Ga in Carbon nanotube)</p>	<p>Суюқланиш хароратининг осцилляцияси ва нанотермометр нинг асосий принципининг тушунтиринг?</p>

Назорат саволлари

1. Атом-кучланишли микроскопия (AFM), сканерловчи зонд микроскопияси (СЗМ) ва атом манипуляциясининг асосий принципини солиширинг?
2. Наноиндентификация ва нанолитографиянинг асосий принципининг тушунтиринг?
3. Микрокантилевер нима учун керак?
4. Электрон микроскопия ва сканирловчи яқин худудли оптик микроскопиянинг асосий принципининг тушунтиринг?
5. Ўта ўказувчан квантинтерферометр (SQUID) ва рентгенфотоэлектронспектроскопия нима учун керак?

Фодаланилган адабиётлар

1. David Rickerby Nanotechnology for Sustainable Manufacturing, Taylor and Francis, 2014, 197-212.

5- амалий машғулот:

Композицион материаллар ишлаб чиқаришда мустаҳкамлаштирувчи компонентларни хоссаларини ўрганиш

Ишнинг мақсади:

Композицион материаллар ишлаб чиқаришида қўлланадиган толасимон ва заррасимон мустаҳкамловчи компонентларни хоссаларини ўрганиш.

Элементар толаларнинг асосий механик хоссалари.

Ишнинг мақсади: Элементар толаларнинг механик хоссаларини ўрганиш.

Тола – бу кўндаланг кесим юзанинг кичик кесимида бўйлама ўлчамларининг кўндаланг ўлчамларига нисбатан катта қийматга(10-100 дан кам эмас) эга бўлган материалdir.

Кўпгина толалар чўзилишда юқори механик хоссалар ва юқори эластиклик модулига эгадирлар. Бундай кўрсаткичлар юқори механик хоссаларга эга композицион материаллар (КМ) олишда асосий кўрсаткичлар ҳисобланади.



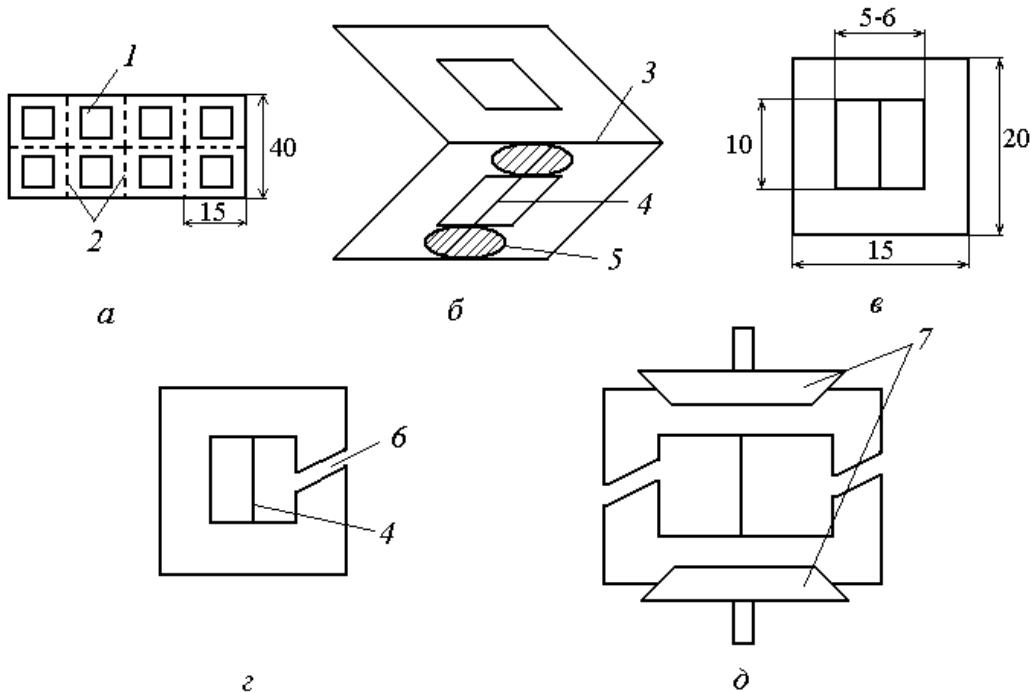
Элементар толаларни механик хоссаларини аниқлаш ГОСТ 6943.5–79 га асосан олиб борилади. Синов учун элементар толадан кесиб олинган ва рамкага қотирилган намуналар қўлланилади. Рамкалар 10 мм узунликда ва 5–6 мм кенгликда тешик кўринишида зич қоғоздан қирқиб олинади (расм 1, *a, б*).

Намунани бузилишигача юкланиш бериш махсус асбобда амалга оширилади (расм 2). Максимал юкланиш F динамометр шкаласи бўйича аниқланади, толанинг узунлиги бўйича ўзгариши Δl – деформация шкаласи ёки горизонтал микроскоп (катетометр) орқали аниқланади. Талаб этилганда деформация диаграммаси тузилади ($F-\Delta l$ боғлиқлик).

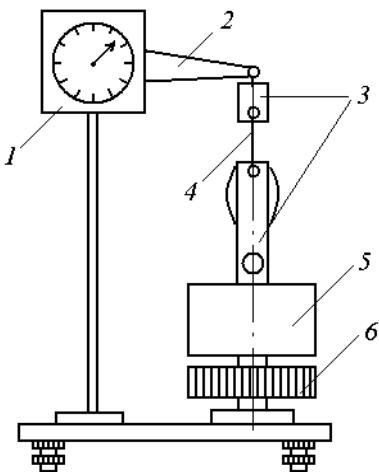
Қўйида баъзи элементар толаларнинг чўзилишидаги диаметр d нинг, бузувчи кучланиш σ_p ва эластиклик модули E_p нинг қийматлари келтирилган (жадвал 1).

Жадвал 1. Элементар толаларнинг кўрсаткичлари.

Тола тури	d , мкм	σ_p , МПа	E_p , ГПа
Шиша толаси	6–20	3450	70–73
Юқори мустаҳкам углеродли тола	7,5–8	2500–3500	200–250
Юқори модулли углеродли тола	7,5–8	2000–2500	300–700



Расм 1. Элементар толалардан механик синов учун намуна олиш. (*а–д* – тайёрлаш босқичлари): 1 –тешиклар; 2 – кесиши чизиқлари; 3 –букиши чизиқлари; 4 – элементар тола; 5 – клей; 6 – кесик; 7 –қисқичлар.



Расм 2. Элементар толаларни бузувчи кучланиш ва эластиклик модулини аниклаш учун асбоб. 1 – динамометр; 2 – ричаг; 3 – қисқичлар; 4 – тола; 5 – стойка; 6 – деформация шкалали маховик.

Бир томонга йўналтирилган толали тўлдирувчиларнинг мустаҳкамлигини аниклаш

Ишнинг мақсади: Элементар толалар мустаҳкамлигини ип ва боғичлар мустаҳкамлигидан фарқини кўрсатиш.

Элементар толаларнинг хоссалари маълум даражада бошқа турдаги толаларнинг хоссаларини аниклайди. Бунда бу хоссаларни амалга ошириш қайта ишлаш усули ва ҳарактерига боғлик бўлади. Шунинг учун бир томонлама йўналтирилган тўлдирувчиларнинг механик хоссалари элементар толаларнинг механик хоссаларидан паст бўлади.

Мустаҳкамловчи тўлдирувчиларни асосий механик хоссалари эластиклик модули ва чўзилишдаги бузилиш кучланиши ҳисобланади.



Бу синовларда рамкаларга қотирилган кесма намуналар қўлланилади. Намунага Р-05 типдаги универсал машинада бузулгунча 60-100мм/мин ўзгарувчан тезликда юкланиш берилади. Берилган қучланишларни куч ўлчаш шкаласи бўйича ўлчанади.

Керак бўладиган асбоблар ва материаллар: шиша ип ва шиша боғлардан кесмалар, намуналарни махкамлаш учун рамкалар, қайчилар, клей, синовчи машина.

Ишнинг бориш тартиби. Синов олиб бориш ва намуналарни тайёрлаш ГОСТ 6943.10-79 га мувофиқ олиб борилади.

220 мм узунликдаги ип кесмалари рамкаларга қотирилади. Елимланган иплар намуналарга ажратилади ва синов машинаси қисқичларига қотирилади. Бунда елимланган қисм 8-10 мм ташқарига чиқиб туриши,

қисқичлар орасидаги масофа 100 ± 1 мм ни ташкил этиши керак.

Намуналарга 60-100 мм/мин тезликда синов машинасида кучланиш берилади ва бузилиш вақтидаги юкланиш қайд қилинади. Олинган қийматлар бўйича чўзилишдаги мустаҳкамлик σ_p (МПа) қуйидаги формула орқали хисобланади:

$$\sigma_p = \frac{F_p}{A},$$

Бу ерда F_p – бузувчи юкланиш, Н; $A = \frac{T}{\rho} \cdot 10^{-3}$ – толанинг умумий юзаси, мм^2 ; T – тўлдирувчининг чизиқли зичлиги(маълумотномадан олинади); ρ – тўлдирувчи материали зичлиги, г/см^3 .

Эксперимент камидаги ўн марта қайтарилини ва ўртача қиймати олинади. Олинган натижалар худди шу турдаги элементар тола натижалари билан солиштирилади ва хulosалар чиқарилади. Олинган натижалар қайд этилади.

Бир томонга йўналтирилган толали тўлдирувчиларни эластиклик модулини аниқлаш.

Керак бўладиган асбоблар ва материаллар: шиша ип ва шишабоғламлар кесмалари, рамкалар, клей, синов машинаси, катетометр, штангенциркуль.

Иш тартиби. Рамкаларга қотирилган намуналарга намунанинг марказидан юқори ва паст томонга 25 мм масофада бўёқ билан белги қўйилади.

Белгилар орасидаги масофа l_0 (катетометр, штангенциркул ёрдамида) бошланғич юкланиш F_0 да ўлчанади. Намунага секин аста юкланиш ΔF F_1 кучгача берилади ва намунанинг узунлиги Δl ўлчанади. Синов 2-3 марта такрорланади ва намунанинг ўртача чўзилганлиги аниқланади.

Тўлдирувчининг элатиклиқ модули E_p (МПа) қуйидаги формула орқали хисобланади:

$$E_p = \frac{\Delta F \cdot l_0}{\Delta l \cdot A},$$

Бу ерда ΔF – ўсиб борувчи юкланиш, Н; l_0 – белгилар орасидаги масофа, мм; Δl – чўзилган намуна узунлиги, мм; A – толанинг умумий юзаси, мм^2 .

Эксперимент камидаги ўн марта қайтарилини ва ўртача қиймати олинади. Олинган натижалар худди шу турдаги элементар тола натижалари билан солиштирилади ва хulosалар чиқарилади. Олинган натижалар қайд этилади.

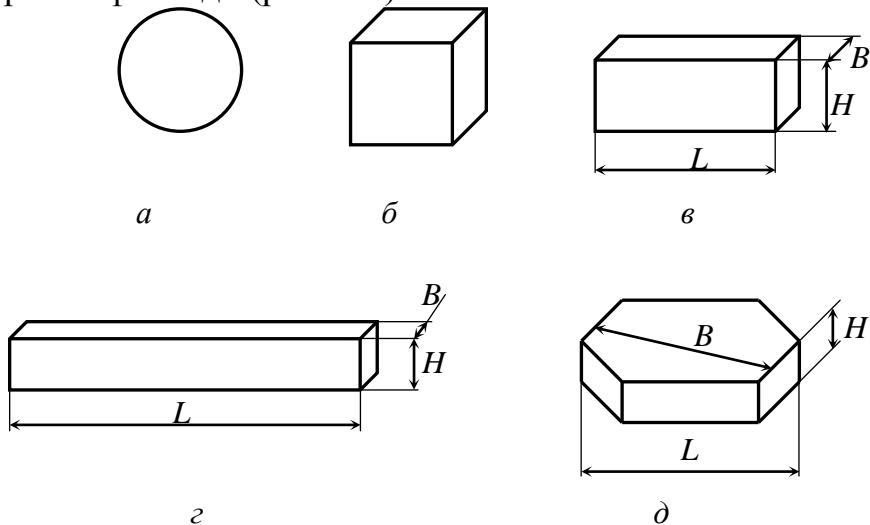
Композицион материаллар ишлаб чиқаришда заррасимон тўлдирувчиларни грануламетрик таркиби ва хоссаларини ўрганиш.

Ишининг мақсади: тўлдирувчиларнинг асосий геометрик тавсифини

аниқлаш.

Тўлдирувчиларни танлаш аввало, унинг зарраларининг ўлчамлари ва зарраларнинг шакли ва тавсифига боғлиқ.

Заррали материаллар тавсифий ўлчамлари нисбатига боғлиқ ҳолда шаклига кўра синфланади (расм 10).



Расм 3. Тўлдирувчи зарраларни ўлчами ва турлари:

а – сфера; б – куб; в – параллелепипед; г - толасимон; д - тангасимон.

L- узунлик; *H* – баландлик; *B* – кенглик.

Кўпгина тўлдирувчиларнинг зарраларининг шакли бир – биридан кескин фарқ қиласди. Шунинг учун уларнинг юзасининг зарраси синфланиш учун хизмат қиласди. Бу мақсадда зарраларни ўлчамини тавсифлайдиган тушунча-эквивалент сфера диаметри(ЭСД) киритилган.

Калта толали тўлдирувчиларнинг геометрик ўлчам ва заррасининг шаклини аниқлаш

Керак бўладиган асбоблар ва материаллар: ёғоч қириндиси, шоя толаси, лънокостра, микроскоп, штангенциркуль, микрометр.

Иш тартиби. Текис юзага маълум миқдордаги тўлдирувчи бир текис ёйилади. Ўлчаш учун штангенциркуль ёки микрометр, жуда майда зарралар учун эса (<0,1 мм) микроскоп ишлатилади.

Зарранинг тегишли ўлчамлари аниқланади (узунлиги, кенглиги, қалинлиги) ва максимал ва минимал ўлчамларнинг нисбати аниқланади.

Турли тўлдирувчилар зарраларининг шакли аниқланади ва чизилади. Олинган натижалар 5 жадвалга ёзиб борилади.

Кукунсимон тўлдирувчилар зарраларининг шакли ва ўлчамларини аниқлаш.

Керак бўладиган асбоблар ва материаллар: турли типдаги кукнсимон тўлдирувчилар, типов, микроскоп, шиша предметлар.

Ишнинг тартиби. Зарраларни шакли ва ўлчамларини аниқлаш учун маълум миқдордаги тўлдирувчи олдиндан намланган шиша предмет юзасига жойланади ва устидан иккинчи шиша билан ёпилади. Бунда тўлдирувчини текис тақсимланиши ва зарраларининг бир-биридан алоҳида –алоҳида бўлишига эътибор берилади.

Намуна микроскоп столчасига ўрнатилади. Керак бўлган катталаштириш ва кескинлик танланади. Зарраларнинг шакли аниқланиб чизиб борилади. Зарраларнинг асосий ўлчамлари ва ЭСД ҳисобланади.

Тўлдирувчиларнинг гранулометрик таркибини ўрганиш.

Ишининг мақсади: Таҳлилнинг элаклар усулини ўрганиш.

Тўлдирувчини танлашда аввало унинг зарраларининг ўлчамлари ва ўлчамлар бўйича таксимланганлиги аниқланади.

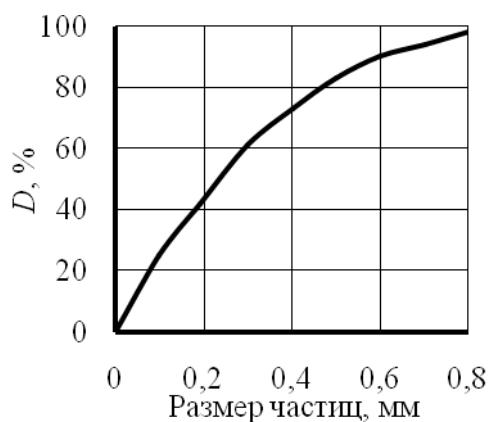
Кукунсимон материалларнинг гранулометрик таркиби кукундаги турли ўлчамдаги зарраларнинг ўзаро нисбати ва қанча миқдордан мавжудлиги тўғрисида маълумот олишга ёрдам беради.

Зарраларнинг ўлчамини аниқлашнинг бир нечта усуллари мавжуд: элаклар ёрдамида(зарралар ўлчами 0,06 дан 19 мм гача), микрометрик (0,001дан 0,06 ммгача), седиментацион (0,0001дан 0,06 ммгача).

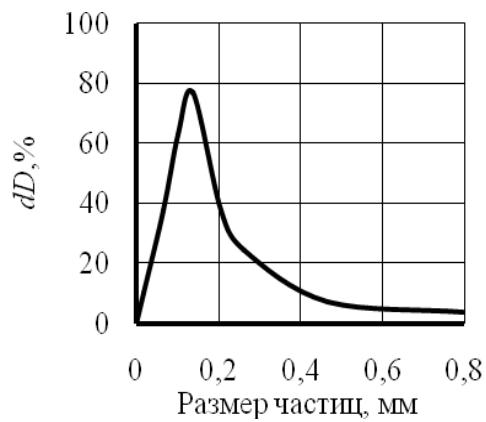


Элаклар усули материал намунасининг стандарт элаклар тўпламидан ўtkазиш орқали фракцияларга ажратишга асосланган. Бу усул дисперс анализнинг асосий усули ҳисобланади. Лекин бу усул зарраларнинг ҳақиқий ўлчамларини аниқлай олмайди.

Гранулометрик таркиби аниқлашда ажралиш даражаси тақсимланиши D (расм 11, *a*) ва фракцияларнинг нисбий сақланиши dD (расм 11, *b*) зарра ўлчамлари δ га боғлиқликлари тузилади.



a



Б

*Расм 4. Ажралии даражаси тақсимланиши функция кўринишлари (*a*) ва фракцияларнинг зарра ўлчамига нисбийлиги (*b*).*

Майда дисперс материаллар ўлчамини аниқлашда асосан седиментацион усул қўлланилади.

Микроскопик усул зарраларнинг чизиқли ўлчамларини аниқлашдаги энг аниқ усул ҳисобланади, лекин анча меҳнат ва вақт талаб этади.

Амалий машғулот вазифалари:

1- вазифа.

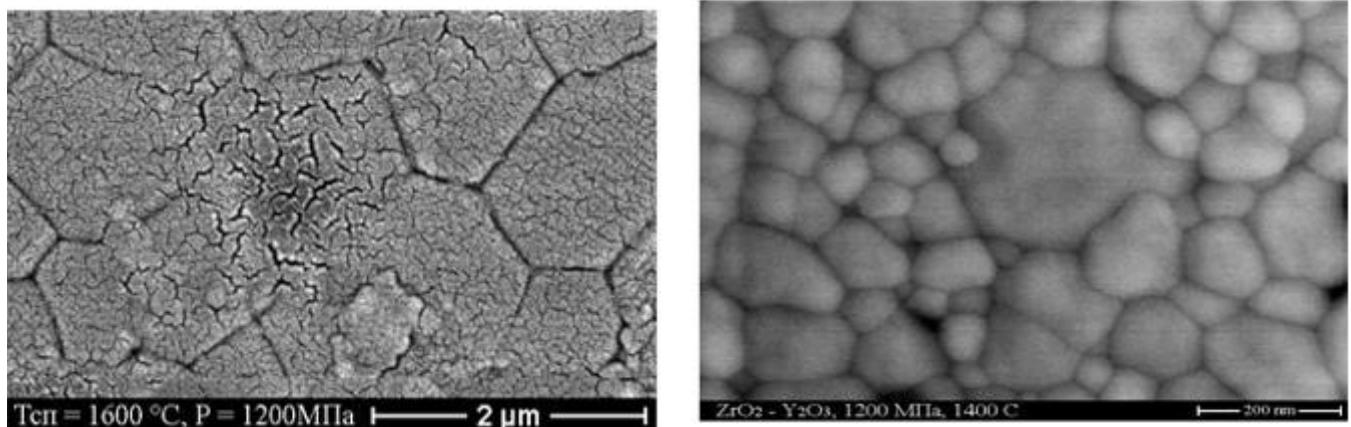
Жадвалда келтирилган қийматлар асосида материал ўлчамларига боғлиқ ҳолда фракцияларни мавжудлиги диаграммасини тасвирланг.

Сармат қумининг гранулометрик таркиби

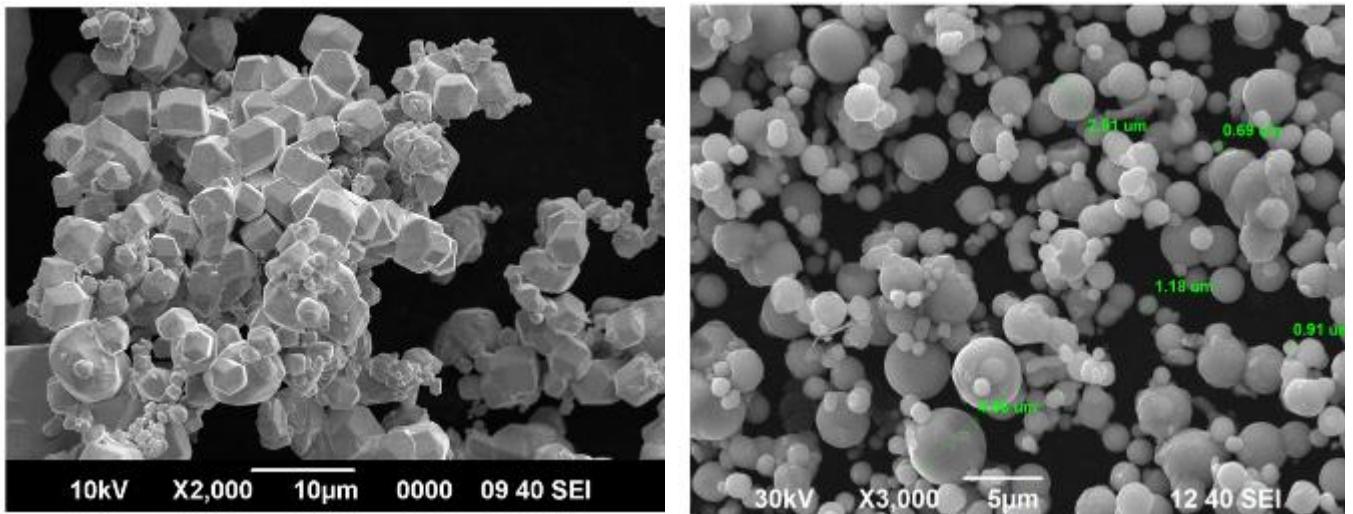
Проба №	Заррачалар миқдори, мас.%	Элақдаги тешиклар ўлчамлари , мм					
		2,5	1,25	0,63	0,3	0,14	0,14 элақдан ўтган
94	1,6	0,6	2,1	17,3	84,4	98	1,9
95	6,8	1,5	4,3	20,7	69,7	95,3	4,6
98	22,6	-	1,1	4,9	42,3	87,5	12,1
99	16,1	-	-	0,6	24,4	83,1	16,8
100	22,7	-	-	1	26,6	78,9	20,6
101	2,8	0,3	1,3	13,8	67,6	96,2	3,4
102	2,7	-	0,2	2,8	37,6	92,9	6,8

2- вазифа.

Келтирилган микроскопик 5,6-расмлардан фойдаланиб, асосий кристалл фазалар ўлчамларини аниқланг.



Расм 5. Керамик материалнинг электрон-микроскопик расми. (электронный микроскоп ЭВМ-100)



Расм 6 – Вольфрам карбиdi ва темири кукунларининг электрон-микроскопик расмлари.

Назорат саволлари:

1. Бир томонлама йўналган толали тўлдирувчиларни келтиринг ва тушунтиринг.
2. Толасимон тўлдирувчиларни юкланишдаги ҳолати нима мақсадда ўрганилади?
3. Чизиқли зичлик нимани тавсифлайди, нималарга боғлиқ ва қандай аниқланади?
4. Элементар тола ва бир тоионлама йўналган толасимон тўлдирувчиларнинг чўзишишга мустаҳкамлиги нимаси билан фарқ қиласи?
5. Чўзишишга мустаҳкамликни аниқлашда намуналар қандай тайёрланади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Krishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012. -98-101, 249-306 p.
2. Morgan P. Carbon fibers and their composites / Morgan P. - Boca Raton: Taylor & Francis, 2005. (Materials engineering; vol.27). - ISBN 0-8247-0983-7. 1153 p.
3. D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. -319-350 p.
4. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010. -655-660 p.
5. Стекловолокно. Нити крученные комплексные. Технические условия: ГОСТ 8325–93 (ИСО 3598-86). – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 12с.
6. Ю.Н. Сидоренко. Конструкционные и функциональные волокнистые композиционные материалы : учебное пособие. -Томск : Изд-во ТГУ, 2006. – 107 с.

V. БИТИРУВ ИШЛАРИ УЧУН МАВЗУЛАР

1. Композицион материаллар структура тузилиши, структура ўрганишда замонавий физик кимёвий таҳлил усуллари.
2. Нометаллар асосида композицион материаллар.
3. Кукун металлургия усули ёрдамида композицион материаллар ишлаб чиқариш.
4. Пўлатлар ишлаб чиқаришда феррит-цемент композициялар.
5. Металл куқунлар, уларнинг хоссалари ва қўлланилиш имкониятлари.
6. Толали композицион материаллар.
7. Шишапластиклар ишлаб чиқариш жараёни.
8. Шиша арматураси ишлаб чиқариш жараёни.
9. Триплекс тузилиши, хоссалари ва ишлаб чиқариш технологик жараёни.
- 10.Мустаҳкамлаштириш компонентлар: толалар турлари ва хоссалари.
- 11.Углерод толалари асосида замонавий композицион материаллар.
- 12.Биокомпозитлар, уларнинг қўлланиш имкониятлари.
- 13.Композицион материаллар ишлаб чиқаришда матрица материаллари.
- 14.Композицион материаллар ишлаб чиқаришда полимерларнинг ўрни.
- 15.Полимер матрицали композицион материаллар ишлаб чиқариш технологик жараёни.
- 16.Керамик матрицали композицион материаллар ишлаб чиқариш технологик жараёни.
- 17.Металл матрицали композицион материаллар ишлаб чиқариш технологик жараёни.

VI КЕЙСЛАР БАНКИ

1-кейс

Нефт тўкилиши ва наноматолар

Бритиш Петролеум (British Petroleum) ташкилотига қарашли нефт платформасидаги портлаш туфайли 2010 йил 22-апрелда бошланган Мексика кўрфазидаги нефт ёйилиши АҚШ тарихидаги энг катта нефт тўкилиши ҳисобланади. Май ойининг ўрталарига келиб эксперталарнинг хисобларига кўра океанга 60000 баррел нефт оқиб чиқкан. Маълумки нефтнинг бир тоннаси сув юзасида ёйилиб 12 км^2 юзасини қоплади; нефтнинг бир баррели 136,4 кг массага эга; Мексика кўрфазининг умумий майдони тахминан 2,5 млн. км^2 эга.

Саволлар:

- 1) Мексика кўрфазига оқиб чиқкан нефтнинг тоннадаги массаси нимага тенг?
- 2) Нефт пленкаси билан қопланиши мумкин бўлган сирт юзасини аниқланг?
- 3) Кўрфаз умумий майдонининг неча фойиз қисми нефт пленкаси билан қопланганлигини аниқланг?
- 4) Nature Nanotechnology журналидаги мақолада эълон қилинишича олимлар, “матонинг” оғирлигидан 20 баробар ортиқ оғирликдаги нефтни абсорбциялаш имкониятига эга бўлган нанотолалардан тўқилган наномато кашф қилишган. Мексика кўрфазидаги нефт тўкилишини бартараф этиш учун неча кг наноматодан ишлаб чиқариш зарур?

2-кейс

Юпқа қаватли қуёш батареяларини ишлаб чиқариш учун микроскоп танлаш.

Ўзбекистонда бир йилда қуёшли вақт шимолда 2000 соат, жанубда эса 3000 соатдан кўпроқ бўлганлиги сабабли, Ўзбекистонда кўп йиллардан бери қуёш энергетикаси соҳасида тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Қуёш энергетикаси панелларини ишлаб чиқариш сифатини назорат қилиш замонавий лабораториясига юзаларнинг хажмий тасвирларини олиш учун микроскоп харид қилиш зарур. Юпқа пленкаларнинг юзасини ва юпқа пленкали қуёш батареяларнинг наноқопламаларининг мустахкамлигини назорат қилишучун харид қилинадиган микроскоп турини танлаб олинг.

Танланган микроскоп ёрдамида монокристалл ва поликристалл батареяларни тадқиқ қилиш мумкинми?

Кейснинг ечиш учун қуидагилар талаб этилади:

- 1) қуёш батареялари турлари ва ишлаш принциплари тўғрисида таъсуротга эга бўлиш керак;
- 2) наноқопламалар мустахкамлигининг оптик ва электрон микроскопиясининг турли хил маълумотларидан олиниши мумкин бўлган

ахборот турларини билиш.

Қуёш батареяларининг ишлаш принципи

Фотоэффектнинг мазмуни қуёш энергиясини доимий токга ўзгартиришга асосланган. Баъзи бир моддаларнинг (мисол учун кремнийнинг) электронлари қуёш нурларининг энергиясини ютиш қобилиятига эга, ўз орбиталларини ташлаб йўналувчи оқим – фототокни хосил қиласди. Бу эффектни хосил қилиш учун маҳсус моддалар – p- ва n- ўтказувчанликлар ярим ўтказгичлар қўлланилади. N- ўтказувчанлик моддадаги электронларнинг ортиқча микдорини ифодалайди, p- эса тегишли равишда уларнинг етишмовчилигини ифодалайди. Фотоэлементни хосил қилиш учун, электрон батареяга ўхшашликни хосил қиласдиган, иккита ярим ўтказгич керак бўлади, бунда катод ўрнида n-ярим ўтказгич анод ўрнида эса p-ярим ўтказгич бўлади. Тушаётган нурлар таъсирида n- ўтказгич (структуранинг тепа қисмида жойлашган бўлади) электронлари р-қаватга ўтади, натижада электронларнинг йўналтирилган оқими вужудга келади. Бу каби тизим, унинг ишлаши кимёвий таъсирлашувга боғлиқ бўлмаганлиги ва натижада материалнинг емирилиши бўлмаганлиги сабабли нихоятда узок вақт мобайнида ишлаши мумкин.

Қуёш фотоэлементлари

Кремнийнинг кенг тарқалганлиги ва ишлаб чиқариш жараёни катта харажат талаб этмаслиги сабабли хозирги кунда қуёш элементлари кремний асосида ишлаб чиқарилади. Кремнийга турли хил турдаги ўтказувчанлик қобилиятини бериш учун турли хил аралашмаларни қўллашади. Мисол учун, электронларнинг ортиқча микдори бор киритилиши натижасида, етишмовчилиги эса мишякнинг киритилиши натижасида эришилади. Шунингдек арсенид, галлий, кадмий ва бошқалар қўлланилади. Ўтказувчанликни шакллантириш билан бир қаторда аралашмаларнинг қўшилиши кремний асосидаги батареяларнинг самарадорлигини ошишига олиб келади, уларнинг ФИК (КПД) ўртача 20% га teng.

Хозирги кунда, юқорисамарадор ва иқтисодий фойдали қуёш батареяларини олишга йўналтирилган бу соҳадаги фаол тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Қуёш батареяларининг турлари

Кремний асосида фотопанелларнинг у тури ишлаб чиқарилади:

- Монокристаллардан. Уларни ишлаб чиқариш учун бир турдаги структурали монокристаллар ўстирилади. Натижада бундай фотоячейкалар бир теккис меъёри юзаси билан фарқланади, бунинг оқибатида қуёш нурларини яхшироқ ютади, юкори ФИК (КПД) га эга, бироқ нархи қимматроқ бўлади.

- Поликристалл ячейкалар нотеккис, поликристалл структурага эга бўлиб, нур ютиш қобилияти моноячейкалардан бир неча баробар пастроқ бўлади, чунки нотеккис юзаси нурларнинг бир қисмини қайтаради.

- Юпқа қаватли қуёш батареялар кристалсимондир. Бирок улар эгилувчан ячейкалар күринишида ишлаб чиқарилади. Уларни қийшиқ юзаларда ўрнатиш мумкин бўлади. Бу батареяларни ишлаб чиқариш арzon, қувват бирлигига кристалсимонларга нисбатан(таксинан 2,5 маротаба) кўпроқ юзани эгаллади.

Юпқа қаватли қуёш батареяси яримўтказувчан бирикмани эгилувчан (одатда - полимер) тагликка пуркаш натижасида хосил бўлади. Даставвал яримўтказгич сифатида фақатгина аморф кремний қўлланилган, бирок бунда олинган фотоэлементларнинг ишлаб чиқариш қуввати нихоятда кичик бўлган (атиги 4 – 5 %). Хозирги кунда мис-галлий-индий селенид асосидаги пленкалар истиқболли хисобланади. Мис-индий-галлийли батареяларининг ФИК (КПД) 20%гача етиши мумкин. Бирок хозирча бу каби элементларнинг юпқа қуёш пленкалари бозоридаги ўрни унчалик катта эмас (таксинан 2%). Кадмий теллурид асосидаги пленкалар кенгроқ тарқалган (таксинан 18%, ФИК (КПД) 16% гача). Аморф-кремнийли батареяларга бўлган талаб юқори. Уларнинг ФИК (КПД) 10%гача ошириш имконияти туғилган.

Мантикий кетма-кетликни тузиш керак:

Намуна тури (юпқа пленкалар) -----

Микроскоп тури (электрон еки оптик) -----

Микроскоп имконияти (микро еки нанометр чегараси?) -----

Намунани тасвирлаш шартлари (вакуум еки вакуумсиз, яssi еки 3D-тасвир, атом монипулятори еки наноинтендер?) -----

AFM -----

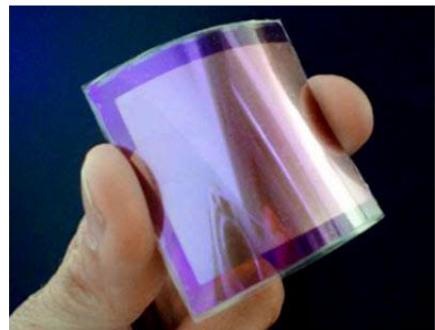


TABLE 3.1 Chart of Microscopy and Type of Information Generated

Microscopy	Resolution Limit	Characteristics
Light microscopy	~0.2 μm	Samples can be imaged in liquid or air. Resolution is limited by the wavelength of visible light.
Fluorescent microscopy	~0.2 μm	Samples can be imaged in liquid or air. Fluorescence labeling is a well-developed technique that can be used to localize molecular components.
Confocal microscopy	Micrometer level	Confocal scanning microscopy enables three-dimensional studies of biological objects. Resolution techniques that break the optical resolution barrier are becoming available.
Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM)	Nanometer level	For FE-SEM imaging, the sample is placed in a vacuum. Sample coating may be needed, as the technique generally requires an electron-conductive sample. The electron beam is used to probe the surface, and techniques for heavy metal labeling of surface molecules are often used.
Transmission electron microscopy (TEM)	Nanometer level	Image contrast depends on impeding electrons as they pass through the sample, usually by heavy metal staining. Operates under vacuum with resolution depending primarily on image contrast through staining. New advances allow imaging samples in a liquid cell.
Scanning tunneling microscopy (STM)	Nanometer level	Allows a relatively flat surface to be imaged by rastering a biased-atomically sharp needle point over a conducting (or semiconducting) surface. Samples can be imaged in ambient conditions and inside various electrolytes. STM can provide images down to atomic and molecular resolution as well as provide 3-dimensional visualization of the surface. Atomic manipulation of atoms and molecules can be achieved with an STM to create novel nanostructures.
Atomic force microscopy (AFM)	Nanometer level	Imaging is accomplished by monitoring the position of a sharpened tip attached to a microcantilever as it is scanned over a sample surface. Samples can be imaged in liquid or air with nanometer resolution at atmospheric pressure enabling dynamic studies. AFM provides three-dimensional surface visualization and measurement of nanomechanical properties of the sample.

3-кейс Нанозаррачалар ва ранг эффектлари

Қадимий католик черковларидағи рангли витражлар ва Британия музейида сақланаётган Ликург қадаҳи ноёб санъат намуналаридан

хисобланади. Олтин ва кумушнинг наноўлчамли заррачалари кукуни қўшилган шишадан ясалган қадаҳ қайтарилган нурда яшил тусга, сингиб ўтувчи нурда эса қизил тусга киради. Хозирги кунда бу каби санъат намуналарини қайтадан ясаш мумкин-ми, еки усталарнинг сирлари изсиз ёқолганми?

Америкалик физиклар, IV асрнинг бошларида римликлар ишлатган рангли шишани олиш технологиясини кимёвий сенсорлар ва касалликларни аниқлашда – диагностикасида қўллашни таклиф қилишган. Муаллифлар томонидан кашф қилинган кимёвий сенсорлар тахминан миллиард наноўлчамли тешиклар қилинган пластик пластинадан ташкил топган. Хар бир тешикнинг деворчалари олтин ва кумушнинг нанозаррачаларини ўзида сақлаб уларнинг юза электронлари детекция жараенида марказий ролни ўйнайди.

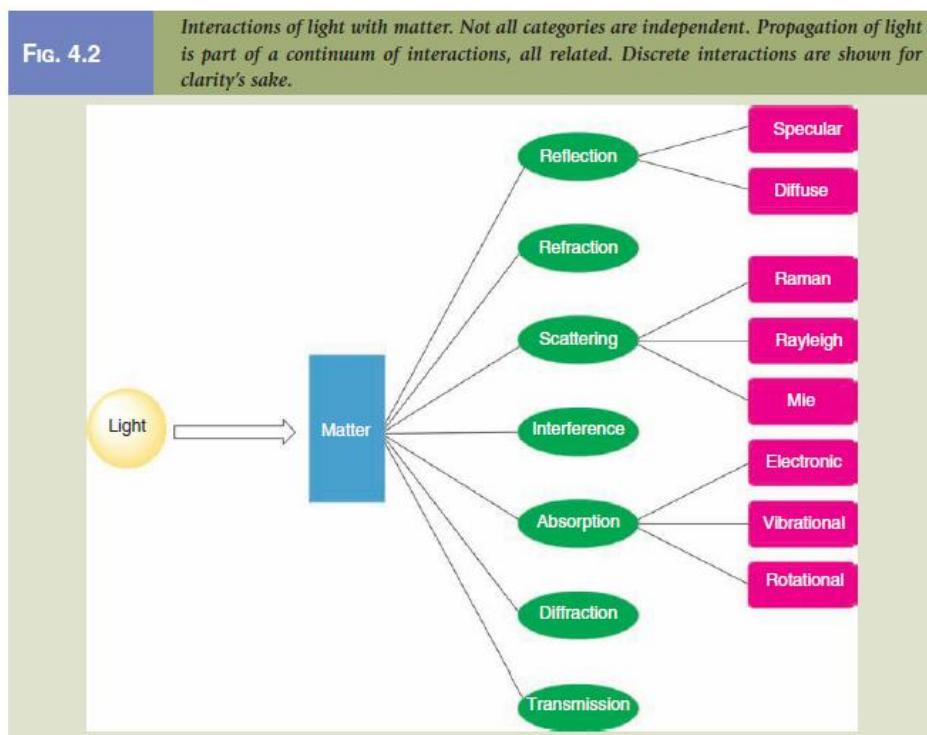
Кейсни ечиш учун ахборот турларини ва қуйидаги саволларга жавобларни билиш талаб этилади:

Нур энергияси ва тўлқин узунлиги қандай боғланган?

Қандай нурнинг частотаси юқорироқ: қизил ёки бинафша?

Қандай оптик ходисалар сизга маълум?

Материалдаги ранг эфектлари ва заррачаларнинг ўлчами қандай боғланган?



Интерференция. Сув ва сирт фаол моддаларнинг пулакчалари сиртидаги ранг пулакчанинг қалинлигига боғлиқ. Анодланган титандан ишланган заргарлик буюмлари одатда турли хил қалинликдаги оксидланган қават туфайли ёрқин ранларни намоён қиласди – бронза ($L \approx 300$ нм), кўк ($L \approx 400$ нм), сарик ($L \approx 600$ нм), вақиқизил ($L \approx 700$ нм).

Дифракция. Дифракцион ранг тасвирнинг энг ёрқин мисоли бўлиб компакт-диск хисобланади.

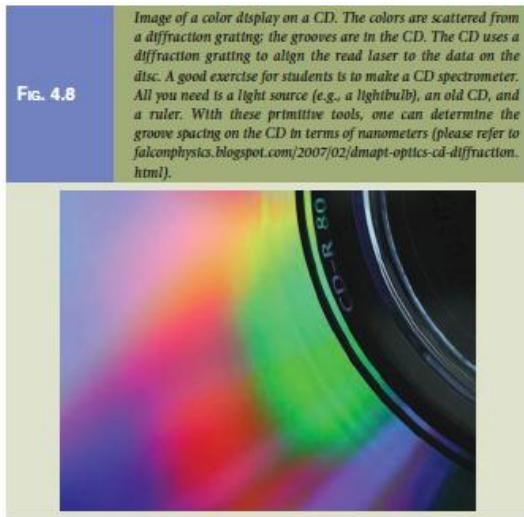


Fig. 4.8

Image of a color display on a CD. The colors are scattered from a diffraction grating; the grooves are in the CD. The CD uses a diffraction grating to align the read laser to the data on the disc. A good exercise for students is to make a CD spectrometer. All you need is a light source (e.g., a lightbulb), an old CD, and a ruler. With these primitive tools, one can determine the groove spacing on the CD in terms of nanometers (please refer to falconphysics.blogspot.com/2007/02/dmapt-optics-cd-diffraction.html).

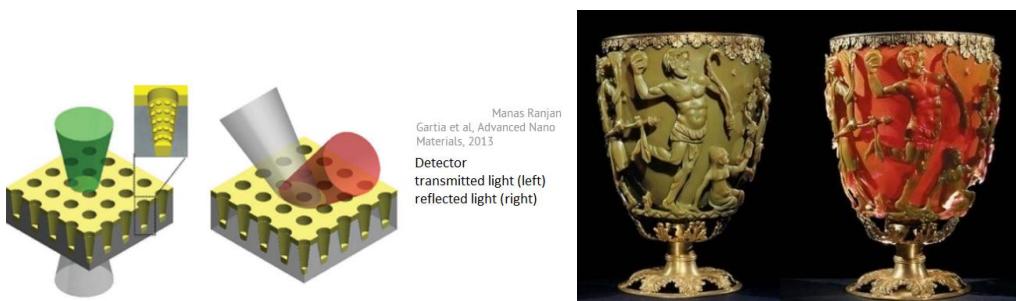
for the plasmon resonance. They are, with their protecting ligand shell, around 4 nm in diameter. The color is a ruby red with λ_{max} at ca. 520 nm.

Color Due to Quantum Fluorescence. Semiconductor quantum dots are known for their intense fluorescent colors. Although made of exactly the same material, different colors are generated due simply to the difference in size of the quantum dots (QDs) (Fig. 4.9).

Тарқатиш - тарқоқлик. Турли хил ўлчамли заррачаларнинг ва турли хил тўлқин узунликларининг комбинацияси. Осмон кўк тусда кўринади, чунки қисқа тўлқинлар молекулалар билан тарқоқлантирилади. Осмон қизил рангда хам бўлади, чунки узун тўлқинлар (мисол учун қизиллари) каттароқ заррачалар билан тарқоқлаштирилади.

Юзаки плазмон. Бирон бир модданинг тирқиши ичида боғланишида нанозаррачаларнинг юзасидаги плазмонларнинг (металлдаги эркин электронларнинг иккиланишини қайтарувчи квазизаррача) резонанс частотаси ўзгаради, бу ўз навбатида пластинкадан ўтувчи тўлқин узунлигини ўзгаришига олиб келади. Бу усул юзаки плазмонли резонансга (SPR) ўхшайди, бироқ ундан фарқли ўлароқ, нурнинг тўлқин узунлигини анчагина салмоқлироқ силжишига олиб келади – тахминан 200 нанометр. Бундай сингналга ишла бериш мураккаб ускуналарни талаб этмайди, шунинг учун моддаларнинг боғланишини қуролланмаган кўз билан хам детектираш мумкин.

Америкалик олимлар томонидан ишлаб чиқилган сенсорларнинг турли хил моддаларга нисбатан сезувчанлигини тешиклар юзаларида ўзига хос антителаларнинг иммобилизацияси билан таъминланади. Олимларнинг сўзига кўра кимёвий детекторнинг тузилиши Британия музейида сақланаётган римнинг Ликург қадаҳининг ноёб хоссалари томонидан айтиб берилган. Қадаҳ шишасининг таркибидаги металл нанозаррачалари нурнинг тушиш бурчагига боғлиқ равишда унинг тўлқин узунлигини ўзgartиради. Шундан келиб чиқсан холда муаллифлар қурилмани “наноўлчамли ликург қадаҳлари матрицаси” деб номлашган (nanoscale Lycrus cup arrays – nanoLCA).



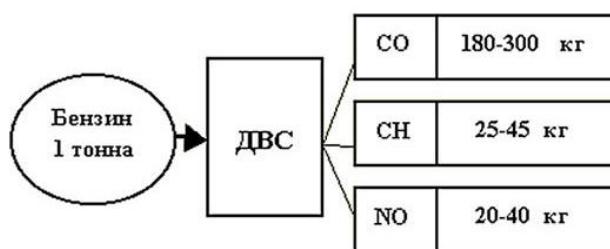
Флуоресценция. Квант нукталари ҳайротомуз хоссаларга эга: уларнинг ўлчамига боғлиқ равища турли хил рангларни таратиши мумкин. Идишчалар турли ўлчамлардаги нанозаррачалар эритмалари билан (гептандаги олеин кислотаси билан қопланган кадмий селенидининг квант нукталари коллоид эритмаси) тўлдирилган. Бу суспензияларни кўзга кўринмайдиган ултрабинафша диапазонидаги нур билан нурлантириш натижасида нур сочишга ундаш мумкин. Бу заррачалардан таралаётган нурнинг частотаси заррачаларнинг ўлчамлари ўсиши билан камаяди.

4-кейс Наноматериаллар ва экология

Нанозаррачалар юқори кимёвий фаолликка эга бўлиб ажойиб катализаторлар хисобланади. Бундай холатнинг асосий сабаби нанозаррачаларнинг юзасида жойлашган атомлар билан боғлиқ. Бу атомлар бошқа атомлар билан кучсизроқ боғланганлиги сабабли қўшимча энергияга эга.

Маълумки, автомобиллар атроф муҳитга ва инсон саломатлигига салбий таъсир қўрсатади. Шундай қилиб ички ёниш двигателларнинг чиқинди газларида куйинди газ (CO), циклик ароматик углеводородлар (CH), азот(II) оксиди (NO) (тасвирга қара) лар топилган.

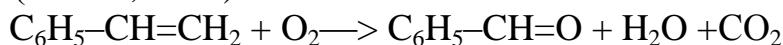
Ички ёниш двигателларнинг чиқинди газлари



Автомобилларнинг чиқинди газларини каталитик оксидлаш қурилмаларида атмосферага чиқарилаётган заарли чиқиндиларни камайтириш мақсадида платина қўлланилиши мумкин. Платина углерод (II) оксидини углерод (IV) оксидига айлантириш имкониятини беради. Нанозаррачалар кўринишида бўлган платина ўзининг каталитик хоссаларини янада кучлироқ намоён этади.

TiO_2 юзасига қопланган 55 атомларни (диаметри 1,4 нм) ўзида сақловчи олтин нанокластерлари стиролни хаво кислороди билан

бензалдегидгача танловчанлик асосида оксидловчи катализатор сифатида хизмат қиласи (*Nature*, 2008):

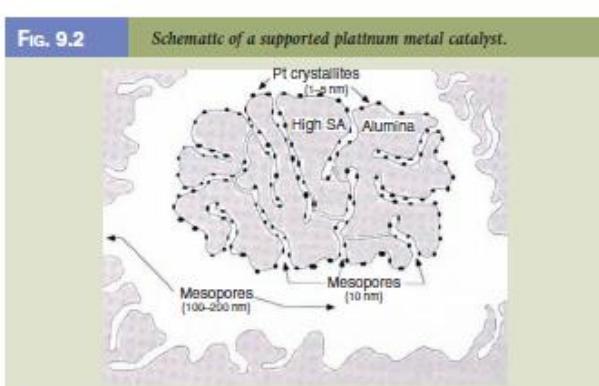


Қизиқарлisisи шундаки, 2 нм дан юқори ўлчамдаги диаметрли заррачалар, шу билан бирга оддий олтин хам хеч қандай катализтик фаолликни намоён этмайди.

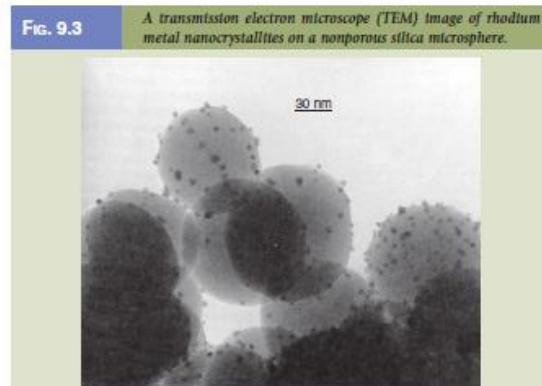
Саволлар:

- 1) Углерод (II) оксидини углерод (IV) оксидига айлантириш тенгламасини тузинг. Бу жараённи амалга ошиши учун платинадан ташқари нима керак бўлади?
- 2) Тўлиқ битта бак (40 л) А-92 маркали бензиннинг (бензиннинг зичлиги 0,75 г/см³) ёнишидан хосил бўладиган заарли чиқиндиларнинг массалари диапазонини хисобланг.
- 3) 3,5 см³ металлдан қанча Pt₂₀таркибли нанозаррачаларни олиш мумкин бўлади? (платиннинг зичлиги 21,45 г/см³).
- 4) Қандай қилиб ихчамлик билан кимёвий реакторда нанозаррачаларни жойлаштириш мумкин бўлади?

Жавоблар: 1) CO – 5,4 кг дан 9 кг гача; CH – 0,75 кг дан 1,35 кг гача; NO 0,6 кг дан 1,2 кг гача 2) 1,16.10²²



Source: R. Farnault and C. Bartholomew, *Fundamentals of industrial catalytic processes*, John Wiley & Sons, (2006). With permission.



Source: S. Chakraborti, A. K. Datye, and N. J. Long, *Journal of Catalysis*, 108, 444-451 (1987). With permission.

5-кейс

Ўзбекистондаги нанотехнологиялар асосидаги тўқимачилик маҳсулотлари

01.04.2014

Кундалик ишлатиш учун бактерицид тўқимачилик маҳсулоти сертификациялаш ва оммавий ишлаб чиқариш босқичида турибти. Ишлаб чиқариш технологияси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Полимерлар физикаси ва кимёси институтида ишлаб чиқарилган.

Хозирги кунда кумушнинг нанозаррачалари асосидаги кўп миқдордаги наноматериаллар ишлаб чиқарилган. Хозирда кумуш нанозаррачали тиш шеткалар ва тиш пасталари ишлаб чиқарилмоқда, улар турли хил инфекциялардан химоя қиласи. Кумушнинг нанозаррачалари оз миқдорда

косметика махсулотларига хам қўшилиб келинмоқда, уларнинг таъсирида яллиқланишнинг олди олинади ва яраларнинг битиши тезлашади. Кўпгина қаттиқ моддаларга (шиша, ёғоч, қофоз, керамика, металларнинг оксидлари ва бошқ.) суртилишидан сўнг хам нанозаррачалар узоқ вақт ўзининг бактерицид хусусиятларини сақлаб қолади. Бу холат юқорисамарадор узоқ вақт таъсир этувчи дезинфекцияловчи аэрозолларни ишлаб чиқариш имкониятини беради. Агарда биноларнинг юзларига суртиладиган лок-бўёқ махсулотларига кумушнинг нанозаррачалари қўшилса бу махсулотлар билан бўялган девор ва шипларда патоген микроорганизмларнинг яшashi мумкин бўлмайди. Сувни тозалаш филтрларидағи кўминаларга кумушнинг нанозаррачаларининг қўшилиши бундай филтрларнинг хизмат муддатини узайтиради ва тозаланаётган сувнинг биологик тозалиги ортади.

Нанозаррачалар нафақат фойда балки зарар хам етказишлари мумкин. Кумушнинг нанозаррачалари инъекция сифатида сичқонларнинг организмига киритилганида токсик таъсири кўрсатилган бўлиб, шу миқдордаги кумуш ионлари киритилганида эса ўлимга олиб келмаган.

Ўзбекистонда янги махсулотни “Policotton-patrokl” МЧЖ “SilverteX” савдо маркаси остида тақдим этади. Ассортиментда нанотехнологялар қўлланилган холда кумуш билан ишлов берилган – носкилар, ички кийимлар, ётоқ тўқимачилик махсулотлари. «SilverteX» носкилари тўлиқ махаллий хом ашёлардан ишлаб чиқарилган бўлиб синтетик махсулотларнинг миқдори минимал даражага келтирилган (8%гача). Кумуш билан махсус ишлов берилиши ёқимсиз хидни, терлашни, касаллик кўзғатувчи замбуруғларни ўсишини олдини олади.

Нима учун нанозаррачалар бактерицид тўқимачилик махсулотлари учун энг мақбул хисобланади?

Кейсни ечиш учун ахборотларнинг турларини ва қўйидаги саволларга жавобларни билиш зарур:

Хлорид кислотаси кумуш билан реакцияга киришадими?

Нима учун оддий кумуш хлорид кислотаси билан реакцияга киришмайди?

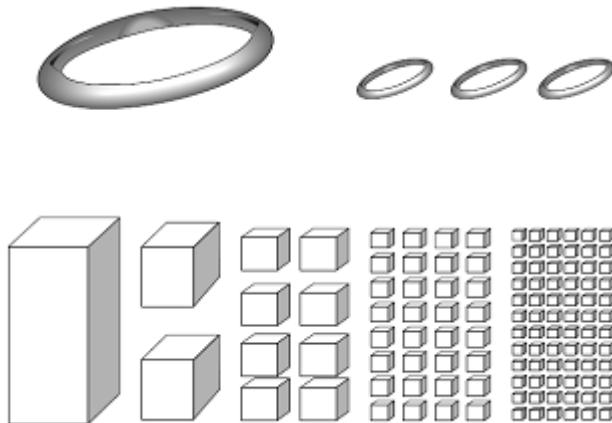
Нима учун кумуш нанозаррачалари хлорид кислотаси блан реакцияга киришади?

Кумушнинг Ag₅ нанозаррачалари ва хлорид кислотаси билан ўзаро таъсиrlашув тенгламасини тузинг?

Кумуш нанозаррачаларининг қўлланилиши қанчалик даражада хавфсиз хисобланади?

Маълумки кумуш инсон организми учун энг қучли антисептик хисобланади, у 700 дан ортиқ кассалик қўзғатувчи микроорганизмларни, замбуруғларни, бактерияларни, вирусларни ўлдиради. Аниқланганки нанозаррачалар юқори реакцион хоссаларга эга бўлиб оддий моддалар реакцияга киришмайдиган жараёнларда қатнашиши мумкин. Оддий кумуш билан хлорид кислотаси реакцияга киришмайди. Бироқ кумушнинг нанозаррачалари хлорид кислотаси билан реакцияга киришиб водороднинг ажралишига сабаб бўлади. Нанозаррачаларнинг бундай холати юза эфекти

туфайли вужудга келади. Гап шундаки майда заррачада юзада жойлашган атомларнинг микдорий кисми ортади. Бу атомларда узилган боғланишлар мавжуд бўлиб, улар нисбатан юқори энергия ва фаолликга эга бўлади.



Decreasing of ring to nanoscale leads to color change (left), depletion of metal to nanopieces leads to great surface active area

6-КЕЙС

Тошкент шахрида жойлашган “Композит” қўшма корхонасида шиша толалар турига мансуб бўлган базалт толаси ишлаб чиқарилмоқда. Ишлаб чиқарилаётган базалт толаси анча арzon ва турли кўринишда ишлаб чиқарилади: узлуксиз иплар - алоҳида толалардан иборат; ровинг - параллел иплардан ташкил топган; қисқа толалар – ипдан ёки 5-50 ммли қисқа ровницидан иборат, бундан ташқари шишатола тўқима мато ёки тўқилмаган матлар кўринишида ҳам ишлаб чиқарилади.

Шиша тола ёки базалт толаси билан армировка қилинган смолалар қурилишда ва саноатда кенг қўлланилади. Улар **шишапластик ёки GRP** деб номланади: бошқа конструкцион материаллар қопламалари сифатида, ёки юк ташимайдиган девор панеллари, структураларнинг таркибий қисмлари, дераза рамалари, цистерналар, труба ва трубопроводлар сифатида кенг қўлланилади. 1960-чи йиллардан бошлаб лодкалар корпуслари шишапластикдан ишлаб чиқарилмоқда.

Кимё саноатида ҳам шишапластиклар кенг қўлланилади – резервуарлар, трубопровод ёки технологик танклар сифатида. Бундан ташқари **шишапластиклар (GRP)** темир йўллари, автомобиль транспорти, аэрокосмик саноатида ҳам ўз ўрнини топган.

Аммо намлик шиша толасининг мустаҳкамлигини кескин пасайтиради. Бундан ташқари шиша тола вақт давомида чарчашга учрайди: узоқ вақт давомида доимий кучланиш таъсир этган ҳолатда шиша тола таркибида ёриқлар тез ўсиши намоён этиши мумкин. Шунинг учун вақт ўтиш билан шиша толанинг механик хоссалари кескин пасайиб боради, аммо қисқа вақт давомида мустаҳкамлиги яхши хисобланади.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлари:

“Композит” қўшма корхонасида ишлаб чиқариш маҳсулотлари турларини кенгайтириш мақсадида базалт (шиша) толаси асосида янги маҳсулот турларини таклиф этинг. Базалт (шиша)композитларнинг

қўлланилиш имкониятларини чеклантирувчи муаммоларни аниқланг ва уларни ечиш йўлларини белгиланг. Базальт (шиша) толали композитларнинг қўлланилиш соҳаларини таклиф этинг. Кейс ечимини жадвал шаклида келтиринг:

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Ҳал этиши йўллари	Қўлланилиш имкониятлари

7-КЕЙС

SHATTLE (АҚШ) ракета-ташувчининг эшиги ва корпуси углерод толали/эпоксид смола композитидан тайёрланган. Замонавий самолетлар, жумладан Boeing 787 (Dreamliner) фюзеляжи ва қанотлари углерод толаси / эпоксид композитлардан тайёрланиб келмоқда.

Бундай углерод толали/органик матрициали композитлар тан нархи қимматлиги билан ажралиб туради (углерод толасини синтез қилиш юқори ҳарорат ва босимларни талаб этади).

Углерод толалари – юқори мустаҳкамлик ва механик хоссаларни термик стабиллиги билан ҳарактерланади; улар инерт шароитда синтетик органик толаларни юқори ҳароратда ишлов бериш усули ёрдамида олинади (вискоза, полиакрилнитрил); дастлабки хом ашё турига қараб турли углерод толалар олиш мумкин: иплар, сим, мато, лента, войлок.

Хозирги вақтда углерод толаларнинг нархи доимий равишда пасайиб бормоқда, шунинг учун қўлланилиш соҳалари ҳам кенгайиб бормоқда. Углерод толали композитлар технологик жиҳозлар - турбина, компрессор, шамол тегирмонлари қанотлари, маховиклар тайёрлашда; медицинада эса – жиҳозлар ва имплантатлар (тизза суставлари) тайёрлашда қўлланилмоқда.

Демак, углерод толалари билан мустаҳкамлаштирилган углерод тола/органик матрициали композит материал юқори физик-кимёвий хусусиятларга эга.

Аммо углерод толалари билан мустаҳкамлаштирилган композит кучли анизотропияга эгалиги муносабати билан унинг хоссалари турли йўналишларда бир хил эмаслиги келиб чиқмоқда. Бу эса композитнинг медицина ва техникада қўлланилиш имкониятларини қисқартирмоқда. Истеъмолчи томонидан композитнинг анизотропиясини камайтириш кераклиги талаб этилди.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг (индивидуал ва кичик гурухда).
- Композитнинг анизотропиясини камайтириш учун бажариладиган ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликлардаги иш). 8-9– иловалардаги маълумотлардан фойдаланишингиз мумкин.

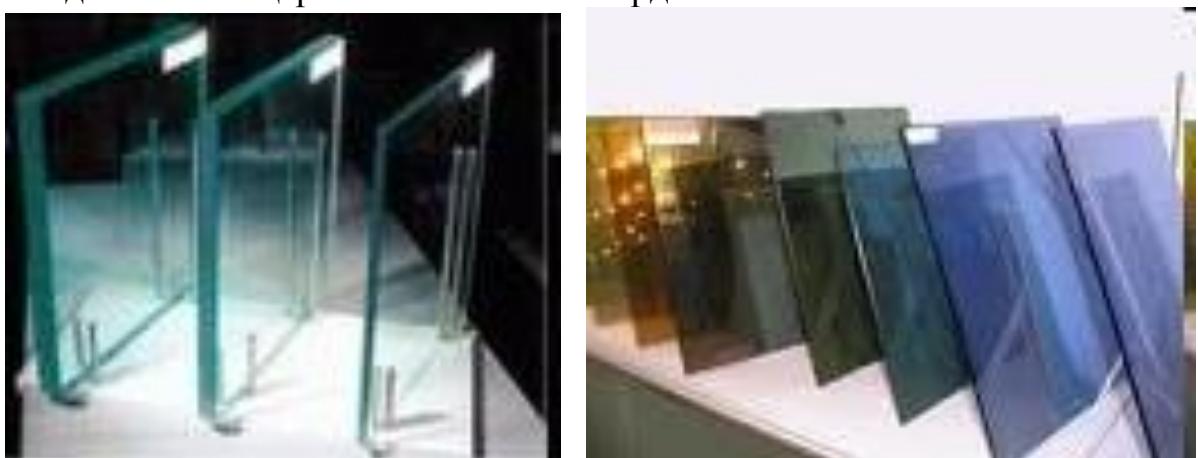
8-КЕЙС

Шиша тараққиёти жамият тараққиёти билан узвий боғлиқ. Унинг кўп хусусиятлари бор. Айниқса – шаффофлиги ҳамда пишиқлигидир. Шишадан турли хил уй рўзғор, безак буюмлари, техника асбоблари, иссиқлик ва товуш изоляцион материаллар ясалади. Шишанинг кашф этилиши турли-туман шакллардаги бутилкалар, ҳар ҳил идишлар, вазалар, стакан, қадаҳлар қисқаси, турмуш учун зарур буюмларни кўплаб ишлаб чиқарилишига олиб келди.

Табиий шиша тарихи одамзод тарихидан катта. Вулқон отилиши, зилзила рўй бериши, момақалдироқ гумбирлаши каби табиат ҳодисалари табиий шишалар-обсидиан ва яшин шишаларининг ҳосил бўлишига сабабчи бўлган.

Марказий Осиё мамлакатларида ҳам шишасозлик қадимдан бошланган. Унинг тараққий етган даври ўрта асрларга тўғри келади. Машҳур энстиклопедист олимлар Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Абу Бакр Мухаммад ибн Закриё ар-Розий асарларида келтирилган маълумотлар шишасозлик техникаси бу ерда қадимги Мисрдагига нисбатан юқорироқ савияда олиб борилганлигидан далолат беради.

Йигирманчи аср давомида Ўзбекистонда қатор шиша корхоналари курилиб, ишга туширилди. Шулар жумласига Тошкент «Оникс» ва «АСЛ ОЙНА» ишлаб чиқариш бирлашмаси каби корхоналар киради. Бу корхоналарни ишга тушириш республика эҳтиёжлари учун керакли бўлган шиша маҳсулотларини (Расм) арzon ва кенг тарқалган маҳаллий хом ашёлар асосида ишлаб чиқариш имкониятини берди.





Шиша ишлаб чиқаришда материаллар иккита катта гурухга бўлинади: шиша ҳосил қилувчилар - улар қаторига олтингугурт, селен, маргимуш, фосфор, углерод каби элементлар; SiO_2 , FeO_2 , B_2O_3 , P_2O_5 , As_2O_3 , BeF_2 каби оксид ва бирикмалар.

Якка ҳолда шишасимон ҳолатни ҳосил қилаолмайдиган элемент, оксид ва бошқа бирикмалар модификаторлар деб аталади. Уларга TiO_2 , TeO_2 , CeO_2 , MoO_3 , CoO_3 , Bi_2O_3 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO , Na_2O , K_2O кабилар киради. Бундай оксид ва бирикмалар шиша ҳосил қилувчилар иштирокида осонгина шишасимон ҳолатни вужудга келтиради. Улар иштирокида шихтанинг эриш температураси пасаяди. Лекин ҳосил бўлган аморф мoddанинг механикавий ва кимёвий хусусиятлари ҳам бироз камаяди.

Шихта таркибиغا киравчи компонентлар сонининг ошиши шишасозликда ижобий рол ўйнайди. Масалан, $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$, $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{B}_2\text{O}_3$, $\text{Me}_m\text{O}_n-\text{P}_2\text{O}_5-\text{B}_2\text{O}_5$ каби системалар асосида шиша осон ҳосил бўлади.

Силикат таркибли саноат шишаларида SiO_2 , CaO ва Na_2O билан бир қаторда MgO ва Al_2O_3 ҳам қатнашади. Магний оксиди шишаларининг кристалланишига бўлган лаёқатини бироз сусайтиради, алюминий оксиди эса уларнинг кимёвий турғунлигини таминлашга хизмат қилади. Шиша ҳосил қилувчи ва модификаторлар устида А.А. Аппен кўп тадқиқотлар олиб борган.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

Бу кейс стади усулида қўзланган мақсад – турли оксидларнинг композицион шиша материаллар яратишдаги ролини ўрганиш.

SiO_2 оксиди минерал сифатида қандай номланади ва факат у асосида якка таркибли шиша материал олиш мумкин-ми?

SiO_2 оксиди асосида якка таркибли шиша материал ишлаб чиқаришдаги муаммоларни аниқланг ва ечимини таклиф этинг. Кейс ечимини жадвал шаклида келтиринг:

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Хал этиш йўллари

9-КЕЙС

Техника шишиасининг тури жуда кўп. Унинг асосий маҳсулотлари қаторига қўйидагиларни қўрсатиш мумкин:

1. Кварц шишиаси - шаффоф ва бўғиқ бўлади. Кварц шишиасини ишлаб чиқаришда формуласи SiO_2 тўғри келадиган юқори даражадаги тоза тоғ биллури ёки Кварц қумларидан фойдаланади. Албатта, улар оғир темирли минераллар, дала шпати, слюда ва тупроқдан тозаланиши зарур. Натижада бойиган тоғ жинсининг кимёвий таркиби SiO_2 фойдасига ўзгаради ва майдаланган заррачаларнинг гранулометрик таркиби тузатилади. Ишлаб чиқаришда қўлланилаётган хом-ашё таркиби қўйидагича бўлади: SiO_2 99.6-99.7; P_2O_5 - 0.15-0.30, шу жумладан Fe_2O_3 0.002-0.003; CaO 0.05-0.08; MgO 0.03-0.05; P_2O 0.01-0.02 ва қиздирилгандаги йўқотиш 0.05-0.08%. Кварц шишиаси ўта юқори термик ва электр бардошлиги билан ажралиб туради.

2. Оптика шишиаси – оптика асбобларида қўлланадиган крон, флинт ва бошқалар. Енгил кронлар - SiO_2 – 50-80 %, B_2O_3 – 10%, K_2O – 20% (базалари 12 % Ф). Кронлар – бор-силикатли шиshalар, оғир кронлар эса бор-кремний ва барий оксидлари асосида синтез қилинади.

3. Электр вакуум ва электроника шишиаси – радиоэлектроника соҳасида замонавий асбоб-ускунакарда кенг қўлланилади. Асосан алюминий-бор-силикат системалар асосида ишлаб чиқарилади. Юқори технологик ва эксплуатасион ҳоссаларига эга – кимёвий бардошлиги, механик мустахкамлиги, термик бардошлиги, юқори диэлектрик ҳоссалари ва вакуумга чидамлиги. Электрон техникасида B_2O_3 - PbO - ZnO , B_2O_3 - Al_2O_3 - ZnO , As - Fe - Se системасидаги шиshalар (ситаллоцементлар) ҳам кенг қўлланилади.

4. Кимёвий - лаборатория шишиаси - юпқа ва ёғон шиshalар, лаборатория ва ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади: кимё, озиқ-овқат, медицина, фармасевтика, лаборатория ва саноат асбобларида ва х. Бу турдаги шиshalар турли реагентлар таъсирига кимёвий бардошлиги, юқори термик бардошлиги билан ажралиб туради.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кварц шишиасини тара маҳсулотлар (бутилка ва шиша банкалар) ишлаб чиқаришда қўлланилиши мумкин-ми? Сабабларини келтиринг.
- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабаблар ва ҳал этиш йўлларини жадвал асосида изоҳланг (индивидуал ва кичик гурухда).

Муаммо тури	Келиб чиқиши сабаблари	Ҳал этиш йўллари

10-КЕЙС

Кейс 5

Тури ёғочлардан олинган елимланган материаллар турлича физик-механик хоссаларни намоён қилади. Ўзбекистон шароитида қайси елимланган ёғоч материалини ишлаб чиқариш ҳар тарафлама фойдали?

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:



VII. ГЛОССАРИЙ

Таянч сўз	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
Аэрогел	Аэрогел: суюқлиги ютилган газ билан ўриналмашган гелдан олинган ғоваксимон қаттиқ чўкма	Aerogel: a porous solid formed from a gel in which the liquid is replaced with a gas with gas entrapment
Атом-кучланишлимикроскопия (AFM) ёки сканерловчи зонд микроскопияси (СЗМ)	Атом-кучланишлимикроскопия (AFM) ёки сканерловчи зонд микроскопияси (СЗМ): атом кўрсатгичли юзадаги атомларнинг тасвирини ёки бошқа функционал хоссаларини тасвирлаш учун қўлланиувчи юқори кўрсатгичли қурилма	Atomic force microscopy (AFM) or scanning probe microscopy (SPM): a high-resolution device used to map topography or other functional properties of the surface atoms at atomic resolution capabilities
Атом манипуляцияси	Атом манипуляцияси: атом-кучланишли микроскопия ва сканерловчи тунелли микроскоп каби илғор усуллар туфайли имконияти туғилган юзанинг тузилишини атом ортидан атом еки кимёвий модификациялаш	Atomic manipulation: atom by atom modification of surface structure or chemistry made possible by advanced techniques like atomic force microscope and scanning tunnelling microscope
Таъқиқланган чегаранинг кенглиги	Таъқиқланган чегаранинг кенглиги: барча электрон энергетик холатлар таъқиқланган қаттиқ жисмдаги валент чегара ва ўтказувчанлик чегараси орасидаги энергетик туйнук	Band gap: energy gap between the valence band and conduction band in a solid in which all electronic energy states are forbidden
Биомослашувчанлик	Биомослашувчанлик: нохуш ўзгаришларни чақирмай материалнинг биологик тизим билан таъсирлашуvida ўз	Biocompatibility: capability of a material in contact with a biological system to perform its intended

	вазифаларини бажариши	function without causing deleterious changes
Биомиметика	Биомиметика: замонавий технологияларни қўллаш билан мухандислик тизимларни тадқиқ қилиш ва лойиҳалаштириш учун табиий тизимларга ўхшаш, инженерия ёки тақлид қилиш тўғрисидаги фан	Biomimetic: the science of imitating or reverse engineering from natural systems to the study and design of engineered systems using modern technology
Бот	Бот: робот ёки автоматлаштирилган интеллектуал машина	Bot: a robot or automated intelligent machine
Тагдан-тепага	Тагдан-тепага: асосий бирликлари нанозаррачалар/нанотизи мларни хосил қилиш билан бирлашадиган атом миқёсидаги асосий бирликларидан наноматериалларнинг синтез қилиш стратегияси	Bottom-up: a strategy for synthesizing nanomaterials from atomic scale fundamental units where the fundamental units link up to form nanoparticles/nanostructures
Бакминстер - фуллерен	Бакминстер - фуллерен: Ричард Бакминстер Фуллерен томонидан лойиҳалаштирилган геодезик гумбазга ўхшаши туфайли унинг шарафига номланган C60 формуласи доирасимон молекула; Бакминстерфуллерен – фуллереннинг дастлабки топилган молекуласи хисобланади, шу билан бирга қурумда оз микдорда топилиши мумкин бўлганлиги учун табиий хосил бўлиши	Buckminster fullerene: a spherical molecule with the formula C ₆₀ , named in homage to Richard Buckminster Fuller, due to its resemblance to the geodesic dome designed by him; Buckminster fullerene is the first fullerene molecule to be discovered and is also the most common in terms of natural occurrence, as it can be found in small

	нуқтаи назаридан энг кўп тарқалган хисобланади.	quantities in soot
Заряд боғланишли қурилма (CCD)	Заряд боғланишли қурилма (CCD): зарядланган позицион-сезгири ахборотни йиға оладиган ва рақамли тасвирларни ишлатиш учун кенг кўлланиладиган монипуляциялар учун рақамли маълумотларга ўтказа оладиган қурилма	Charge-coupled device (CCD): a device that can gather position-sensitive charge information and convert to digital data for manipulation, which is used extensively for digital imaging applications
Комплементарметалоксидли ярим ўтказгич (CMOS)	Комплементар металоксидли ярим ўтказгич (CMOS): интеграл схемалар (ICs) ва ўта катта интеграл схемаларни (VLSI) ясаш учун янги технология, асосий афзаликлари кам энергия сарф қилиши ва юқори шовқин даражасида бўлиб бу ўз навбатида юза бирлиги доирасида қурилмаларнинг юқори зичлигини таъминлайди	Complementary metal–oxide semiconductor (CMOS): an emerging technology for the fabrication of ICs and VLSI, the main advantage being low power consumption and high noise, enabling larger density of devices within unit area
Углеродли нанотрубка (CNT)	Углеродли нанотрубка (CNT): тасвир форматининг юқори ўзгартирилиб туришли цилиндросимон наноструктурали углероднинг аллотропик шакли; уларнинг ўзгача бўлган электрон ва магнит хоссалари кенг кўлланилади.	Carbon nanotube (CNT): an allotrope of carbon with cylindrical nanostructure and having high aspect ratios; their unusual electronic and magnetic properties find wide applications
Коллоид	Коллоид: ўзлуксиз муҳитдаги дисперсияланган модданинг бир турдаги суспензияси; қаттиқ,	Colloid: a homogenous suspension of a dispersoid in a continuous medium; it

	суюқ ёки газсимон бўлиши мумкин.	may be a solid, liquid or gas
Буғ фазасидан кимёвий чўктириш (CVD)	Буғ фазасидан кимёвий чўктириш (CVD): газсимон реагентларнинг қўлланилиши билан юпқа пленкаларнинг таглиқда чўктириш услуби	Chemical vapour deposition (CVD): a technique for depositing thin films on a substrate using gaseous reactants
Холилаштирилганхудуд	Холилаштирилганхудуд: зарядларни эркин ташувчиларидан холи бўлган яrimўтказгич материалларнинг бирлашиш жойи	Depletion zone: a region at the junction of semiconducting materials that is devoid of free charge carriers
Дислокация	Дислокация: кристаллографический линейный дефект, включающий нерегулярность периодического расположения атомов (отсутствие ряда атомов в плоскости) в кристалле	Dislocation: a crystallographic line defect involving irregularity in the periodic arrangement of atoms (missing row of atoms in a plane) in a crystal
ДНК-чип	ДНК-чип: гендаги мутацияларни ёки ўзгаришларни идентификациялаш учун қўлланиладиган яrimўтказгичли микрочип асосидаги датчик	DNA chip: a sensor based on a semiconductor microchip used to identify mutations or alterations in a gene
Тенг каналли бурчакли пресслаш(ЕСАР)	Тенг каналли бурчакли пресслаш(ЕСАР): шакл ва ўлчамларини ўзгартиришсиз катта микдордаги деформацион силжишни киритувчи ултрайсперс тузилишли заррачаларни ишлаб чиқариш учун пластик деформациянинг оғир техникаси; экструзия иштирокидаги ўхшаш жараённи намоён қилувчи тенг каналли	Equal channel angular pressing (ЕСАР): a severe plastic deformation technique for producing ultrafine grain structures, which introduces a large amount of shear strain into the materials without changing its shape or dimensions; equichannel angular extrusion (ECAE) is a

	бүрчак экструзияси (ECAE)	similar process involving extrusion
Электрон микроскоп	Электрон микроскоп: тезлаштирилган электронларнинг коллимирланган дастасини намунага фокуслаб атом ўлчамидаги катталаштирилган тасвирни олиш учун кўлланиладиган микроскоп	Electron microscope: a microscope that focusses a collimated accelerated electron beam on the specimen to produce a magnified image at atomic resolution
Электрон бурун	Электрон бурун: хид еки таъмларни аниқлаш учун бир неча кимёвий сенсорлардан ташкил топган қурилма	Electronic nose: a device consisting of an array of chemical sensors to detect odours or flavours
Электрон тил	Электрон тил: таъмларни аниқлаш ва таққослаш учун бир неча кимёвий датчиклардан ташкил топган қурилма	Electronic tongue: a device consisting of an array of chemical sensors to detect and compare tastes
Эпитаксия	Эпитаксия: асосий таглик билан кристаллографик тартибни (когерентликни) таъминлаш учун иккиламчи фазанинг ўсиши	Epitaxy: growth of a secondary phase maintaining a perfect crystallographic registry (coherency) with the underlying substrate
Fab	Fab: интеграл схемалар ва ва яримўтказгичли асбобларни ишлаб чиқариш учун назорат қилинувчи чўктириш жараёнлари ва тоза хоналардан ташкил топган микротехнологик объект	Fab: a microfabrication facility consisting of clean rooms and controlled deposition process for the fabrication of semiconductor devices and ICs
Майдон эфектлитранзистор (FET)	Майдон эфектлитранзистор (FET): электр майдони ёрдамида ўтказувчанлигини	Field effect transistor (FET): a transistor whose conductivity can be controlled by

	бошқариш мүмкін бўлган транзистор	electrical field
Ёқилғи элементи	Ёқилғи элементи: ташқи манба ёқилғиси ёки реагенти асосида электр энергиясини ишлаб чиқариш имкониятига эга электрокимёвий ячейка	Fuel cell: an electrochemical cell capable of producing electrical energy with fuel or reactant being used up from an external source
Гигантмагнит қаршилиги (GMR)	Гигантмагнит қаршилиги (GMR): юпқа пленкали структуralарда кузатиладиган квант-механик эффект: ферромагнит қаватнинг магнит майдони таъсирига учраганда электр қаршилиги сезиларли даражада камаяди	Giant magnetoresistance (GMR): quantum mechanical effect observed in thin film structures: the electrical resistance decreases significantly when the ferromagnetic layer is exposed to a magnetic field
Заррачаларниң чегараси	Заррачаларниң чегараси: 2D-дефект, аниқ аникланган иккита чегараланувчи кристалларниң интерфейси	Grain boundary: a 2D defect, the interface bordering two well-defined crystals
Заррачалар чегарасининг миграцияси	Заррачалар чегарасининг миграцияси: термик ёки механик кучланиш йўли ёрдамида фаоллаштирилган заррачалар чегараларининг келишилган харакати	Grain boundary migration: coordinated movement of grain boundaries activated either thermally or by mechanical stress
Холл-Петч қонуни	Холл-Петч қонуни: асосан чегарадаги заррачанинг мустахкамлашуви хисобига хосил бўлувчи кристалсимон модданинг қаттиқлигига заррачаларниң ўлчамини тескари	Hall-Petch relation: the effect describing the inverse effect of grain size on the hardness of a crystalline solid that arises mainly due to grain boundary strengthening

	таъсирини тавсифловчи эффекти	
Иссик изостатик преслаш (HIPing)	Иссик изостатик преслаш (HIPing): майин заррачаларни яхлит қисмларга сиқиш учун юқори гидростатик босим ва хароратни кўллаш жараёни	Hot isostatic pressing (HIPing): the process of using high hydrostatic pressure and temperature to compress fine particles into coherent parts
Кридер қонуни	Кридер қонуни: қаттиқ дискларнинг хотира хажми деярли хар йили икки баробар кўпаяди	Kryder's law: the memory storage capacity of hard drives doubles almost every year
Светодиод (LED)	Светодиод (LED): электролюминесценция принципига асосан ишловчи яримўтказгичли нур манбай, нурланувчи ёруғликнинг тўлқин узунлиги яримўтказгичларнинг таъкиқланган худуди кенглигига боғлиқ	Light-emitting diode (LED): a semiconductor light source working on the principle of electroluminescence, where the wavelength of light emitted depends on the band gap of semiconductors
Суюқкристал (СК)	Суюқ кристал (СК): суюқлик ва қаттиқ кристалсимон модда хоссалари оралиғидаги материя; суюқ кристалли дисплейларда кенг кўлланилади	Liquid crystal (LC): a state of matter with properties between a liquid and solid crystal; it is used extensively in liquid crystal displays
Магиксон	Магиксон: анчагина юқори бўлган структуравий ва потенциал турғунликни таъминловчи кластердаги атомларнинг критик сони	Magic number: a critical number of atoms in a cluster size providing it higher structural and potential stability
Механикқотишималаш	Механик қотишималаш: юқори энергияли шарли тегирмонда заррачаларнинг қайта деформацияланиши ва ёриқлари натижасида майдаланиши,	Mechanical alloying: a solid state process in which grain refinement occurs by repeated deformation, fracturing and cold welding of powder particles in a high-energy ball mill

	кукунларнинг заррачалари совук пайванланадиган қаттиқ жисмдаги жараён	
Суюқланиш хароратининг осцилляцияси	Суюқланиш хароратининг осцилляцияси: заррачала ринг ўлчами ассоcий массадан субнанометргача камайиб миқдорининг ошиши натижасидаги суюқланиш хароратини бостириш ходисаси	Melting point oscillation: the phenomenon of suppression of melting point followed by elevation as the particle size is reduced from bulk to sub-nanometre size
Микроэлектромеханик системалар(MEMS)	Микроэлектромеханик системалар (MEMS): электр энергияси билан бошқариладиган микрорамермеханик тизим; механик курилмаларнинг ўлчамлари нанометрик диапазонга яқинлашганда уларни наноэлектромеханиктизи млар деб аташади (NEMS)	Microelectromechanical systems (MEMS): a microdimensional mechanical system driven by electrical energy; when the dimensions of the mechanical devices approach nanometric range they are termed nanoelectromechanical systems (NEMS)
Мезоговакли	Мезоговакли: бир меъёрда бер текис жойлашган мезоговакли (диаметри 2-50 нм) ғоваксимон материаллар; юза сиртининг катталиги уларни адсорбент еки катализаторлар сифатида фойдали қиласи	Mesoporous: porous materials with regularly arranged, uniform mesopores (2–50 nm in diameter); their large surface areas make them useful as adsorbents or catalysts
Микрокантилевер	Микрокантилевер: микрометр миқёсидаги ўлчамли кантилеверли нур, MEMS соҳасида, датчикларда, резонаторларда ва хз кенг қўлланилади	Microcantilever: a cantilever beam with dimensions in the micrometer scale that is extensively used in the field of MEMS, sensors, resonators, etc.

Молекуляр электроника	Молекуляр электроника: электрон қурилмаларда қўлланилиши учун молекулаларнинг тадқики ва қўлланилиши	Molecular electronics: the study and application of molecules for electronic device applications
Мур қонуни	Мур қонуни: қурилманинг юза бирлигига ўрнаштирилган транзисторларнинг сони тахминан хар 18 ойда икки баробар кўпайишини назарда тутувчи хисоблаш қурилмаларидағи ўзоқмуддатли тренд	Moore's law: a long-term trend in computing hardware suggesting that the number of transistors built in a unit area of the device approximately doubles every 18 months
Мултиплет иккиламчи заррачалар (MTP)	Мултиплет иккиламчи заррачалар (MTP): олмос (C, Si, Ge) ва қотишмалар типидаги яrimўтказгичлардан, кубсимон ёқларимарказлаштирилган металлардан олинган юпқа пленкалар (кристалл тагликларда чўқтирилган) ва нанокристалл заррачалардаги бешинчи тартибли псевдосимметриянинг кузатилиши	Multiply twinned particles (MTP): observed frequently with a pseudo five-fold symmetry in nanocrystalline particles and thin films (deposited on crystalline substrates) of cubic face-centred metals, diamond-type semiconductors (C, Si, Ge) and alloys
Мултиқаватлар	Мултиқаватлар: бир-бирига жойлаштирилган турли хил кимёвий таркибли ёки структурали юпқа пленкалар	Multilayers: thin films of differing chemistry or structure deposited one over the other
Нано	Нано: карликни ёки бирон-бир кичик нарсани билдирувчи грекча олд қўшимчаси, бир миллиарддан бир қисмини билдиради (10^{-9})	Nano: Greek prefix meaning dwarf or something very small; depicts one billionth (10^{-9}) of a unit

Нанобот	Нанобот: нанометрли ўлчамлардан ташкил топган компонентли робот (яrim ёки тўлик автоматлаширилган интеграл машина); улар нанороботлар, наноидлар, нанитлар, наномашиналар ёки наномитлар номлари билан хам учрайди	Nanobots: a robot (semi- or fully- automated intelligent machine) consisting of components of a few hundred nanometre-dimensions; they are also referred to as nanorobots, nanoids, nanites, nanomachines or nanomites
Нанотолалар	Нанотолалар: 100 нм дан кичик бўлган диаметрли толалар	Nanofibre: fibres with diameter less than 100 nm
Нанодисперсия	Нанодисперсия: металлар, керамиқ, углеродли нанотрубкалар ва хиз нанозаррачаларнинг коллоид суспензияси	Nanofluid: colloidal suspension of nanoparticles of metals, ceramic, carbon nanotubes, etc.
Наноиндентификациялаш	Наноиндентификациялаш: наноўлчамли хажмларга қўлланилувчи босищдаги қаттиқлик тести, кичик босимларда алоҳида нанозаррачаларнинг қаттиқлигини аниқлаш учун	Nanoindentation: an indentation hardness test applied to nanoscale volumes at small loads to obtain the hardness of individual nanoparticles
Нанолитография	Нанолитография: наноўлчамли деталларни шакллаш учун нано ишлаб чиқариш техникаси; интеграл схемалар ва NEMSлар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади	Nanolithography: a nanofabrication technique for patterning nanoscale features; used extensively in the fabrication of ICs and NEMS
Наноматериал	Наноматериал: бирон бир ўзгариши нано даражада (<100 нм) бўлган материалларнинг синфи	Nanomaterial: class of materials in which at least one of the dimensions is on the nanoscale (<100 nm)
Наностержнлар	Наностержнлар: ёқларин инг нисбати 3-5 диапазонида бўлган 3Dнаноструктуралар;	Nanorods: 3D nanostructures with aspect ratio typically in the range of 3–5; all

	уларнинг барча ўлчамлари 1-100 нм диапазонида бўлади	their dimensions are in the range 1–100 nm
Нанокобиклар	Нанокобиклар: диаметри бир неча ўнликдаги нанометрда бўлган объект ядроси устидаги юпқа қобик	Nanoshells: a thin coating over a core object a few tens of nanometres in diameter
Нанотехнологиялар	Нанотехнологиялар: атом ва молекула даражасида моддаларнинг устидаги манипуляциялар; одатда 1 дан 100 нанометргача бўлган ўлчамдаги структуралар билан ишланади, хамда бир кўрсатгичи шу ўлчамларда бўлган материалларни ёки курилмаларни ишлаб чиқиши ўз ичига олади	Nanotechnology: study of manipulating matter on an atomic and molecular scale; generally deals with structures sized between 1 and 100 nanometres in at least one dimension, and involves developing materials or devices possessing at least one dimension within that size
Наносимлар	Наносимлар: нанометр ўлчамли кенглиқдаги ва геометрик ўлчамларининг нисбати 1000 ва ундан юқори бўлган 1Dнаноструктуралар	Nanowires: 1D nanostructures with width of nanometric dimensions and exhibiting aspect ratios of 1000 or more
Наноэлектромеханические системы (NEMS)	Наноэлектромеханические системы (NEMS): см MEMS	Nanoelectromechanical systems (NEMS): refer MEMS
Оптоэлектроника	Оптоэлектроника: электрон қурилмалардани электромагнит фотонларнинг кўлланилиши; “электр сигналини оптик сигналга” ёки “оптик сигнални электр сигналга” ўтказувчи ўзгартгичлар бўлиши мумкин	Opto-electronics: an application of electromagnetic photons for electronic device applications; they can be either electrical-to-optical or optical-to-electrical transducers
Фотокатализ	Фотокатализ: катализатор иштироқида фотонлар	Photocatalysis: phenomenon of

	оқимини қўллаш билан кимёвий реакция тезлигини тезлаштириш феномени	accelerating a chemical reaction rate using a photon beam in the presence of a catalyst
Фотолюминесценция (PL)	Фотолюминесценция (PL): баъзи бир моддаларнинг маълум бир тўлқин узунликдаги электромагнит нурларни ютиб ва қайтадан фотонларни турли хил тўлқин узунликда нурлатувчи жараён	Photoluminescence (PL): a process by which certain substances absorb electromagnetic radiations of specific wavelengths and re-radiate photons of different wavelength
Фотонкристаллар	Фотонкристаллар: электромагнит тўлқинларни тарқатилишига таъсир этишга мўлжалланган даврий диэлектрик ёки металл диэлектрик оптик наноструктуралар	Photonic crystals: periodic dielectric or metallo-dielectric optical nanostructures that are designed to affect the propagation of electromagnetic waves (EM) in the same way as the periodic potential in a semiconductor crystal affects electron motion by defining allowed and forbidden electronic energy bands
Фотоника	Фотоника: маълумотларни бошқаришда электронлар ўрнига еруғликни (фотонларни) қўлловчи электроника	Photonics: electronics using light (photons) instead of electrons to manage data
Пьезорезистив эффект	Пьезорезистив эффект: ташқаридан механик босим таъсирига боғлиқ равишда материалнинг электр қаршилигининг ўзгариш ходисаси	Piezoresistive effect: phenomenon by which electrical resistance of a material varies with externally applied mechanical pressure
Плазма	Плазма: ионлашган модданинг анчагина катта фракциясини ўзида	Plasma: a state of matter containing a significantly large

	сақловчи модданинг холати; плазманинг хоссалари қаттиқ моддалардан, суюқликлардан ёки газлардан тубдан фарқ қилади	fraction of ionized matter; plasma properties differ significantly from those of solids, liquids or gases
Буғ фазасидан физикавий чўқтириш (PVD)	Буғ фазасидан физикавий чўқтириш (PVD): таглиқда юпқа пленкаларни олиш учун атомларни мўлжал материалидан бўғлатишиш иштирокида вакуум чўқтиришнинг турли технологиялари	Physical vapour deposition (PVD): a variety of vacuum deposition technique involving vaporization of atoms from target material to produce a thin film on a substrate
Пиролиз	Пиролиз: алана(<i>pyr</i>) остида ажратишни (<i>lysis</i>) англатувчи грекча сўз; кислород иштирокисиз юқори хароратларда органик моддани парчалашни ўз ичига олувчи термокимёвий усул	Pyrolysis: Greek word denoting separation (<i>lysis</i>) under fire (<i>pyr</i>); a thermochemical method involving decomposition of organic material at elevated temperatures in the absence of oxygen
Кванткомпьютерлар	Кванткомпьютерлар: кир иш маълумотларидағи операцияларда квант-механик ходисаларини қўлловчи хисоблаш асбоблари	Quantum computers: a computational device using quantum mechanical phenomena for operations on input data
Квантнуктлари	Квантнуктлари: электр онларнинг энергия холатлари барча учта кенглик ўлчамларида аниқланадиган 0Днаноструктуралар; уларнинг электрон хоссалари кластерлар ва яримўтказгичлар орасида бўлади	Quantum dots: 0D nanostructures in which electron energy states are confined in all three spatial dimensions; their electronic properties are between that of clusters and bulk semiconductors
Кубит	Кубит: хисоблашлардаги битнинг квант	Qubit: a quantum-computing equivalent

	эквиваленти; атомларнинг квант хоссаларини ўлчаш қўшимчаси билан	to a bit; with an additional dimension of quantum properties of atoms
Резонансли туннелланган қурилма (RTD)	Резонансли туннелланган қурилма (RTD): электронларни фақатгина икки йўналишда ушлаб колувчи узун ва қисқа яримўтказгичли оролчалардан ташкил топган 2Dквант ускуналари	Resonant tunnelling devices (RTD): 2D quantum devices that consist of a long and narrow semiconductor island, with electron confinement only in two directions
Резонанс-туннелли транзисторлар (RTT)	Резонанс-туннелли транзисторлар (RTT): RTD га қара	Resonant tunnelling transistors (RTT): see RTD
Сканирловчи яқинхудудли оптикомикроскопия(SN OM)	Сканирловчи яқинхудудли оптикомикроскопия(SN OM): намунани ишлатилаётган нурнинг тўлқин узунлигидан кичик бўлган ўлчамдаги тирқиши орқали ёритади, намунани яқинхудудли манба режими доирасида жойлаштирилади; оддий объектив ёрдамида намунадаги диафрагманинг сканерлаш йўли билан тасвир шаклланиши мумкин бўлади	Scanning near-field optical microscopy (SNOM): illuminates a specimen through an aperture of a size smaller than the wavelength of light used and with the specimen positioned within the near-field regime of the source; by scanning the aperture across the sample through a conventional objective, an image can be formed
Ўз-ўзини йиғиши	Ўз-ўзини йиғиши: бирор бир ташқи куч таъсирисиз бир теккис ёки ташкиллаштирилган тузилиш ҳосил қилиш учун компонентларнинг ўз ичидаги ўзаро таъсирлашув жараёни	Self-assembly: process in which the components interact within themselves to form aligned or organized structures without any external force
Шакл хотирали полимерлар	Шакл хотирали полимерлар: хароратнинг	Shape memory polymers: smart

	г ўзгариши каби ташқи кучлар таъсирида вужудга келган ташқи кучлар таъсирида деформациядан сўнг ўзининг дастлабки шаклига қайтиш қобилиятига эга ақлли полимерлар	polymers capable of returning to their original shape after being deformed by external forces, when triggered by an external stimulus such as temperature change
Бирэлектронли транзистор (SET)	Бирэлектронли транзистор (SET): чиқувчи заряднинг жуда кичик ўзгаришларини аниqlаш қобилиятига эга мосламалар; биргина электрон учун хам зарядлар фарқи “ёқиў-ўчириш” функциясини чақириши мумкин	Single electron transistor (SET): devices that are capable of detecting very small variations in the charge of the gate; charge differences of even one electron can cause the on-and-off switching function of SET
Золь-гельусул	Золь-гельусул: кейинчалик қовушқоқ гел ва қаттиқ материалга ўтувчи коллоид суспензияни (“зол”) генерациялашни ўз ичига олучи жараён	Sol-gel method: a process that involves the generation of a colloidal suspension ('sol'), which is subsequently converted to viscous gel and solid material
Спинtronика (спин асосидаги электроника)	Спинtronика (спин асосидаги электроника): электронларнинг иккиланган хоссаларини, жумладан заряд ва спин холатини қўлловчи янги технология; манито-электроника сифатида хам маълум	Spintronics (spin-based electronics): an emerging technology, which exploits the dual property of electrons, namely charge and spin state; also known as magneto-electronics
Учқунли плазмали пишириш (SPS)	Учқунли плазмали пишириш (SPS): графит матрицаси шунингдек ўтказувчан намуналар холатида пиширилаётган кукундан бевиста ўтаётган доимий импулс	Spark plasma sintering (SPS): a sintering technique using pulsed DC current that directly passes through the graphite die, as well as

	токи қўлланилишидаги пишириш техникаси	the powder to be consolidated, in case of conductive samples
Ўтаўказувчан квантинтерферометр (SQUID)	Ўтаўказувчан квантинтерферометр (SQUID): ўта кучсиз магнит майдонларини ўлчаш имкониятига эга мослама	Superconducting quantum interference device (SQUID): a device capable of measuring extremely weak magnetic fields
Жойлашиш дефектлари	Жойлашиш дефектлари: атомларнинг нотўғри кетма-кет планар жойлашуви натижасида хосил бўлувчи кристаллографик дефектлар	Stacking faults: crystallographic defects arising due to wrong stacking sequence of planar arrangement of atoms
Сканирловчи туннелли микроскоп (STM)	Сканирловчи туннелли микроскоп (STM): атом даражасида юзаларнинг тасвиirlарини қайта ишлишда цўлланиладиган қурилма; квант тунеллаш қоидаси асосида ишлайди	Scanning tunnelling microscope (STM): an instrument used for imaging surfaces at the atomic level; it works on the principle of quantum tunnelling
Ўта эгилувчанлик	Ўта эгилувчанлик: чўзилувч анликка бўлган тадқиқотларда кутилаётган нормаларнинг чегараларидан анча катта бўлган материалнинг деформацияланиш қобилияти	Superplasticity: ability to deform a material well beyond the limits expected from normal tensile tests
Юзаплазмон (SP)	Юзаплазмон (SP): ёруғлик билан кучли таъсирлашиш натижасида поляритонга олиб келувчи юзага мос келувчи плазмонлар	Surface plasmon (SP): plasmons that are confined to surfaces and interact strongly with light resulting in a polariton
Дориларни мақсадли	Дориларни мақсадли	Targeted drug

етказиши	етказиши: терапияда локаллашган заарланган хужайраларга/түқималарға керак бўлган миқдорда фармацевтик бирикмани киритиш	delivery: administration of a pharmaceutical compound in desired amount to a localized diseased cell/tissue for therapy
Юпқа пленкали транзисторлар (TFT)	Юпқапленкали транзисторлар (TFT): яримўтказгичли ва диэлектрик материалли юпқа пленка қаватли транзисторлар; радиографиянинг LCD ва рақамли иловаларида кўлланилади	Thin film transistors (TFT): an FET made of thin film layers of semiconducting and dielectric materials; used in LCD and digital radiography applications
Юпқа пленкалар	Юпқа пленкалар: атомар конструкцияланган қаватлар нанометрдан максимум бир неча микронгacha бўлган диапазонда бўлган қалинликдаги пленкалар	Thin films: atomically engineered layers with film thickness usually in the range of nanometers to a maximum of a few microns
Тўқимили инженерия	Тўқимили инженерия: сут эмизувчиларнинг асосий тўқималарининг тузилиши ва функционал асослари хамда функцияларини тиклаш, кўллаб туриш ёки яхшилаш учун биомослашувчан ўрнини босувчиларнинг кўлланилиши тўғрисидаги фан	Tissue engineering: science of structural and functional fundamentals of mammalian tissues and application of biocompatible substitutes to restore, maintain or improve functions
Тепадан пастга	Тепадан пастга: нанокристалл материални олиш билан микрокристалл модданинг майдалашни ўз ичига олади; наноструктураларни синтез қилишнинг қаттиқ	Top-down: involves fragmentation of a microcrystalline material to yield a nanocrystalline material; all solid state synthesis routes of nanostructures fall into

	моддали йўллари шу категорияга киради	this category
Учкаррали тугун	Учкаррали тугун: учта кристалларнинг еки зарраларнинг тўқнашувидаги тугун	Triple junction: a node at the intersection of three crystals or grains
Буғ-суюқлик-қаттиқ модда усули (VLS)	Буғ-суюқлик-қаттиқ модда усули (VLS): буғ фазасидан кимёвий чўқтиришдаги наносимлар каби бирўлчамли наноструктураларнинг ўсиши учун механизм; кристалларнинг ўсиши ва кинетикаси самарадорлигини ошиши учун кўлланилади, каталитик суюқотишмали фаза буғларни ўтатўйинганлик даражасигача тезда адсорбциялаши мумкин	Vapour–liquid–solid method (VLS): a mechanism for the growth of one-dimensional nanostructures, such as nanowires, from chemical vapour deposition; to enhance the efficiency and kinetics for the growth of crystals, a catalytic liquid alloy phase which can rapidly adsorb a vapour to supersaturation levels is used
Вискерлар	Вискерлар: эркиндислокацияланадиган кристаллнинг нозик толали ўсиши	Whiskers: thin fibrous growth of a dislocation free crystal
Рентгенфотоэлектронспектроскопия (XPS)	Рентгенфотоэлектронспектроскопия (XPS): кимёвий модданинг юзасини микдорий анализ қилиш услуби, элемент таркибини аниқлайди; Усул, рентген нурлари билан қаттиқ модданинг нурлаш ёрдамида олинган фотоэлектронларнинг тавсифини ўз ичига олади	X-ray photoelectron spectroscopy (XPS): a quantitative surface chemical analysis technique that measures the elemental composition; the technique involves characterization of photoelectrons produced by irradiating a solid material with x-rays

Композицион материал	Ишлаб чиқарилган, икки ёки кўпроқ физикавий ва/ёки кимёвий ҳар хил	It is manufactured, it consists of two or more physically
-----------------------------	--	---

	бўлган, матрица (интерфейс) ичида тартибли жойлашган фазалардан ташкил топган материал.	and/or chemically distinct, suitably arranged or distributed phases with an interface separating them.
Матрица, интерфейс	Композицион материалнинг бутунлигини таъминловчи боғловчи компонент	The binding material ensuring the integrity of the structure
Матрица материаллари	Металл, керамика, полимер	Metal, ceramics, polymer
Боғловчи материалнинг вазифаси	Махсулотга маълум геометрик шакл бераб, кучланишларни ҳажм бўйича бир хил тақсимланишини таъминлайди ва маълум механик хоссани шакллантиради, ҳамда арматура ёки қўшимчаларни ташки мухитдан сақлайди.	Gives the material the necessary geometric shape, distributes the load evenly throughout the volume, keeps the armature or fillers from the effects of the environment
Композитнинг мустаҳкамлигини оширадиган компонент	Мустаҳкамлаштирувчи компонент, армировка материали, арматура	reinforcement material, reinforcement
Нол-ўлчамли қўшимчалар	Улчами уч йўналишда кичик бўлган қўшимчалар - кум, майда (кукун) доначаларга эга бўлган металлар, фосфатлар, шиша ва лойсимон микросфера шаклдаги материаллар.	The dimensions of the reinforcing additive is very small in all 3 directions – the particles of sand, metal powders, phosphates, glasses, materials with forms of clay microspheres
Бир ўлчамли қўшимчалар	Толасимон тўлдирувчилар, арматура	Fiber shaped elements, fittings,

	элементлари, калта толали табиий материаллар -асбест, ўсимлик материаллари, толасимон кристаллар (алюминий нитрид, бериллий оксида, бор карбиди, кремний нитриди), узун толали ҳар хил органик бирикмалар.	short natural fiber materials-asbestos, plant materials, fiber-shaped crystals (aluminum nitride, berilliy oxide, boron carbide, and silicon nitride), different length fiber of organic compounds.
<i>Икки ўлчамли тўлдирувчилар</i>	Ленталар, матолар, матлар, тўрсимон элементлар.	Tapes, mats, fabrics, nets elements.
<i>Изотроп композицион материал</i>	Материалларнинг хоссалари ҳамма йўналишда бир хил булиши керак.	Material properties in all directions are the same.
<i>Изотроп композитлардаги мустаклаштирувчи компонент</i>	Дисперс ҳолдаги мустаҳкамлаштирувчи компонетлар: микро- ва нанозаррачалар.	Dispersed reinforcing components: micro-and nanopowders.
<i>Анизотроп композицион материал</i>	Материалларнинг турли йўналишлардаги хоссалари фарқ қиласи.	Material properties in all directions different
<i>Анизотроп композитлардаги мустаклаштирувчи компонент</i>	Арматура сифатида толалар, пластинкалар, матолар, тўрлар маълум йўналишда жойлаштирилган бўлади.	As reinforcement in a particular order fibers, plates, fabrics, nets are arranged
<i>Полиармировка қилинган композитлар.</i>	Икки ва ундан кўп турдаги мутахкамлаштириш тўлдиргичлари қўлланилган композицион материаллар.	Composite materials, reinforced by two or more types of reinforcers

Дисперс-мустаҳкамлаштирилган композицион материаллар	Матрица оғирлик ва мустаҳкамликни таъминловчи асосий элемент, дисперс заррачаларнинг улчамлари 0,01...0,1 мкм	The matrix provides strength and weight, the particle size of 0,01...0,1 μm
Дисперс-мустаҳкамлаштирилган композицион материаллар	Изотроп хусусиятларга эга материал	Isotropic material
Дисперс-мустаҳкамлаштирилган композицион материалларни ишлаб чиқариш усуллари	Куқун metallurgical усуллари ёки суюқ металл таркибига қўйиш олдидан тўлдиргичлар қўшиш усуллари ёрдамида ишлаб чиқарилади.	Powder metallurgical methods, the method of adding additives to liquid metal before casting
Куйдирилган алюминий кукуни (САП)	Алюминий матрикаси ва 18%гача алюминий оксиди заррачаларидан иборат бўлади	Consists of a matrix of aluminum with additions of up to 18% of particles of aluminum oxide
Никель асосида тайёрланган композитлар	Матрица сифатида никель ва унинг хром билан қотишмалари қўлланилади (хромнинг микдори - 20%гача), мустаҳкамлаштириш компонентлари - торий ва гафний оксидлари.	As the matrix involved Nickel and its chromium alloy (chromium content up to 20%), reinforcing components – thorium and hafnium oxides
Бор толалари	Юқори мустаҳкамлик, қаттиқлик, юқори ҳароратда бузилишга чидамли; 70...200 мкм диаметрига эга; улар металлик ва полимер матрикалани армировка қилиш учун қўлланилади	Have high strength, hardness, are not destroyed at high temperature, diameter 70...2000 μm , are used for reinforcement of metal and polymer matrix

Углерод толалари	Юқори мустаҳкамликга эга, механик хоссалари термик барқарор; алюминий ва магнийни армировка қилиш учун қўлланилади;	Have high strength, mechanical properties resistant to the temperatures; used for the reinforcement of aluminum and magnesium
Керамик толалар	Оксид, нитрид, карбидлар асосида тайёрланади, юқори қаттиқлик, мустаҳкамлик ва термик барқарорликга эга; алюминий ва магнийни армировка қилиш учун қўлланилади	Are made of oxides, nitrides, carbides; have high hardness, strength and heat resistance; used for the reinforcement of aluminum and magnesium
Шишатола	Мустаҳкамлик, термик бардошлиқ, диэлектрик хоссаларга ва паст иссиқлиқ ўтказувчанликга эга; иссиқлиқ изоляция материаллар, конструкцион материаллар ишлаб чиқаришда қўлланилади.	Have strength, heat resistance, dielectric properties and low thermal conductivity, used in the manufacture of insulating and structural materials
“E –glass” (E-шиша)	Электрик толалар белгиланади, Е-шиша яхши электр изолятор, яхши механик ва эластиклик модулига эга	Electric fiber, E-glass is a good insulator, has good mechanical elastic properties
“C –glass” (C-шиша)	Коррозия турдаги толалар белгиланади, С-шиша юқори кимёвий коррозияга бардошлиги билан тавсифланади;	Corrosion fiber, C-glass has high chemical resistance
“S –glass” (S-шиша)	Энг юқори термик ва оловбардошлиқга эга шишалар	Have the highest temperature resistance and

		refractoriness
Кевлар-29 арамид толаси	Канатлар, кабеллар, қопламали матолар, архитектура матолари ва баллистик ҳимоя матолари - бронежилетлар ишлаб чиқаришда қўлланилади	Used in the manufacture of ropes, cables, protection fabrics, architectural fabrics and fabrics for ballistic protection of body - armor
Гетинакс	Қатламли композит, таркибида қоғоз ва смола мавжуд (фенолоформальдегид ёки б.).	Layered composite, composed of paper and resin (phenol formaldehyde, etc.)
Ёғоч-қатламли пластиклар (ДСП)	Фенолоформальдегид ва крезолоформальдегид смола матрицаси/ёғоч шпонидан иборатdir.	Consists of phenolformaldehyde and cresol formaldehyde resin/veneer
Матрица	Материалнинг бутун жахми бўйича узлуксиз жойлашган компонент аталади.	Component located continuously throughout the volume of the material
Армировка компонентлари	Конструкцион композитларда асосан керакли механик хусусиятларни (мустаҳкамлик, қаттиқлик ва б.) таъминлайди	Provide in composite materials the necessary mechanical properties (strength, hardness, etc.)
Термореактив полимерлар	Полимер занжири ҳосил бўлаётганда қотиш реакцияси ҳам содир бўлади. Бу реакциялар маҳсус кимёвий моддалар таъсирида, ёки иссиқлик ва босим таъсирида, ёки	During the formation of the polymer chain occurs in the hardening reaction. The hardening reaction can be initiated using the

	мономерларга электронлар оқимини таъсир этиш натижасида содир бўлади.	appropriate chemicals or by applying heat and pressure, or by exposure to a monomer to an electron beam.
Термопластлар	Полимерлар температура ва босим таъсирида оқувчанлик эга бўладилар ва иссиқлик таъсирида юмшоқ ёки пластик ҳолатга ўтадилар. Хона ҳароратигача совутилганда бундай полимерлар ҳам қотади.	Polymers that flow when exposed to temperature and pressure, i.e., they soften or become plastic when heated. After cooling to room temperature, the thermoplastic solidifies.
Полимер матрициали композитлар	Тайерлашда асосан полиэфир, эпоксид ёки фенолоформальдегид боғловчилилар кўлланилади, булар қотган ҳолатда етарли мустаҳкамликга эга.	For the manufacture of polymer - matrix composites most commonly used polyester, epoxy or phenol-formaldehyde binder, as the most efficient, with reasonably high strength properties in the cured state
Термопластик полимерлар	Ҳарорат таъсирида юмшайдиган ёки эрийдиган полимерлар, бу турга паст ва юқори зичликдаги полиэтилен, полистирол ва полиметилметакрилатла р киради.	Polymers that soften or melt when heated; examples include polyethylene low and high density, polystyrene and polymethylmethacrylate.
Полимерларнинг оловбардошлиги	Қўйидагиларга боғлиқ бўлади: олов тарқалиш	Depends on the surface flame

	майдони, таъсири ва индекси.	ёқилгини кислород иккита индекси.	spread and penetration of fuel and oxygen index.
Кислород индекси (LOI)	Ёниш давом этиш учун зарур бўлган кислороднинг минимал қийматини белгилайди.	The minimum amount of oxygen that will support combustion.	
Полимер матрициали композитларда термопластик матрициалар	Полипропилен, нейлон, термопластик полиэфирлар (ПЭТ, ПБТ) ва поликарбонатлар, полиамид имид, полифениленсульфид (ПФС), полиарилсульфон (polyarylsulfone) ва полиэфир-эфиркетон кетонлардир (PEEK).	Polypropylene, nylon, thermoplastic polyesters (PET, PBT), and polycarbonates, polyamide imide, Polyphenylene sulfide (PPS), polyarylsulfone (polyarylsulfone) and polyester-etherketone ketone (PEEK).	
Металлар кристалл сингониялари	Асосан 3 та кристалл сингонияларда кристалланади: <ul style="list-style-type: none"> • ёnlари марказлашган кубик (ГЦК) • ҳажми –марказлашган кубик (ОЦК) • олтибурчакли зич упаковка қилинган (НСР) 	Most often, one of the following three crystalline forms: <ul style="list-style-type: none"> • face-centered cubic (FCC) • body-centered cubic (BCC) • Hexagonal close-Packed (HCP) 	
Металл матрициали композитларнинг турлари	3 тури мавжуд: <ul style="list-style-type: none"> • Дисперс-мустаҳкамлаштирил ган ММК • қисқа тола ва мўйловлар билан армировка қилинган ММК • узлуксиз тола ва листлар илан армировка 	<ul style="list-style-type: none"> • particle-reinforced MMCs • MMCs reinforced with short fibers or whiskers • MMCs reinforced with continuous fibre or sheet 	

	қилинган ММК.	reinforced MMCs
Эвтектик композицион материаллар	Эвтектик таркибли композитлар, мустаҳкамлаштирувчи фаза сифатида масса таркибида йўналтирилган кристаллизация жараёнлари натижасида ҳосил бўлган кристаллар хизмат қиласди.	Alloys of eutectic composition, in which the reinforcing phase are oriented crystals, which are formed by directional solidification.
Шишиакерамик материаллар	Ҳажм бўйича 95-98 фоизи кристалл фазадан, қолган қисми эса шиша фазадан иборат бўлади. Кристалл фаза ўта нозик (заррачалар диаметри 100 нмдан кичик) структурага эга.	They form a sort of composite material, as they consist by volume of 95-98% crystalline phase, and the rest submitted to the glassy phase. Crystalline phase is very fine (grain size less than 100 nm in diameter).
Керамика	Грекча keramike (юононча keramos) – тупроқ	From ancient Greek (keramos) - clay
Керамика материали	Табиий тупроқ ёки тупроқ билан турли минераллар аралашмасидан ҳосил қилинган лойни пишишиб, қуйиб, қуритиб ва кейин қаттиқ қиздириб ҳосил қилинган маҳсулот	The product of high temperature calcination of a mixture of natural clay and other minerals
Шиша	Кимёвий таркиб ва қотиш температурасига боғлиқсиз равишда юқори ҳарорат таъсирида ҳосил қилинган эритмани ўта совитиш орқали	Amorphous solids obtained by quenching the melt irrespective of the chemical composition and the solidification

	олинадиган қаттиқ жисмларнинг хоссаларини қабул қилинадиган барча аморф жисмлар.	temperature.
Оловбардош буюм	Керамика технологияси бўйича ишлаб чиқарилган, ўтхона ва печлар қуришда ишлатиладиган, оловбардошлиги 1580°C дан кам бўлмаган керамика буюми.	The product obtained by ceramic technology and used in the furnaces and high temperature furnaces construction, it's fire resistance not less than 1580°C
Техника керамикаси буюми	Керамика технологияси асосида ясалган ўтказгич, ярим ўтказгич, изолятор, маҳсус хоссали (магнит, оптик, электрик) буюм ва бошқалар	A conductor, semiconductor, insulator or a product with special properties (magnetic, optical, electrical) obtained by ceramic technology.
Керамик матрициали композитлар ишлаб чиқаришида иссиқ пресслаш жараёни	Бир вақтнинг ўзида матреиалга юкори ҳарорат ва босимни таъсир этиш натижасида зич структурали, ғоваксиз ва майда заррачали композиция ҳосил бўлади.	The simultaneous application of pressure and high temperature can accelerate the rate of densification and allows to obtain non-porous and fine-grained structure.
Керметлар	Металл заррачалар билан мустаҳкамлаштирилган керамика юкори механик мустаҳкамлик, иссиқлик зарбга бардошлиги, юкори иссиқлик ўтказувчанликга эга.	Reinforcement of ceramic dispersed metal particles leads to new materials (cermet) with increased resistance, resistance relative

		to thermal shock, high thermal conductivity.
Керметлар құлланилиши соҳалари	Юқори ҳароратлы керметлар асосида газ турбиналар деталлари, электр печлар арматураси, ракета ва реактив техника деталлари тайёрланади. Қаттық ишқаланишга чидамли керметлар қирғиши инструментлари ва деталлари тайёрлашда кенг қўлланилади.	High temperature cermets used to make parts for gas turbines, valves furnaces, parts for rocket and jet technology. Hard ware resistant cermets are used to manufacture the cutting tools and parts.
OSB	Ориентирланган қириндили плиталар	Oriented strand board
MDF	Ўртача зичликдаги ёғоч толали плиталар	Medium Density Fibreboard
Фанера	шпон қатламларидан пресс slab олинадиган плита материали	the tiled material received by pressing of layers of an interline interval
Ёпшиқоқлик	елим юзасининг асос юза билан таъсирлашиши	interaction of a surface of glue with a basis surface
Дисперс боғланиши	Бир-бирига жуда яқин жойлашган молекулалар ўртасидаги боғланиш	Communications between very closely located molecules
Водород боғланиши	Водород атомининг иккита қутбланган гурухга тақсимланиши натижасида ҳосил бўладиган боғланиш	Communication, formed in a consequence of division of atom of hydrogen into two polar groups
Паренхим хужайралари	Ёғочдаги чўзинчоқ бўлмаган хужайралар (ўзак нурлари, смола йўллари ва х.к.)	the wood cages (beams, the pitch courses, etc.) which aren't extended on length

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар

1. Jeremy Ramsden Nanotechnology, Second Edition: An Introduction (Micro and Nano Technologies) 2nd Edition, Elsevier, 2011, 272 p.
2. Guozhong Cao, Ying Wang Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications 2nd Edition, Imperial College Press, 2010, 596 p.
3. David Rickerby Nanotechnology for Sustainable Manufacturing, Taylor and Francis, 2014, 283 p.
4. Пул Ч., Оуэнс Ф. Мир материалов и технологий. – М.: Техносфера, 2004. – 265 с.
5. Charles P. Poole, Frank J. Owens Introduction to Nanotechnology, John Wiley and Sons, 2003, 388 p.
6. Linda Williams, Wade Adams, Nanotechnology Demystified, McGraw-Hill, 2007, 343 p.
7. Л. Уильямс, В.Адамс. Нанотехнологии без тайн, McGraw-Hill, 364 с.
8. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию: Учебное пособие (пер. с японского). – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2005. – 374 с.
9. Said Salaheldeen Elnashaie, Firoozeh Danafar, Hassan Hashemipour Rafsanjani Nanotechnology for Chemical Engineers, Springer, 2015, 278 p.
- 10.Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований. Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Аливисатоса, Москва, 2002.
- 11.П. Харрис. Углеродные нанотрубы и родственные структуры, Москва, 2003.
- 12.Нанотехнологии-Азбука для всех. Под ред. Ю. А. Третьякова, М. Физматлит, 2008, 368 с.
- 13.T. Pradeep Nano: the essentials. Understanding Nanoscience and Nanotechnology. McGraw-Hill, 2007.-432 p.
- 14.Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов/Под ред. С.В. Калюжного.-М.: Физматлит, 2010.-528 с.
- 15.rishan K. Chawla. Composite Materials. Science and Engineering. Third Edition. Springer Science, New York-London, 2012.- 542 p.
- 16.D.R. H. Jones, Michael F. Ashby. Engineering Materials 2: An Introduction to Microstructures and Processing. Fourth Edition. Elsevier, UK, 2012. -576 p.
17. William D.Callister, Jr., David G.Rethwisch. Materials Science And Engineering. An Introduction. Eight Edition. USA, Wiley, 2010.- 1000 p.
18. Roger M. Rowell. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. CRC Press; 2 edition; 2012, 703 p. ISBN-13: 978-1439853801.
- 19.Harold A. Wittcoff, Bryan G. Reuben, Jeffery S. Plotkin. Industrial Organic Chemicals. UK, 2008. 848 p.ISBN-10: 0470537434.
- 20.Donald G. Baird, Dimitris I. Collias. Polymer Processing: Principles and

- Design, 2nd Edition, USA, 2014. ASIN: B010WF8PF4
- 21.Lang R.W. Woodworker's Guide to SketchUp (DWD-ROM). USA, 2015.
- 22.Тялина Л.Н., Минаев А.М., Пручкин В.А. Новые композиционные материалы. Учебное пособие. Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011.-82 с.
- 23.Шевченко А.А. Физикохимия и механика композиционных материалов. – М. : Профессия, 2010. – 224 с.
- 24.Нано и биокомпозиты/под ред. А. К.-Т. Лау, Ф. Хуссейн, Х. Лафди ; пер. с англ. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 390 с.

Интернет ресурслар

1. www.sciencedirect.com
2. doi:10.3390/ma7031927
3. www.elsevier.com
4. <http://wiley.com>
5. www.Ziyonet.uz
6. Infocom.uz электрон журнали: www.infocom.uz
7. <http://link.springer.com/article>

IX. МУТАХАССИС ТОМОНИДАН БЕРИЛГАН ТАҚРИЗ

ОТЗЫВ

**на образовательную программу и учебно-методический комплекс по
учебному модулю «Методы и технологии производства нано и
композиционных материалов» курсов переподготовки и повышения
квалификации преподавателей направления «Химическая технология»
(по производству неорганических веществ и минеральных удобрений)
Ташкентского химико-технологического института**

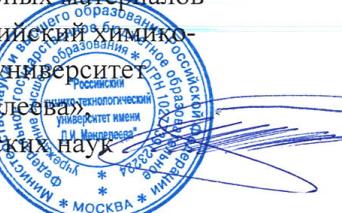
Образовательная программа и учебно-методический комплекс подготовлены для переподготовки и повышения квалификации преподавателей по направлению «Химическая технология» (по производству неорганических веществ и минеральных удобрений) в Отраслевом центре при Ташкентском химико-технологическом институте.

Учебно-методический комплекс по учебному модулю «Методы и технологии производства нано и композиционных материалов» состоит из рабочей программы модуля; интерактивных методов обучения; теоретического и практического материала занятий; тем квалификационных выпускных работ; банка кейсов, глоссария, списка использованной литературы.

Содержание учебного модуля состоит из 2-х частей. Первая часть посвящена изучению нанотехнологий и наноматериалов, в том числе основных понятий нанотехнологии и наноматериалов; методов синтеза различных типовnanoструктурных материалов и нанообъектов. Вторая часть посвящена технологии получения композиционных материалов; изучению основных видов матриц и армирующих материалов, в том числе изучаются нетрадиционные и биокомпозиты, а также сферы их применения.

Практические занятия посвящены изучению основных методов получения нано и композиционных материалов, возможностей использования современных методов синтеза. Освоение учебного модуля «Методы и технологии производства нано и композиционных материалов» позволяет повысить знания и практические навыки профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, способствует усовершенствованию учебных программ дисциплин специальности.

Декан факультета технологии
неорганических веществ и
высокотемпературных материалов
ФГБОУ ВО «Российский химико-
технологический университет
имени Д.И. Менделеева»
кандидат технических наук



Д.О. Лемешев